

PRODUITS ET SERVICES



Accelonix
keeping you ahead

Accelonix est un groupe d'experts dédié à l'industrie électronique et microélectronique, présent en France, au Royaume-Uni et Irlande, au Benelux, au Maghreb et en Chine.

Nous proposons des équipements et solutions spécialisés pour la production, l'inspection, le test, les logiciels métiers, la microélectronique et la métrologie, avec un service de formation certifié Qualiopi en France.

Véritable lien entre nos clients et nos partenaires fournisseurs, nous nous positionnons comme un acteur clé capable de répondre à vos besoins avec une expertise reconnue. Notre ambition ? Vous offrir des produits à la pointe de la technologie et un accompagnement sur mesure pour maximiser vos investissements.

Nos fournisseurs, rigoureusement sélectionnés pour leur innovation et leur excellence, nous permettent de proposer des solutions adaptées aux exigences spécifiques des différents marchés.

Dans ce catalogue, vous découvrirez une gamme complète de solutions pour l'assemblage de PCB, les systèmes de test et d'inspection, et bien plus encore.

Accelonix vous accompagne à chaque étape de vos projets, avec un soutien personnalisé pour relever les défis technologiques et garder une longueur d'avance dans un secteur en constante évolution.

Accelonix « keeping you ahead ! »

PRODUCTION

LOGISTIQUE COMPOSANTS6

Réception automatisée des marchandises entrantes et stockage automatisé
Comptage RX des composants électroniques
Armoire de stockage des composants MSL et mise sous vide

TRANSITIQUE, TRANSPORT ET CONDITIONNEMENT12

Transitiques cartes électroniques
Palettiseur-dépalettiseur

IDENTIFICATION 16

Sérialisation par étiquettes
Sérialisation par gravure laser
Nettoyage des cartes électroniques non équipées

SÉRIGRAPHIE 19

Automatique sur pochoir ou écran
Manuelle et semi-automatique sur pochoir ou écran
Outillages, accessoires et consommables

INSERTION ET PLACEMENT23

Placement de composants CMS
Insertion automatique axiale, radial et exotique

PROCÉDÉS THERMIQUES26

Convection sous air, azote, ou sous vide
Fours-tunnels de traitement thermique
Brasage des cartes électroniques sous phase vapeur
Brasage par conduction avec ou sans vide

NETTOYAGE ET LAVAGE 30

Lavage des pochoirs et écrans de sérigraphie
Lavage des cartes électroniques équipées
Lavage des pièges à flux et cadres de vagues
Lavage accessoires sérigraphie et pièces mécaniques

DÉTOURAGE 34

Séparation par détournement mécanique
Séparation par détournement laser

DOSAGE ET DISPENSE35

Dispense et vernissage sélectif
Préparation des résines bi-composants pour l'encapsulation
Pompes de dosage pour résines mono et bi-composants
Systèmes de dosage de résines sous pression atmosphérique
Systèmes de dosage sous vide
Étanchéité et système de dispense de mousse monocomposant

SYSTÈMES THERMIQUES INDUSTRIELS 42

Systèmes thermiques industriels

RÉPARATION BGA, QFN... 44

Station de réparation BGA, QFN...

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 45

Plateforme de gestion
Puces et fils (Bonding)

INSPECTION

CRÈME À BRASER (SPI) 46

SPI 3D

INSPECTION CARTES ÉQUIPÉES (AOI) 47

3D AOI
Vernis 2D et 3D
Inspection THT

INSPECTION DES PCB PAR RAYONS X 50

Inspection manuelle 2D/3D des PCB par Rayons X

COMPTAGE DES COMPOSANTS51

Comptage par rayons-X

TEST

TEST ÉLECTRIQUE52

Testeurs à sondes mobiles
Testeur lit à clous
Test réparation

TESTEURS DE CÂBLES ET HARNAIS56

Basse et haute tension
Test fonctionnel

LOGICIELS

NPI 60

Suite de logiciels pour NPI

L'USINE CONNECTÉE62

Connectivité
Gestion du matériel
Traçabilité
Factory Insights

WORK INSTRUCTION SOFTWARE 66

Work Instruction Software

MICROÉLECTRONIQUE

SALLE ET ZONE BLANCHE 68

Hotte, cabine et salle

WAFERS 69

Découpe wafers et substrates
Die sorting
Périphériques pour montage et découpe de wafers

INSPECTION ET TEST74

Inspection - die et wirebond
Shear & pulltest pour dies et wire bonds

WIRE BONDING, SMART ET LASER WELDING76

Câbleuses semi-automatiques fin et gros fil
Câbleuses automatiques fin fil, ball et wedge
Soudage des connexions de puissance
Outils pour wirebonding

FABRICATION ADDITIVE (AME) 80

Fabrication additive (AME)

PLASMA 81

Plasma sous vide pour activation et décontamination

DIE ATTACH ET DIE SORTING82

Brasage en chambre vide/pression
Die bonder manuel
Die bonder semi-automatique
Die bonding automatique

ENCAPSULATION 87

Dispense pour glob-top, dam & fill, et underfill
Surmoulage et singulation
Fermeture hermétique

LOGICIEL MICROÉLECTRONIQUE 90

Logiciels microélectronique

MÉTROLOGIE

MÉTROLOGIE DE DÉFORMATION THERMIQUE92

Métrologie de déformation thermique

MÉTROLOGIE DES SURFACES93

Métrologie des surfaces par capteur optique

NOTRE STRATÉGIE



Distributions Exclusives
Forts Partenariats Clients



Experts Maison
Forts Partenariats Fournisseurs



Produits Complémentaires
Experts européens
Recherche d'innovation

NOS DOMAINES D'EXPERTISE

Inspection & métrologie

Réparation BGA, QFN
Logiciels pour l'industrie de l'assemblage électronique

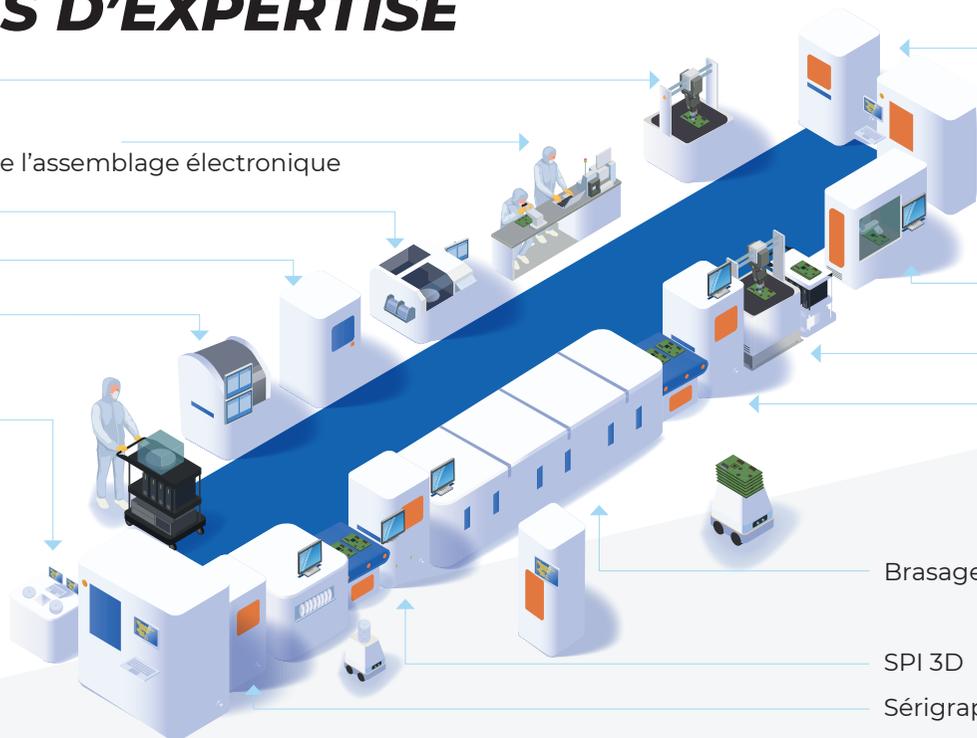
Dicing, Plasma

Die Attach

Wire Bonding

Contrôle d'entrée

Stockage dynamique
des composants



Marquage laser

RX 3D

Test à sondes mobiles
et ICT

Vernissage, potting, gasketing

AOI 3D

Brasage et polymérisation

SPI 3D

Sérigraphie

NOS GAGES DE QUALITÉ

Certification
ISO 9001



Système de
management
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105060474

Organisme
de formation





Accelonix Software se distingue par sa suite logicielle dédiée au NPI (New Product Introduction), offrant des solutions innovantes, évolutives et adaptées aux besoins spécifiques de la fabrication de cartes électroniques.



Advanced Dicing Technologies (ADT) développe des systèmes et lames pour la découpe des wafers, boîtiers et matériaux durs microélectroniques, avec un service de conseil pour besoins spécifiques.



Akrometrix fabrique des équipements de métrologie pour analyser la déformation thermique et les contraintes, utilisant « Shadow Moiré », « Digital Fringe Projection » et DIC pour tout type de substrat.



AMADA MIYACHI AMERICA, INC.

Amada Miyachi-Unitek US, membre du groupe Amada, fabrique des systèmes de soudage des métaux. Sous la marque « Benchmark », elle propose des solutions de scellement hermétique pour boîtiers verre/métal ou céramique, avec des enceintes sèches adaptées.

ASYS GROUP

Asys Group, fondé en 1992, développe des solutions d'automatisation couvrant plus de 75 % des besoins d'une ligne d'assemblage CMS, complétées par des solutions logicielles et logistiques intelligentes.



La division **cleanroom de Asys Group** propose des solutions modulaires ou intégrées pour la création et l'équipement de zones blanches



Atlas Copco EPS GmbH, leader mondial en technique de collage, dosage et potting, propose des solutions de préparation de matière, potting sous vide ou atmosphère, et automatisation modulaire. Active dans les industries automobile, électronique, télécommunication, médicale et chimique, elle allie expertise et qualité.



Besi

Besi est fabricant d'équipement de précision pour l'assemblage de semi-conducteur. Les clients-utilisateurs sont des multinationales, fabricants et sous-traitants pour l'industrie électronique.



Cirris, leader mondial du test de câbles et harnais, compte 20 000 installations chez plus de 8 000 clients. L'entreprise propose un testeur moderne alliant architecture matérielle innovante et logiciel intuitif.



Cogiscan existe depuis 1999 et à pour fondation le concept : utiliser la technologie de l'information pour intégrer de façon fluide tous les différents éléments du processus de fabrication, y compris, les machines, les matériaux, les gens et les systèmes d'entreprise.



Comet Yxlon est un concepteur et fabricant de systèmes d'inspection par rayons-X, avec dans la gamme de produits Feinfocus les systèmes Cheetah EVO et Cougar EVO.



Cyber Technologies, spécialiste des systèmes profilométriques 2D et 3D sans contact, offre des capteurs optiques précis pour le contrôle des processus en industrie et R&D, couvrant composants, assemblages hybrides et pièces optiques ou mécaniques.



Avec près de 50 ans d'expérience en câblage ultrasonique, **Deweyl** est leader dans la fabrication d'outils en céramique. L'entreprise propose également des finitions en carbure de tungstène et titane.



Screen Printing Technologies

Depuis près de 40 ans, **Ekra (Asys Group)** conçoit des solutions complètes d'impression par sérigraphie, offrant des systèmes performants, fiables et de haute qualité. Ses nombreuses innovations reflètent son expertise et répondent aux évolutions du marché.



focus on **storage solutions**

Forte de 30 ans d'expérience en assemblage de cartes électroniques, **Essegi Automation** a développé des solutions de stockage automatisé et dynamique sous la marque « StorageSolutions » depuis plus de 12 ans. Avec un réseau de distribution mondial et deux usines, l'entreprise est aujourd'hui un leader incontournable du secteur.



GPD Global, est une société américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de dispense de fluide depuis plus que 40 ans.



Hesse GmbH, l'un des leaders mondiaux des machines de câblage wedge-wedge automatisées, excelle en mécatronique, technologie ultrasonique et ingénierie de contrôle, avec une expertise approfondie des processus et des effets physiques de la connexion par ultrasons.



Huntron fournit depuis plus de 35 ans, des solutions complètes pour le support et la maintenance des cartes (PCB).



Marvin Test Solutions conçoit des solutions de test innovantes pour les secteurs militaire, aérospatial et manufacturier, améliorant les performances tout en réduisant l'encombrement et la consommation d'énergie, avec un soutien à long terme fiable.



Modus est un fabricant de système A.O.I (Automated Optical Inspection) et propose une gamme de machines d'inspection par vision (scanner ou caméra) des cartes électroniques à chaque étape de la chaîne de fabrication.



Nano Dimension fournit des machines intelligentes pour la fabrication additive d'électronique (AME). Elles déposent simultanément des matériaux conducteurs et diélectriques, intégrant directement des composants comme condensateurs, antennes et transformateurs, pour des performances inégalées.



Nordson March, leader des solutions plasma pour back-end, fournit des équipements automatiques et robustes pour améliorer la mouillabilité et le collage. Ces systèmes, basés sur le plasma RF, garantissent des processus fiables pour le nettoyage avant wirebonding et le traitement avant collage ou flip-chip underfill.



Panasonic Connect Europe, créée en 2021, intègre **Panasonic Factory Solutions Europe**, spécialisée dans les solutions pour usines intelligentes. Cette division propose des technologies variées, notamment en fabrication électronique, systèmes robotiques, soudage et logiciels.



Grâce à une expérience de plus de 15 ans et une expertise interne brevetée dans la mesure combinée Caméra + Laser et le développement de logiciels, **Parmi** est aujourd'hui le leader mondial dans l'inspection pâte à braser SPI 3D et un acteur incontournable pour l'inspection AOI 3D avec des solutions et technologies adaptées à l'analyse CMS, des traversants, des press fit et autres applications de haute résolution dans le semi-conducteur.



Fondée en 1985 par Philip Gibbs, David Lowrie et Roger Gibbs, **PDR** a lancé son premier système IR en 1987. Plus de 37 ans plus tard, l'entreprise reste à la pointe des technologies de retouche SMD, collaborant avec les plus grandes entreprises mondiales.



THERMAL SYSTEMS

Fondée en 1990, **Rehm Thermal Systems** est spécialisée dans les fours de séchage, de brasage par convection et phase vapeur, atmosphérique ou sous vide, pour les assemblages électroniques. Réputée pour la robustesse de ses fours en environnements exigeants, elle s'est diversifiée depuis 2010 dans les robots de vernissage sélectif.



Depuis plus de 30 ans, les équipements **Royce Instruments** sont utilisés mondialement par les principaux fabricants de semi-conducteurs. Ils offrent une précision remarquable pour les tests et la sortie de puces. En 2013, Royce a rejoint un leader du domaine de la mise en bobines de puces.



SST International est spécialisée dans le soudage sous vide pour la brasure de puces et le scellement hermétique. Leurs solutions éliminent les gaz piégés grâce à une transition du vide à la surpression à l'état liquide. Elles intègrent un contrôle précis de la chaleur, du vide et des gaz dans un équipement robuste et fiable.



A Member of the ASYS Group

Totech EU, initialement distributeur d'armoires ultra-sèches il y a dix ans, est devenue une entreprise indépendante de conception et fabrication. Sous la marque Super Dry®, elle propose des solutions MSD reconnues à l'échelle mondiale.



SUCCESS TOGETHER

Depuis 1990, l'entreprise allemande **Systronic** conçoit et fabrique des machines de nettoyage pour l'assemblage électronique. Sa gamme robuste et de qualité couvre le nettoyage des écrans, pochoirs de sérigraphie, cadres de vague, filtres piège à flux, et des flux sur cartes équipées.



Takaya N°1 des testeurs à sondes mobiles dans le monde est très présent sur le territoire français avec plus de 200 testeurs en fonctionnement.



Teknek, pionnier du nettoyage par contact, améliore les rendements en éliminant les contaminants. Spécialiste de l'industrie PCB, il réduit les rebuts en nettoyant les circuits imprimés nus avant la sérigraphie.



Teradyne est le leader mondial dans le domaine du Test In Situ de cartes électroniques. Manuel, automatiques, en ligne, simple ou multiple puits, Teradyne propose toutes ces solutions de test.



TPT, basée à Munich depuis 2000, conçoit et fabrique des machines de bonding semi-automatiques et manuelles pour fils fins et gros-fils. Son succès repose sur des solutions de bonding efficaces, un support technique réactif, et un réseau mondial de distribution et d'assistance.



Tresky conçoit des Die Bonders manuels et semi-automatiques pour la R&D et les petites à moyennes productions. Ces solutions offrent un placement précis au micron près, adaptées aux processus complexes. Les innovations récentes intègrent des automatisations pour garantir fiabilité, simplicité et reproductibilité tout en réduisant la dépendance à l'opérateur.



by VisiConsult

VCcount by VisiConsult est une entreprise Allemande, spécialiste des systèmes de rayons X personnalisés et standard. Elle a introduit sur le marché la technologie de comptage de composants par rayons X et est leader dans ce domaine.



Fort de plus de 50 ans d'expérience, **VKS** aide les entreprises à optimiser leurs opérations et à renforcer les compétences de leur main-d'œuvre grâce à sa plateforme d'instruction de travail intelligente.

LOGISTIQUE COMPOSANTS

- ▶ Réception automatisée des marchandises entrantes et stockage automatisé

ESSEGI AUTOMATION

focus on **storage solutions**

INCOMING MATERIAL STATION

Station d'étiquetage et d'enregistrement des composants CMS

Cette station de contrôle d'entrée matières permet la lecture automatique des codes fournisseurs 1D/2D sur chaque emballage et l'enregistrement automatisé des informations dans votre atelier de fabrication électronique ainsi que dans votre ERP. L'édition d'un code unique, appliqué sur chaque emballage, garantira la traçabilité tout au long du processus.



Lecture par caméra des codes bobines CMS, plateaux JEDEC, etc.

Reconnaissance automatique des codes 1D et 2D

Interfaçage des données avec ERP

Comparaison du bon de Livraison et de la commande fournisseur

Comparaison du code article reçu avec base articles qualifiée.

Édition code unique et traçabilité associée

Appariement étiquettes fournisseurs et code unique

Interfaçage des données avec l'atelier de fabrication électronique

INCOMING MATERIAL STATION 2.0

Station ergonomique d'étiquetage et d'enregistrement CMS

La Station de Réception Matières 2.0 est la solution ergonomique optimiser la réception et l'enregistrement matières. Conçue pour offrir un confort maximal aux opérateurs, cette nouvelle version intègre des fonctionnalités avancées telles que des caméras haute précision, des pieds réglables en hauteur et une mobilité assurée grâce à ses roues.



Caméra supérieure et interne pour une capture rapide et précise des étiquettes

Pieds ajustables de 750 mm à 1150 mm pour un confort optimal en position assise ou debout

Espace suffisant pour travailler confortablement assis ou utiliser comme poste de travail ISM

Bouton et pédale pour un traitement ergonomique des opérations d'acceptation

Roues intégrées pour une mobilité et une sécurité maximales

Enregistrement rapide des étiquettes avec lecture des deux côtés

Version automatique avec 4 positions de stockage et version manuelle selon les besoins

ISM 500

Armoire sèche pick-to-light pour composants CMS

Armoire sèche et stockage dynamique d'une grande variété de composants électroniques. Chaque position est matérialisée par des signaux lumineux LED permettant d'identifier rapidement la position de prélèvement. Accompagnée de son logiciel et son lecteur de code 1D et 2D, vous serez garanti de prélever les bons composants, et supprimer ainsi le risque d'erreur humaine.



Armoire sèche pour stockage des composants MSL

Configurable jusqu'à 640 positions

Stockage bobines 7, 13 et 15 pouces, plateaux JEDEC, Tubes composants SMD et THT, etc

Gestion dynamique des espaces disponibles

Visualisation par LED de la position du composant

Contrôle d'humidité RH<5% et logiciel de gestion des MSL

Importation des Ordre de Fabrication (OF) depuis l'ERP ou les machines de report CMS

Connaissance des quantités consommées pour le contrôle des stocks en temps réel

Interfaçage des données avec ERP, MES, Report CMS, Compteur RX

Existe en version 6, 10 et 16 étagères

ISM 1800

Tour de stockage des composants CMS jusqu'à 2000 bobines

L'armoire automatisée ISM 2000 est une alternative à l'ISM 3600 par sa capacité et sa construction. Pour les clients qui souhaitent stocker qu'une seule bobine par casier, elle représente une solution adéquate.



Capacité de stockage jusqu'à 2059 bobines

Stockage des bobines 7 pouces et hauteur 8, 12, 16mm et bobines de 13 et 15 pouces jusqu'à 72mm, plateaux JEDEC.

Entrée/sortie de 27 bobines à la fois (Breveté)

Contrôle d'humidité RH<5% et logiciel de gestion des MSL

Importation des Ordre de Fabrication (OF) depuis l'ERP ou les machines de report CMS

Connaissance des quantités consommées pour le contrôle des stocks en temps réel

Existe en modèle ISM 1100 de plus petite capacité

Interfaçage des données avec ERP, MES, Report CMS, Compteur RX

ISM ULTRAFLEX 3600

Tour de stockage des composants CMS de grande capacité

L'armoire automatisée ISM 3600 permet une grande capacité de stockage et de flexibilité de typologie des conditionnements des bobines composants. Elle gère la consolidation les approvisionnements, l'extraction et l'insertion automatisée jusqu'à 54 bobines à la fois. Possibilité d'ajout d'extensions pour doubler, tripler... votre capacité de stockage CMS.



Capacité jusqu'à 3600 bobines + 3900 par extension

Allocation des espaces re-configurable et dynamique selon la typologie des bobines

Stockage combiné des bobines 7 à 15 pouces et de 8 à 88mm, plateaux JEDEC

Contrôle d'humidité RH<5% et logiciel de gestion des MSL

Importation des Ordre de Fabrication (OF) depuis l'ERP ou les machines de report CMS

Connaissance des quantités consommées pour le contrôle des stocks en temps réel

Interfaçage des données avec ERP, MES, Report CMS, Compteur RX

Reconnaissance et gestion de des différentes tailles de plateau

ISM ULTRAFLEX 3600 FA

Tour de stockage CMS automatisé ou manuel

Systèmes de tours indépendants ou intégrés avec d'autres armoires de stockage pour le chargement et le déchargement automatisés par AMR ou manuels par l'avant.



Porte élévatrice automatique sans contact

Porte de sortie rapide

Reconnaissance et gestion automatiques de tous les formats de plateaux

Chargement et déchargement automatiques avec des robots mobiles autonomes (AMR)

PC intégré avec écran tactile

Logiciel ISM Console inclus

Écran tactile

Scanner de code-barres 1D/2D externe

Certification ESD

Système de déshumidification interne (en option)

AMR pour ISM3600 FA

Reconnaissance et gestion automatiques de tous les formats de plateaux

Chargement et déchargement automatiques et radar d'alignement automatique

SMART RACK MOBILE

Stockage mobile intelligent pour Composants CMS

Le Smart Rack Mobile d'Essegi Automation est un chariot conçu pour transporter et gérer divers composants à proximité des lignes de production. Il assure une traçabilité complète et automatisée de la matière et une réponse en temps réel.



Compatible avec le logiciel ISM et les solutions de stockage intelligent d'Essegi

Échange de données avec ERP, MES, WMS et systèmes Pick & Place

Espace ajustable : Étagères modulaires avec séparateurs réglables

Pick to Light : Système LED RGB pour réduire les erreurs de prélèvement

Détection automatique : Capteurs intégrés pour identifier les articles en stock

Jusqu'à 4 heures d'utilisation

Mobilité fluide : Déplacement facile grâce aux roues et à une mécanique optimisée

Tampon près des lignes : Positionnement flexible pour répondre aux besoins immédiats de production

Polyvalence des étagères : Modulation des espaces pour divers matériaux

Solution clé pour démarrer dans les solutions de stockage dynamiques et intelligentes

► Comptage RX des composants électroniques

VCcount
by VisiConsult

XRH COUNT Comptage des composants CMS par rayons X

VCcount a rendu le comptage des composants électroniques plus rapide, fiable et économique avec le compteur sans contact XRHCount. Contrairement aux compteuses manuelles, il détecte automatiquement les codes-barres et met à jour les stocks dans l'ERP, améliorant ainsi la productivité.



Écran tactile et Interface utilisateur intuitive

Certifié NFC74100 suivant les normes machine à Rayon X françaises

Tiroir automatique

Impression d'étiquettes automatisée

Position de travail ergonomique pour l'opérateur

Prise en charge des composants sur bobines, tubes ou autres conditionnements

Reconnaissance automatique du type de composant

Comptage sans contact rapide et précis (moyenne de 8.5 s par bobine) des composants CMS par rayons X (2s par bobine avec l'option Quad Count)

Compatibilité avec les principaux logiciels de gestion des stocks

Faible empreinte au sol : 1.25m x 0.85m

XRH COUNT INLINE Comptage des composants CMS par rayons X en ligne

Le XRHCount inline est un compteur de composants par rayons-X intégré aux lignes de production, offrant un chargement et déchargement automatisés. Il utilise l'analyse des mégadonnées et l'IA pour la maintenance prédictive et la gestion des systèmes.



Intégration à l'usine intelligente

Capacités de maintenance prédictive

Suite de statistiques et de maintenance

Surveillance complète du système : Suit des valeurs clés telles que les heures d'utilisation du tube à rayons X, les défauts de barrières lumineuses, les urgences, les cycles de tiroirs et les mises à jour logicielles pour une maintenance préventive

Fonctionnement automatisé : Capable de chargement et de déchargement automatiques, s'intégrant parfaitement aux lignes de production

Suivi et analyse des données : Surveille divers indicateurs opérationnels pour faciliter la maintenance préventive et l'optimisation des performances du système

Communication de données en temps réel

Dimensions du système : 830 x 660 x 2250 mm et temps de cycle de 10 sec./bobine

► Armoire de stockage des composants MSL et mise sous vide

SUPER DRY®
Tottech EU®

A Member of the ASYS Group

XSDC SERIES

Armoire de stockage réfrigérée pour pâte à braser

Les armoires réfrigérées XSDC de Totech EU offrent un stockage optimal pour la pâte à braser, maintenant une température de 0 à 12 °C avec une faible consommation d'énergie. Fabriquées en acier inoxydable, elles supportent des charges de 40 kg et permettent de suivre la localisation et la durée de stockage des pâtes, assurant une gestion FIFO efficace.



Dimensions externes : 701 x 2060 x 735 mm

Capacité effective : 466 L

Fabrication : Corps entièrement en acier inoxydable

Écran tactile : Affichage 10 pouces

Plage de refroidissement : 0-12 °C

Capacité de charge maximale : 300 kg

Capacité de stockage : 105 grandes cartouches, 175 petites cartouches, 180 pots (3 étagères de 42 pots)

Consommation électrique : +/- 60-100 W/h (température ambiante)

Nombre d'étagères : 3 étagères ajustables en hauteur, supportant chacune 40 kg

Capteurs de contrôle climatique

CONSIDUS

Armoire sèche

Avec alimentation en azote ou avec sècheur intégré. Pour une régulation d'humidité inférieure à 5 % pour les stockages, en conformité avec la norme IPC/JEDEC J-STD-033. Options en dimensions et pour stockage des formes diverses – en étage, étage coulissant ou pour stockage des rouleaux composants.



Contrôle d'humidité fiable et calibré

Option Dé-humidification par absorption: séchage et circulation de l'air contrôlés avec un puissant assécheur.

Structure en métal massif avec version ESD avec étagères en acier inoxydable (charge jusqu'à 50 kg)

Système de recirculation fermé avec des taux de circulation d'air élevés.

Système à 3 chambres (volume total de l'armoire divisé en trois chambres individuelles indépendantes)

Enregistrement de données pour la suivi du taux d'humidité et de température

Option : Conception spécifique client

Option : Alarmes visuelles et sonores et Portes verrouillables

Option : Profondeur d'armoire étendue (jusqu'à 1100 mm)

Option : Module de chauffage pour chauffer le corp jusqu'à 40 °C

SÉRIE SD

Conception solide et résistante

La série SD comprend un large éventail de modèles d'armoires. Grâce à leur conception avancée, à leurs étagères standard en acier chromé et à leurs unités de séchage fiables, elles offrent une protection maximale pour le stockage à moyen et long terme.



Unité de séchage U-2000 avec ventilateur intégré sans entretien

Conception sécurisée antistatique ESD (IEC 61340-5-1)

Surveillance des valeurs limites (HR ; °C)

Alarme de porte, alarme d'humidité

Panneau de contrôle numérique avec affichage de l'humidité et de la température

Portes verrouillables

Humidité relative régulée

Convient au stockage et au séchage conformément aux normes IPC

Séchage sans interruption grâce à 2 modules de séchage avec régénérations en déphasées (SD-1104/1106 et SDF-1704 uniquement)

D'autres options possibles

SÉRIE SD+

Séchage économique, précis avec enregistrement

Les modèles de la série SD+ correspondent à une version améliorée de la série SD. Les armoires sont équipées de sondes de haute précision. La régénération dynamique des unités de séchage réduit au minimum la consommation d'énergie.



Unité de séchage U-2000 avec ventilateur intégré sans entretien

Conception sécurisée antistatique ESD (IEC 61340-5-1)

Surveillance des valeurs limites (HR ; °C)

Alarme de porte, alarme d'humidité, Portes verrouillables

Régénération dynamique

Enregistreur de données intégré

Logiciel Totech Viewer pour visualisation sur PC

Interface Ethernet

Humidité relative régulée

D'autres options possibles

SÉRIE ESDA

Armoire acryliques

Les armoires de la série ESDA ont été conçues dans un esprit de transparence et sont ESD. Elles disposent d'un large éventail d'équipement et options, tels que les purges N₂, variété de différentes unités de séchage, conception sécurisée antistatique, etc.



Corps d'armoire en polycarbonate de haute qualité

Portes verrouillables

Unité de séchage U-2000

Conception sécurisée antistatique ESD

Alarme de porte, alarme d'humidité

Panneau de contrôle numérique

D'autres options possibles

SÉRIE SD, SDB, ASDA

Armoire de maintien au sec

Les armoires de séchage de la série SDB ont été spécifiquement conçues pour être des modèles premier prix et disposent uniquement des fonctions de base. L'unité de séchage U4001 brevetée garantit un niveau faible d'humidité relative pour le stockage à moyen et long terme.



Unité de séchage U-4001 avec ventilateur intégré sans entretien.

Conception sécurisée antistatique (ESD) (IEC 61340-5-1)

Visualisation conviviale du niveau d'humidité par un hygromètre.

Étagères peintes.

Portes verrouillables

Humidité relative de l'air inférieure à 5 %

D'autres options possibles

SÉRIE HSD, MSD, XSD

Armoires de séchage ou déshumidification rapide

Les modèles de la série HSD disposent d'une unité de séchage à haute performance, une technologie de mesure de précision et un panneau de contrôle intuitif.



Unité de séchage U-5000 avec ventilateur intégré sans entretien

Conception sécurisée antistatique ESD (IEC 61340-5-1)

Surveillance des valeurs limites (HR, °C)

Alarme de porte, alarme d'humidité, porte verrouillable

Humidité relative régulée en dessous de 0,5 %

Régénération dynamique

Enregistreur de données intégré

Logiciel Totech Viewer pour visualisation sur PC

Interface Ethernet

D'autres options possibles

SÉRIE MSD

Conception modulaire

Les armoires de séchage MSD peuvent évoluer en fonction de votre demande. Les caissons additionnels offrent une extension facile pour s'adapter à vos besoins.



Unité de séchage U-5000 avec ventilateur intégré sans entretien

Conception sécurisée antistatique (IEC 61340-5-1)

Surveillance des valeurs limites (HR ; °C)

Alarme de porte, alarme d'humidité, étagères peintes et télescopiques, portes verrouillables

Humidité relative régulée en dessous de 0,5 %

Régénération dynamique

Enregistreur de données intégré, surveillance en ligne

Totech Viewer logiciel gratuit

Interface Ethernet

D'autres options possibles

SÉRIE XSDB / 54 / 57

Technologie haut de gamme

Les armoires premium de la série XSD allient un séchage de haute performance et des courbes de température et d'humidité stables avec un savoir faire et une conception haut de gamme.



Unité de séchage U-5000 avec ventilateur intégré sans entretien (XSDB et XSD)

Corps de l'armoire isolé thermiquement et double vitrage

Écran tactile 4» (uniquement pour XSDB et XSD)

Chauffage jusqu'à 40° C (XSDB), jusqu'à 60° C (XSD) et refroidissement 2-20°C (XSDC)

Conception sécurisée antistatique

Surveillance des valeurs limites

Régénération dynamique (XSDB et XSD)

Enregistreur de données intégré (excepté XSDC 601-01)

Logiciel Totech Viewer gratuit (excepté pour XSDC 601-01)

Éclairage interne (XSD et XSDC)

SÉRIE XSDC

Séchage combiné avec refroidissement

L'armoire de stockage XSDC fournit une température et une humidité basses et stables pour tous les besoins de stockage à long terme. L'enregistrement des données des températures et alarmes est réalisé avec l'enregistreur de données intégré.



Unité de séchage U-5000 avec ventilateur intégré sans entretien (XSDB et XSD)

Corps de l'armoire isolé thermiquement et double vitrage

Refroidissement de 10°C en dessous de la température ambiante/de l'environnement

Conception sécurisée antistatique ESD

Surveillance des valeurs limites

Alarme de porte, alarme d'humidité, portes verrouillables

Régénération dynamique

Enregistreur de données intégré

Logiciel Totech Viewer gratuit

Éclairage interne

SÉRIE SDR

Solutions sur mesure

Chambres de séchage construites sur mesure. Nous vous assistons dans le choix des bonnes dimensions, de la couleur, de la capacité de séchage et du logiciel pour votre application spécifique.



Unité de séchage U-5000 avec ventilateur intégré sans entretien

Panneaux muraux isolés

Chauffage 40° C ou 60° C avec ventilateur radial puissant

Surveillance des valeurs limites

Alarme de porte, alarme d'humidité, portes verrouillables

Panneaux de visualisation

Humidité relative régulée en dessous de 5 %

Enregistreur de données intégré

Logiciel gratuit avec fonction de visualisation

Écran tactile 4» / 7»

SÉRIE SDV

Emballage sous vide

La série SDV est équipée d'un capteur de contrôle avec un détecteur de vide permettant un réglage précis des paramètres importants.



Chambre sous vide profonde en acier inoxydable

Couvercle en acrylique antistatique

Double soudure

Systèmes d'étanchéité à haute pression

Inserts pour réglage de profondeur de cuve

Panneau de commande Z3000 avec contrôle par sonde de dépression

99 emplacements de mémoire de programme

Fonctions de verrouillage des touches, d'arrêt rapide et de vide par étape

Pompe à vide de qualité Busch

Système de soudage avec alimentation sans fil

TRANSITIQUE, TRANSPORT ET CONDITIONNEMENT

▶ Transitiques cartes électroniques

ASYS GROUP

VEGO COMPACT BLO 01 Chargeur de ligne CMS - 1 rack

Chargeur 1 rack avec élévateur. Le système utilise un extracteur électrique pour charger le PCB depuis le rack jusqu'à la ligne de production. Le rack est changé manuellement par l'opérateur de ligne.



- Extracteur électrique
- Verrouillage mécanique du rack en deux points
- Panneau contrôle LCD
- Tour lumineuse et alarme sonore
- Interface SMEMA
- Hauteur de 950 mm +/- 50mm – 850mm en option
- Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l)
- Dimensions Rack : 535 x 520 x 568mm (L x l x H)
- Encombrement : 1140 x 1030 x 1140mm (L x l x H)

VEGO COMPACT BLO 03 Chargeur de ligne CMS - 2 racks

Chargeur de ligne pour 2 racks. Une navette équipée d'un extracteur électrique se déplace devant l'un et l'autre des deux racks, extrait le PCB puis se déplace jusqu'à la position de chargement de la ligne.



- Navette + extracteur électrique
- Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option
- Verrouillage mécanique des racks en deux points
- Panneau contrôle LCD
- Tour lumineuse et alarme sonore
- Courroies antistatiques
- Interface SMEMA
- Hauteur de 950 mm +/- 50mm – 850mm en option
- Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l) - Dimensions Rack : 535 x 520 x 568mm (L x l x H) - Encombrement : 1055 x 1520 x 1489mm (L x l x H)
- Solution à 3 racks disponible dans cette configuration

VEGO DYNAMIQUE AES03D Chargeur de ligne CMS - 2 à 4 racks

La station AES 03D est utilisée pour alimenter les PCB sur la ligne. Les PCB sont déchargés du rack, véhiculé par une navette vers l'entrée de la ligne. Il se caractérise par sa construction compacte et robuste. La plateforme élévatrice de stockage des racks permet un accès facile et ergonomique.



- Ecran couleur avec interface utilisateur graphique
- Paramètres du produit peuvent être modifiés en cours de fonctionnement
- Fonction de mémoire
- Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option
- Verrouillage mécanique des racks
- Tour lumineuse et alarme sonore
- Courroies antistatiques
- Interface SMEMA et HERMES
- Disponible en version 2, 3 ou 4 racks

VEGO COMPACT BDS 01

Dépilleur de PCB nus

Le dépilleur de circuits imprimés nus sépare les PCB pour les charger unitairement sur la ligne via un convoyeur placé sous la pile. La hauteur de la pile est de 200mm et une nouvelle pile de PCB peut être ajoutée sans stopper le système.



Pinces latérales pneumatique pour le maintien des PCB

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Mode traversant

Courroies antistatiques

Bouton marche/arrêt

Tour lumineuse et alarme sonore

Interface SMEMA

Hauteur de 950 mm +/- 50mm – 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l)

Encombrement : 530 x 797 x 1222mm (L x l x H)

VEGO COMPACT BCO 01-03

Convoyeurs PCB

Gamme de convoyeurs de 1 à 3 segments de 530mm à 1590mm pour la connexion intermédiaire entre deux machines



Segments multiples de 530mm de longueur - jusqu'à 3 segments et plus

Différentes longueurs de segments disponibles jusqu'à 1200mm

Réglage manuel de la largeur du convoyage aisé selon guides de précision

En option, réglage de la largeur de convoyage motorisé, programmable par contrôleur ou pilotée.

Fonction inspection processus

Convoyage à vitesse variable

Courroies antistatiques

Châssis stable et robuste

Interface SMEMA

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l) - Encombrement : 530 ou 1060 ou 1590 x 797 x 953mm (L x l x H) - Disponible pour PCB grands formats : jusqu'à 1200x660mm (L x l)

VEGO COMPACT BLG 01

Passage basculant pour ligne CMS

La barrière de passage est un convoyeur monté sur un point pivotant qui par l'action manuelle de l'opérateur permet l'ouverture d'un passage dans la ligne de production.. Le passage est de 845mm une fois la barrière levée.



Bouton marche/arrêt

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Fonction 0/1 des segments pour inspection process

Convoyage à vitesse variable

Courroies antistatiques

Interface SMEMA

Hauteur de 950 mm +/- 50mm – 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l)

Encombrement : 1250 x 1072 x 966mm (L x l x H)

Avec ou sans capotage

VEGO DYNAMIQUE TDM06

Passage télescopique pour ligne CMS

La barrière télescopique TDM 06 permet un passage à travers une ligne de production sans effet sur le flux de production. Le PCB est repris depuis le système amont et le translatteur horizontal le véhicule au système aval. Après transfert, le convoyeur se rétracte, ouvrant ainsi le passage de nouveau.



Écran couleur avec interface utilisateur graphique

Paramètres du produit peuvent être modifiés en cours de fonctionnement

Fonction de mémoire

Largeur ajustables électriquement

Largeur de passage réglable (en Mode NO)

Disponible en version ouverture droite ou ouverture gauche

Temps de cycle <15s

VEGO COMPACT BRS 03 Convoyeur d'inspection ou réparation pour ligne CMS

La station d'inspection - réparation est équipée de trois segments de 530mm chacun. Après avoir reçu le signal NOGO de l'AOI, le PCB est élevé sur le segment central pour inspection-réparation et les PCB GO transitent sous la carte en cours de reprise.



Segments de 530mm

Réglage manuel de la largeur du convoyage ou motorisé

Convoyage de sortie à vitesse variable

Courroies antistatiques

Capotage ESD de protection

Commande au pied du convoyage de la carte réparée

Poste de travail équipé à façon

Interface SMEMA

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l) - Encombrement : 1590 x 797 x 953mm (L x l x H) - Hauteur de 950 mm +/- 50mm - 850mm en option

VEGO COMPACT BBS 20 Buffer de PCB pour ligne CMS

Ce buffer dispose d'un élévateur pour le stockage des PCB. Un bras poussoir intégré transfère la carte depuis le convoyeur jusqu'à l'élévateur tampon. Pour le déchargement, un extracteur électrique transfère la carte depuis le tampon. Ce buffer en ligne peut être utilisé comme buffer FIFO, LIFO ou comme convoyeur simple.



Poussoir et extracteur électrique

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Élévateur avec stockage tampon 20 positions

Panneau contrôle LCD, programmation FIFO, LIFO et Pass through

Courroies antistatiques

Tour lumineuse et alarme sonore

Interface SMEMA

Hauteur de 950 mm +/- 50mm - 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l) - Dimensions Rack : 535 x 520 x 568mm (L x l x H) en option - Encombrement : 1206 x 1130 x 1740mm (L x l x H)

Autres fonctions : Refroidissement, tri des PCBs GO/NOGO

VEGO COMPACT BTT 01 Convoyeur orienteur PCB pour ligne CMS

La table orienteur est utilisée dans la ligne CMS pour changer de direction les PCB venant de la ligne. Les PCB sont orientés selon le mode programmé ou bien triés selon un signal extérieur. Les modes possibles sont traversant, chargement, déchargement, triage



Chargement/Rotation/Routage des cartes

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Courroies antistatiques

Bouton marche/arrêt

Interface SMEMA

Hauteur de 950 mm +/- 50mm - 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l)

Encombrement : 830 x 830 x 1060mm (L x l x H)

VEGO COMPACT BFS 01 Convoyeur retourneur PCB pour ligne CMS

La station de retournement est utilisée sur la ligne d'assemblage CMS pour retourner le PCB de 180° (recto-verso). Le PCB rentrant est maintenu par les côtés par verrouillage pneumatique avant d'être retourné par le mécanisme et convoyé vers le système suivant.



Fonction de retournement à 180°

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Courroies antistatiques

Mode traversant

Interface SMEMA

Hauteur de 950 mm +/- 50mm - 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l)

Encombrement : 530 x 1100 x 1284mm (L x l x H)

VEGO COMPACT BUL 01

Déchargeur de ligne CMS - 1 rack

Le déchargeur de ligne reçoit le PCB depuis la ligne via un convoyeur intégré équipé d'un bras électrique de poussée de la carte dans le rack. Une fois le PCB chargé dans le rack, l'élévateur positionne le rack au slot suivant. Le rack est changé manuellement par l'opérateur de ligne.



Convoyeur intégré avec bras poussoir électrique.

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Verrouillage mécanique du rack en deux points

Panneau contrôle LCD

Tour lumineuse et alarme sonore

Interface SMEMA

Hauteur de 950 mm +/- 50mm – 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l)

Dimensions Rack : 535 x 520 x 568mm (L x l x H)

Encombrement : 1146 x 1030 x 1137mm (L x l x H)

VEGO COMPACT BUL 03

Déchargeur de ligne CMS - 2 racks

Déchargeur de ligne pour 2 racks. Le PCB de la ligne est chargé sur un convoyeur navette équipée d'un bras poussoir électrique. La navette se positionne face à l'un ou l'autre des deux racks, le bras poussoir charge le PCB dans le rack. L'élévateur positionne le rack au slot suivant.



Navette + bras poussoir électrique

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Verrouillage mécanique des racks en deux points

Panneau contrôle LCD

Tour lumineuse et alarme sonore

Courroies antistatiques

Interface SMEMA

Aiguillage des PCB dans rack GO et NOGO

Hauteur de 950 mm +/- 50mm – 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l) - Dimensions Rack : 535 x 520 x 568mm (L x l x H) - Encombrement : 1034x 1520 x 1489mm (L x l x H)

VEGO DYNAMIQUE

AMS03D

Déchargeur de ligne CMS - 2 à 4 racks

La station AMS 03D conditionne les PCB en rack en provenance de la ligne de production. Il se caractérise par sa construction compacte et robuste. La plateforme de stockage des racks permet un accès facile et ergonomique et le changement des racks s'opère sans rupture de flux.



Écran couleur avec interface utilisateur graphique

Paramètres du produit peuvent être modifiés en cours de fonctionnement

Fonction de mémoire

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Verrouillage mécanique des racks

Tour lumineuse et alarme sonore

Courroies antistatiques

Interface SMEMA

Aiguillage des PCB dans rack GO et NOGO

Disponible en version 2, 3 ou 4 racks

VEGO COMPACT BST 01

Empileur de PCB nus

L'empileur de circuits imprimés collecte les circuits imprimés nus à la sortie de la ligne pour les mettre en pile. Le circuit est positionné sur le convoyeur intégré, puis un élévateur le place en dessous de la pile.



Maintien latéral pneumatique de la pile

Réglage de la largeur de convoyage manuel ou motorisé en option

Mode traversant

Courroies antistatiques

Bouton marche/arrêt

Tour lumineuse et alarme sonore

Interface SMEMA

Hauteur de 950 mm +/- 50mm – 850mm en option

Dimensions PCB : 50-460mm x 50-460mm (L x l)

Encombrement : 530 x 797 x 1231mm (L x l x H)

▶ Palettiseur-dépalettiseur

**ASYS
GROUP**

PARIO 500 Palettiseur-dépalettiseur de plateaux thermoformés

La gamme PARIO est dédiée au transfert de plateaux thermoformés. Le PARIO 1000 permet le transfert des plateaux vers une station de manutention des produits opérée par un robot XYZ. Il est parfaitement adapté aux intégrateurs recherchant à minimiser leur coût d'ingénierie en utilisant des fonctions déjà existantes.



Dimensions max des plateaux 600 x 400 mm

2 niveaux indépendants pour plateaux vides et plateaux pleins, ou tour de stockage multi plateaux avec gestion chaotique

Utilisable en unité de chargement ou de déchargement automatique

Poids max par plateau 5kg

Hauteur max de la pile de plateaux 400mm

Poids max de la pile de plateaux 28Kg

PARIO existe en version dépileur et empileur

IDENTIFICATION

▶ Sérialisation par étiquettes

**ASYS
GROUP**

INSIGNUM 3000 LABEL Impression et dépose automatique d'étiquettes pour PCB

L'INSIGNUM 3000 Label est doté d'un convoyeur PCB et d'un portique motorisé XYZThéta. Il permet l'impression et la dépose d'étiquettes de façon programmée et reproductible.



Système de transport intégré

Répétabilité de précision ± 0.25 mm avec correction optique

Format max PCB (L x l) : 460 x 460mm

Impression/Correction Optique/Placement par étiquette de 3,8s

2eme imprimante à transfert thermique possible

Imprimante sur rail télescopique pour une maintenance aisée et rapide

INSIGNUM VARIETY

Impression laser et dépose automatique d'étiquettes pour PCB

L'INSIGNUM Variety est doté d'un convoyeur PCB, d'un laser destiné au marquage et à la découpe des étiquettes et d'un portique motorisé XYZThéta pour la dépose. Il repousse les limites de miniaturisation des étiquettes à partir d'un processus robuste et permet la dépose d'étiquettes de façon programmée et reproductible.



Système de transport et retournement PCB intégré

Format PCB : 70-460mm x 50-460mm (L x l)

Résolution dot (data matrix) 7,5mil - 190µm

Marquage/découpe/placement étiquette en 4,5s

Placement sur PCB et/ou composants

Alimentation du film montée sur tiroir extractible

Compatible avec films laser sensible du marché (cf. 3M, TESA...)

Étiquettes compatibles avec processus de refusion et lavage

Dimensions étiquettes DMC inférieures à 5x5mm

► Sérialisation par gravure laser

ASYS
GROUP

INSIGNUM 1000

Gravure laser pour PCB petits formats

L'INSIGNUM 1000 est équipée d'une tête laser statique et d'un tiroir de chargement et déchargement des produits avec la possibilité d'intégrer un convoyeur et un retourneur pour le marquage recto verso.



Chargement/déchargement par tiroir

Répétabilité de précision ±0.5 mm

Surface de marquage max. 80x80mm

Format PCB: jusqu'à 300mm x 300mm (L x l)

Disponible avec laser CO2 ou laser fibré

Disponible avec convoyeur et retourneur intégré

INSIGNUM 3000

Gravure laser pour PCB

L'INSIGNUM 3000 est la solution de marquage cœur de gamme. Avec une surface de marquage de 400x400mm, sa station de retournement intégrée pour le marquage recto verso, dotée d'une grande précision, elle sera le meilleur rapport performance/prix de la gamme.



Système de transport et retournement PCB intégrés

Tête de marquage montée sur axes linéaires

Surface de marquage de 400x400mm

Temps de cycle marquage/relecture 1s

Codes : Codes 1D, 2D, Texte, Logo

Lecture des codes par lecteur 1D/2D

Monitoring de la qualité de marquage

Opération facile et confortable grâce à l'interface utilisateur SIMPLEX

Format PCB max (L x l) : 460 x 460mm - Dimensions : L x l x P: 830 x 1550 x 1480 mm

INSIGNUM 4000 Gravure laser pour PCB grands formats

L'INSIGNUM 4000 permet le marquage de PCB de grandes dimensions et le marquage recto-verso grâce à une station de retournement intégrée. Son système d'axes linéaires et sa table de retournement haute vitesse lui confère des cadences élevées. NOUVEAUTÉ : Station de retournement recto-verso haute vitesse



Système de transport PCB intégré

Axes XY linéaires pour la précision et la vitesse

Codes : Codes 1D, 2D, Texte, Logo

Précision et répétabilité de $\pm 0.15 \text{ mm}@5\text{Sigma}$

Surface de marquage max. 508x508mm

Extension du marquage à 610mm en longueur

Eclairage RGB pour PCB couleurs

Opération facile et confortable grâce à l'interface utilisateur SIMPLEX

Compacte : L x l x P: 830 _ 1565 _ 1550 mm

Disponible en laser CO2 ou laser fibré

► Nettoyage des cartes électroniques non équipées

teknek

An ITW Company

SMT II Machine de nettoyage par contact pour carte électronique grand format

Le nettoyeur SMT II est la référence dans le nettoyage PCB par contact. Avec un nettoyage à dissipation statique et une faible pression appliquée, le SMT II représente la méthode idéale pour collecter les contaminants avant sérigraphie. Il répond aux enjeux de traçabilité des processus et de connectivité.



Nettoyage par rouleaux élastomères électro dissipatifs

Nettoyage en ligne simple ou double face et traversant

Largeur de nettoyage 400 et 600mm

Connectivité IPC-Hermes-9852

Réponds aux normes :

Machine : ANSI/ESD s6.1 – 2014 & IEC 61340-5-1 2016

Rouleaux élastomères ISO 6122 Class A et ANSI /ESD s20.20 – 2014

Adhésifs FINAT

TEK-HR 2.0 Nettoyage à rouleaux manuel pour PCB

Les rouleaux à main, dont la poignée garantie 10 ans, sont testés scientifiquement pour fournir la meilleure performance de nettoyage. L'élimination des particules jusqu'à moins de 1 micron directement au poste de travail. Les rouleaux de nettoyage Teknek nettoient mieux, ils durent plus longtemps et n'ont aucun additif qui se dégrade. Sa nouvelle formulation élastomère donne des propriétés antibactériennes.



Rouleau élastomère monté sur une poignée ergonomique

Confortable, léger et fonctionne pour de multiples applications.

Faible pression exercée sur le produit

Bloc adhésif Teknek DCR associé pour optimiser les performances

Nettoyage des pochoirs avant montage sur la machine de sérigraphie

Nettoyage des PCB nus avant sérigraphie

Nettoyage de surface de matériaux durs (verre,) ou souple tels les polymères de synthèse (PET)

Tous les types de rouleaux Teknek sont disponibles dans le système DCR selon votre application.

Sa nouvelle formulation élastomère donne des propriétés antibactériennes.

Nettoyage à un niveau jamais atteint.

BC-40

Nettoyage en ligne par contact pour PCB

Le Tek-BC 40 est un nettoyeur en ligne conçu pour éliminer les particules et les charges électrostatiques des PCB avant sérigraphie. Conforme aux normes IPC/JEDEC et ANSI ESD, il assure la suppression optimale de la contamination.



Type de nettoyage : nettoyeur de cartes simple face en ligne

Modules de pré-nettoyage : brosse et module d'aspiration

Barre antistatique : barre à air assisté 24 VDC pour réduire l'électricité statique

Largeur de nettoyage : plage de 40 à 400 mm

Conformité aux normes : conforme aux standards ANSI / ESD S6.1 – 2019 et IEC 61340-5-1-2016

Adhésifs : tous les adhésifs respectent la norme FINAT

SÉRIGRAPHIE

► Automatique sur pochoir ou écran

EKRA

Screen Printing Technologies

SERIO 4000

Sérigraphie PCB en ligne économique et évolutive

La SERIO 4000 est une sérigraphieuse automatique en ligne destinée à la sérigraphie de crème à braser ou de colles sur les circuits imprimés. Elle est née pour être évolutive et recevoir de nouvelles fonctionnalités chez le client selon l'évolution des besoins. NOUVEAUTÉ : Placement automatique des chandelles magnétiques.



Opération facile et confortable grâce à l'interface utilisateur SIMPLEX

Rapidité de programmation <5min et changement rapide de production <2min

Aire de sérigraphie 610 x 510 mm

Temps de cycle 11s, 9s, 7s + sérigraphie selon besoin

Inspection 2,5D des dépôts % de couverture, court-circuit, volume

Sérigraphie asservie selon résultat SPI 3D

Système de chargement automatique du pochoir

Changement rapide des racles

Nettoyage intrusif de l'écran par oscillation

Vérification du plan de chargement et traçabilité et systèmes de supportage PCB auto conformant: GridLock, Variogrid, QuickTool

SERIO 5000

Sérigraphie PCB en ligne évolutive et précision accrue

La SERIO 5000 est basée sur un concept de plate-forme modulaire. Comme la SERIO 4000 elle est évolutive pour s'adapter avec souplesse aux besoins individuels. Elle est conçue pour des applications qui exigent une précision de sérigraphie accrue, des opérations et un processus asservis pour une qualité maîtrisée du produit final. NOUVEAUTÉ : Placement automatique des chandelles magnétiques



Répétabilité de sérigraphie $\pm 20 \mu\text{m}$ @ 6 Sigma

Durée du cycle: 7 s + print

Format de sérigraphie jusqu'à 610 x 510 mm

Changement de programme <2 min

Changement de setup produit asservi

Maniement simple grâce à l'interface utilisateur SIMPLEX

Traçabilité du processus et Connectivité (MES)

SERIO X5 PROFESSIONAL

Sérigraphie polyvalente en ligne pour crème et encre

Le système de sérigraphie X5 professionnel est une solution de sérigraphie de haute polyvalence et performance. Elle est synonyme de fonctionnalités sans précédent et assure une qualité de production au plus haut niveau. Cette plateforme bénéficie d'un développement continu de nouvelles fonctionnalités destinées à répondre à l'émergence de nouvelles applications.



Adaptée à la sérigraphie sur pochoir ou écran mesh

Contrôle dynamique de la pression des racles

Têtes de sérigraphie basse pression

Répétabilité: $\pm 20 \mu\text{m}$ @6 Sigma CpK ≥ 2.00

Fonction d'alignement unitaire des produits avant sérigraphie collective

Dispense colle et crème par jetting sans contact

Nettoyage pochoir oscillant

Opération facile et confortable grâce à l'interface utilisateur SIMPLEX.

Temps de cycle: 8 ou 5s + temps d'impression (selon option).

SERIO 8000

Sérigraphie pour formats PCB extra larges

La SERIO 8000 est spécialement conçue pour la sérigraphie de crème à braser et colle pour des applications très grands formats ayant une surface allant jusqu'à 1,000 x 610 mm (40 x 24 pouces).



Alignement répétabilité: $\pm 12,5 \mu\text{m}$ @ 6 Sigma.

Zone d'impression jusqu'à 1000 x 610 mm (40 x 24 pouces).

Écran flexible et porte-pochoir pour des tailles allant jusqu'à 1.700 x 1.270 mm (67 x 50 pouces).

Opération facile et confortable grâce à l'interface utilisateur SIMPLEX.

Rapide set-up et changement de produit <5 min.

Grande variété d'options intégrables

HYCON XH3

Automatique pour applications de sérigraphie épaisses

Le système de sérigraphie automatique XH3 est spécialement conçu pour les applications de sérigraphie, ainsi que pour les couches minces et épaisses sur écrans en mesh avec émulsion.



Précision d'alignement : $\pm 12,5 \mu\text{m}$ à 6 Sigma pour un positionnement précis

Temps de cycle : 12 s + impression

Zone de sérigraphie pour substrats rigides : de 4 _ 4 pouces à 7 _ 7 pouces

Zone de sérigraphie autres formats : de 80 _ 50 mm à 508 _ 508 mm

Système de positionnement optique breveté EVA™ : précision et fiabilité optimales

Têtes indépendantes : deux têtes pneumatiques avec contrôle en boucle fermée pour des conditions constantes pendant la sérigraphie

Support flexible pour écrans : compatible avec des tailles jusqu'à 740 mm (29 pouces) sans adaptateur supplémentaire

Transport de substrats, alignement par caméra, maintien sous vide et sérigraphie automatisée

Changement de produit rapide : temps de configuration inférieur à 3 minutes

► Manuelle et semi-automatique sur pochoir ou écran

EKRA

Screen Printing Technologies

SERIO E2

Sérigraphie semi-automatique pour PCB

La SERIO E2 est une machine de sérigraphie semi-automatique conçue pour la sérigraphie d'une grande variété de supports rigides et souples pour des petites et moyennes productions, R&D et prototypage.



Aire de sérigraphie 370mm x 450mm et 550 x 610mm pour E2 XL

Épaisseur du substrat jusqu'à 30mm

Alignement manuel par 3 vis micrométriques et par 2 caméras

Précision d'alignement +/- 10µm

Utilisation de tout type d'écrans/pochoirs jusqu'à 740mm (29 pouces) sans adaptateur.

SERIO XM

Sérigraphie manuelle pour PCB

La SERIO XM est une machine de sérigraphie manuelle conçue pour la sérigraphie d'une grande variété de supports pour les applications en R&D et prototypage.



Avance de la racle régulière sur guides latéraux

Pression des racles asservie

Outillage de maintien pour matériaux rigide ou souple

Opération simple

Temps de conversion court

HYCON XH STS

Sérigraphie semi-automatique pour applications hybride et wafer

La XH STS semi-automatique est conçue pour la sérigraphie sur écran ou pochoir pour les applications de substrat couche épaisse ou tranche wafer. Flexible, elle est adaptée aux applications hybrides, du semiconducteur ou encore du solaire.



Cadre de sérigraphie monté sur 4 piliers guides pour plus de précision et répétabilité

Zone d'impression jusqu'à 300 x 300 mm.

Système d'alignement optique breveté utilisant la reconnaissance de bord

Opération facile et confortable grâce à l'interface utilisateur SIMPLEX.

2 têtes de sérigraphie indépendantes asservies et auto-compensées

Disponible en version HW STS pour sérigraphie sur tranche wafer

HYCON 2000

Sérigraphie semi-automatique pour wafer

L'HYCON 2000 pour écran et pochoir a été conçue pour la sérigraphie sur tranche wafer. Elle est parfaitement adaptée pour la petite et moyenne série ainsi que le prototypage.



Alignement de précision: ± 10 µm.

Table d'impression motorisée.

Support pour pochoir et écran flexible

Supportage et maintien spécifique du wafer avec système de levage autonome

Diamètre wafers jusqu'à 12 pouces

Options supplémentaires disponibles

▶ Outillages, accessoires et consommables

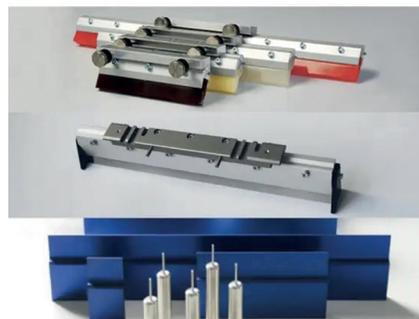
EKRA

Screen Printing Technologies

ACCESSOIRES RACLETTES

Porte raclettes, raclettes métalliques pour sérigraphie

Durant le développement, la sélection et la fabrication de toute la série S10, EKRA a porté une attention particulière sur la qualité et la longévité des produits proposés.



Porte raclettes et raclettes métalliques, polyuréthanes ou diamant

Outillages pour mesure la dureté des polyuréthanes

Accessoires pour la dispense de crème et colle par jetting et vis d'archimède

Supportage de cartes : pions magnétiques, auto-conformant, nid à vide

CONSOMMABLES

Consommables pour sérigraphie PCB

Durant le développement, la sélection et la fabrication de toute la série S10, EKRA a porté une attention particulière sur la qualité et la longévité des produits proposés.



Racles et lames métalliques

Raclettes polyuréthanes

Lames de maintien des PCB

Rouleaux de nettoyage pochoirs haute performance «Puro»

Lingettes de nettoyage saturées «Pure Wipe» et paquets recharge

Lingettes de nettoyage à sec

Gants jetables, spatules pour crème

S10 MOBILE

Servante pour la sérigraphie CMS

Le S10 mobile est un système auxiliaire universel adapté aux opérations quotidiennes autour de la zone sérigraphie. Ce plan mobile de travail et de stockage mobile est remarquable pour sa polyvalence, flexibilité et extensibilité.



Permet un stockage sécurisé et un accès rapide au plus près de la sérigraphie.

Stockage pochoirs et écrans, sur cadre alu ou auto tendeur

Tailles de pochoirs jusqu'à 29 pouces (740 mm)

Stockage racles, rouleaux de tissus de nettoyage, lingettes, crème à braser

Totalement configurable selon besoins du client

S10 MODULAIRE

Armoire de stockage d'écrans et pochoirs de sérigraphie

Le S10 Modulaire est une solution pratique et flexible pour moderniser et sécuriser le stockage des écrans.



Faible encombrement

Armoire munie de deux portes battantes et d'une fermeture sécurisée.

Configurable individuellement pour accueillir des pochoirs avec ou sans cadres

Tailles de pochoirs jusqu'à 29 pouces (740 mm)

Armoires superposables

S10 SELECT

Distributeur de consommables pour la sérigraphie PCB

Le S10 select est un distributeur automatique de consommables, conçu pour conditionner et distribuer de manière traçable la crème à braser, les colles, et autres consommables.



Fourniture de matériel à la demande

Température de stockage régulée

Traçabilité

Distribution en FIFO

Conception flexible, adaptable à différents consommables

Alerte niveau bas du stock

Imprimante d'étiquettes intégrée

INSERTION ET PLACEMENT

► Placement de composants CMS

Panasonic CONNECT

AM100

Plateforme modulaire de placement pour prototypes et faibles productions

La Panasonic AM100 est une machine placement CMS modulaire conçue pour le prototypage et petite série. Sa flexibilité, combinée à des options avancées et l'automatisation des changements de série, optimise la productivité tout en maintenant une haute qualité d'assemblage.



Polyvalence des composants : compatible avec des tailles de composants allant de 0402mm (01005inch) à 150 _ 25mm

Capacité_Feeder : 160 positions 8mm (Feeder Double)

Vitesse de placement : 23 000 CPH (Composants Par Heure) IPC

Précision de placement : tolérance de ± 40 _m pour les petits composants

Prise en charge des bandes, sticks, plateaux

Changement automatique : fonction d'automatisation des changements de configuration

Interface connectée : intégration avec les logiciels PanaCIM et iLNB pour une gestion production centralisée

Efficacité énergétique : faible consommation électrique (2,0 kVA) et compatibilité avec des systèmes multi-voltage

NPM-W2

Plateforme modulaire polyvalente et flexibles pour productions petites à moyennes

La Panasonic NPM-W2 est une plateforme modulaire conçue pour optimiser la productivité et la qualité des lignes SMT. Avec une capacité de placement jusqu'à 84 000 CPH, elle combine flexibilité et précision pour répondre aux besoins des productions complexes.



Grande précision : placement avec une tolérance de $\pm 30 \mu\text{m}$, option $\pm 25 \mu\text{m}$

Largeur des composants de 03015mm à 135 _ 135 mm et jusqu'à 40mm de hauteur

Flexibilité des PCB : supporte des formats allant de 50 _ 50mm à 750 _ 550mm

Capacité_Feeder : 120 positions 8mm (Feeder Double)

Têtes de placement polyvalentes : 4 modèles de têtes (3, 8, 12 ou 16 buses) pour s'adapter à divers besoins

Caméra multi-reconnaissance : inspection avancée pour améliorer la qualité et réduire les erreurs et 3D pour le contrôle de coplanarité

Automatisation des changements : trolley pour changements des feeders et pins de support PCB automatiques

Maintenance automatisée

NPM-GH

Plateforme de placement CMS autonome de haute précision

La NPM-GH de Panasonic est une plateforme avancée conçue pour maximiser l'efficacité et la qualité des lignes CMS. Grâce à des options modulaires, une précision accrue et une intégration intelligente, elle répond aux exigences des productions variées, tout en s'inscrivant dans une vision de fabrication autonome et connectée.



Vitesse de placement élevée : jusqu'à 103 000 CPH en mode haute production

Tolérance jusqu'à $\pm 10 \mu\text{m}$ pour les composants en mode haute précision

Compatibilité étendue : supporte des composants de 0201mm à 150 _ 25mm

Options pour têtes FC16, FC08 et FC03, adaptées à différents besoins de production

Flexibilité des PCB : prend en charge des dimensions de cartes jusqu'à 510 _ 590mm

Maintenance automatisée

Correction automatique

Système APC-5M : contrôle intelligent des processus pour réduire les variations et améliorer l'OEE

Options avancées : feeder AutoLoad, caméras 3D pour une détection précise et un contrôle de coplanarité

NPM-GW

Plateforme de placement CMS autonome, modulaire et flexible

La série NPM G de Panasonic, incluant la NPM-GW et la NPM-GH, révolutionne les lignes CMS avec une précision accrue, une flexibilité optimale et des fonctionnalités avancées. Conçue pour les usines autonomes, elle répond aux besoins des productions électroniques modernes.



Vitesse de placement jusqu'à 104 000 CPH avec les têtes FC16_2

Supporte des dimensions de 50 _ 50mm à 760 _ 687mm

Plage de composants diversifiée : de 0201mm à 150 _ 25mm (longueur et largeur)

Automatisation des opérations de rechargement des composants sans rabotage

Maintenance pro-active et automatisation des changements de série

Intégration au concept «Autonomous Factory» pour lignes autonomes

Contrôle intelligent APC 5M : optimise la production grâce à une surveillance en temps réel des conditions machines

Option de composants larges : prend en charge des composants jusqu'à 135 _ 135 mm et poids max 300gr

► Insertion automatique axiale, radiale et exotique

Panasonic CONNECT

NPM-VF

Insertion THT et placement CMS exotiques

La NPM-VF de Panasonic est une plateforme polyvalente conçue pour le placement de composants CMS exotique et THT. En réduisant le besoin d'intervention humaine, elle améliore la qualité, optimise la productivité.



Insertion rapide : jusqu'à 0,65 s par composant avec une structure à deux têtes pour une productivité accrue

Remplacement de 3 à 5 opérateurs par une seule machine NPM-VF

Flexibilité des composants : compatible avec des composants THT et CMS exotique

Détection et correction automatiques

prise en charge de sticks, plateaux, bandes radiales, bandes axiales et vrac

Configuration modulaire : options d'outils (pinces, buses, chucks) adaptables à chaque type de composant

Système de détection des erreurs d'insertion et récupération automatique

Recharge des sticks et plateaux possible pendant le fonctionnement de la machine

Traçabilité : enregistrement et gestion des données de fabrication

Clinchage : clinchage programmable

AV132

Insertion axiale ultra-rapide

L'AV132 de Panasonic est une machine d'insertion axiale ultra-rapide, idéale pour optimiser la production de composants électroniques. Elle allie précision, efficacité et fiabilité grâce à des fonctionnalités avancées.



Insertion ultra-rapide : vitesse de 0,12s par composant

Insertion Pitch : 5 mm à 26mm

Capacité_Feeder : 40 à 80 Positions

Flexibilité des PCB : prend en charge les PCB jusqu'à 650 mm x 381 mm (option large PCB)

Fiabilité accrue : auto-correction complète pour des insertions précises sur toute la surface du PCB

Opération continue : possibilité de recharger les composants sans arrêter la machine

Connectivité avancée : options de surveillance en temps réel et d'analyse de données pour l'optimisation de la production

Maintenance simplifiée : indications sur les entretiens réguliers via le panneau de contrôle

RG131

Insertion radiale rapide et fiable

La RG131 de Panasonic est une machine d'insertion radiale conçue pour optimiser la productivité des lignes THT. Avec la technologie «Guide Pin» Compatible avec divers composants et tailles de PCB, elle combine haute densité, précision et efficacité.



Vitesse d'insertion élevée : De 0,25 s à 0,6s par composant, même pour les composants de grande taille

Flexibilité des PCB : Prend en charge des PCB jusqu'à 650 mm x 381 mm (option large PCB)

Précision fiable : Fonction d'auto-correction complète pour des insertions précises sur toute la surface du PCB

Flexibilité des pas d'insertion : Supporte plusieurs pas d'insertion (2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm, 10 mm)

Capacité_Feeder : 40 à 80 positions

Opération continue : Système d'alimentation permettant le rechargement des composants sans interruption

Maintenance simplifiée : Indications des opérations et échéances d'entretien directement sur le panneau de contrôle

Options de surveillance et d'édition des programmes hors ligne

RL132

Insertion radiale rapide et compacte

La RL132 de Panasonic est une machine d'insertion radiale rapide et compacte, conçue pour améliorer l'efficacité des lignes THT. Avec la technologie «Lead Chuck» elle combine haute vitesse, précision et efficacité.



Insertion rapide : jusqu'à 0,14s par composant

Capacité_Feeder : 40 à 80 positions

Flexibilité des pas d'insertion : supporte plusieurs pas d'insertion (2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm, 10 mm)

Flexibilité des PCB : prend en charge des PCB jusqu'à 650 mm x 381 mm (option large PCB)

Précision fiable : fonction d'auto-correction complète pour des insertions précises sur toute la surface du PCB

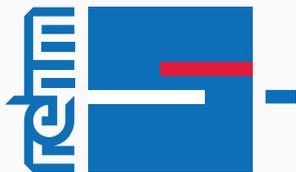
Opération continue : système d'alimentation permettant le rechargement des composants sans interruption

Maintenance simplifiée : indications des opérations et échéances d'entretien directement sur le panneau de contrôle

Connectivité avancée : options de surveillance et d'édition des programmes hors ligne pour une productivité accrue

PROCÉDÉS THERMIQUES

► Convection sous air, azote, ou sous vide



THERMAL SYSTEMS

VISION VXC Four de refusion à convection pour les cartes électroniques

Le vision XC est la solution de choix technico-économique de la sous-traitance électronique. Il est conçu pour répondre sans concession aux besoins de performance thermique et aux volumes de production modérés. Il est doté de deux unités de traitement des flux par condensation qui lui confère une disponibilité accrue et un coût de possession contenu.



- Four 6 à 11 zones de chauffe simple convoyage
- Performance thermique reconnue des fours REHM
- Deux unités de traitement des flux par condensation
- Zone sortie de pic contrôlée en température
- Gestion pilotée de la consommation d'azote disponible
- Surveillance du processus embarqué
- Solution d'interblocage et de traçabilité
- Solution connectée et interfaçable (MES)

VISION VXS Four de refusion à double convoyage pour les cartes électroniques

La gamme Vision XS se distingue par sa conception modulaire. Il est configurable sous différentes variantes de transport simple et double voie, un traitement des flux avec ou sans pyrolyse et dimensionner la productivité du four au plus prêt du besoin client.



- Four 7 à 13 zones de chauffe simple ou double convoyage
- Deux unités de traitement des flux par condensation séparées
- Traitement des flux par pyrolyse disponible
- Zone sortie de pic contrôlée en température
- Gestion pilotée de la consommation d'azote disponible
- Surveillance du processus embarqué
- Solution d'interblocage et de traçabilité
- Solution connectée et interfaçable (MES)

VISION XP + Four de refusion à convection pour la production de masse de cartes électroniques

Le Vision XP + intègre le traitement des flux par pyrolyse et filtrage séparés pour une productivité optimum, un caisson thermique à double isolation pour réduire les consommations électrique et azote. Il est doté de moteurs et capteurs communicants pour un processus asservi et pour une traçabilité et connectivité incomparables.



10t less CO₂ per year

up to 20% less energy

- Stabilité du processus
- Consommation réduite des énergies par construction
- Isolation renforcée pour une perte thermique considérablement réduite.
- Température extérieure du four de 15 ° C supérieure à la température ambiante
- Disponible en convoyeur en simple jusqu'à quadruple voie
- Disponible avec deuxième pyrolyse pour accroître la productivité
- Gestion efficace des résidus et coût de possession réduit grâce à la pyrolyse
- Traçabilité exceptionnelle grâce aux objets connectés

VISION XP+ VAC

Four de refusion sous vide pour les cartes électroniques

Le Vision XP + VAC intègre un caisson de vide qui permet de supprimer les occlusions de gaz et de vides immédiatement après le processus de brasage tandis que la soudure est dans un état parfaitement liquide. Un taux de « void » résiduel de moins de 2% est rendu possible



Trois convoyeurs indépendants avec caisson de vide intégré

Niveau de vide jusqu'à 2 mbar

Fonction vide débrayable

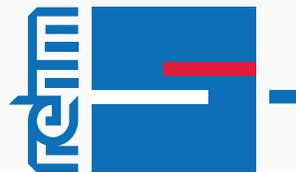
Four préparé pour brasage sous azote

Gestion de flux par unités de pyrolyse et filtrage séparées

Maintenance réduite grâce à la pyrolyse

Excellent refroidissement

► Fours-tunnels de traitement thermique



THERMAL SYSTEMS

FOUR DE SÉCHAGE RDS

Four de séchage pour cartes électroniques vernies

Les fours à passage RDS couvrent un large périmètre applicatifs tel la polymérisation et le séchage des revêtements protecteurs sur les assemblages électroniques.



Rayonnement IR et convection combinée
IR ou UV

Durcissement de séchage maîtrisé

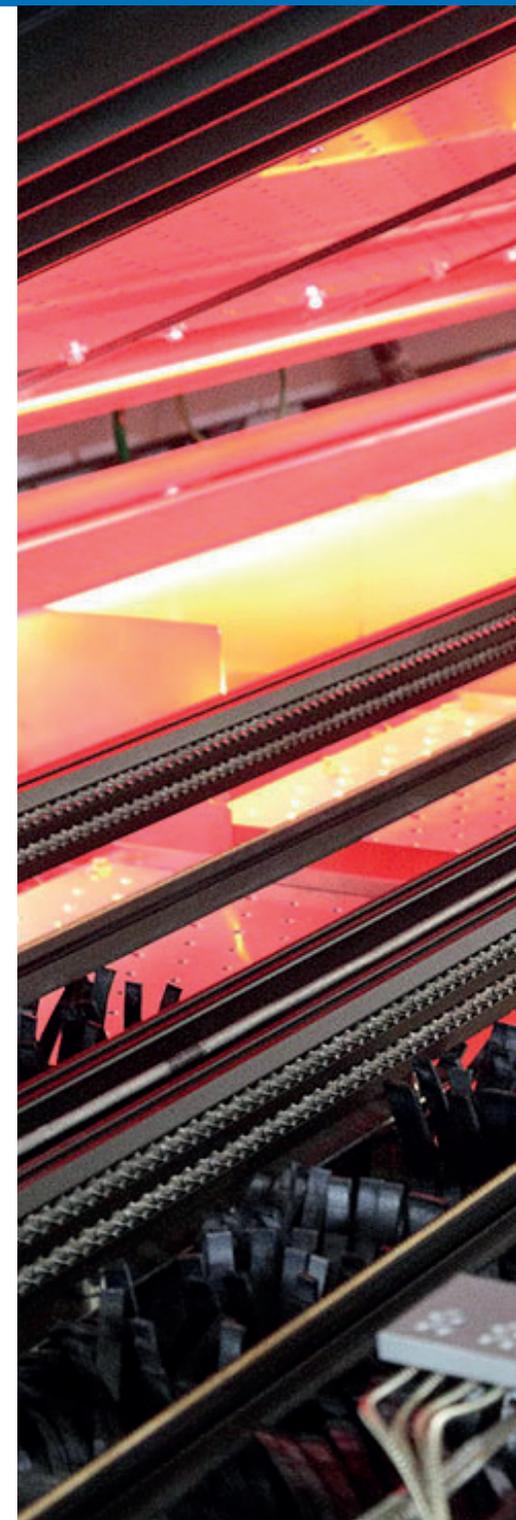
Efficacité énergétique exceptionnelle

Création simple des profils de température

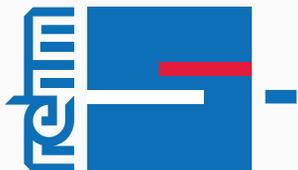
Traçabilité des processus

Entretien minimal

Complément idéal des robots de vernissage sélectifs



▶ Brasage des cartes électroniques sous phase vapeur



THERMAL SYSTEMS

CONDENSO XC Four de refusion par phase vapeur semi-automatique

Le Condenso XC est le modèle compact à chargement frontal de la série Condenso. Il permet la brasure sous vide sur une surface de processus de 500 x 500 mm². Il sera l'équipement idéal pour le brasage de petite et moyenne séries et le prototypage.



- Faible consommation de Galden grâce au principe d'injection
- Processus collectif ou unitaire des produits
- Profile plombé et sans plomb avec le même Galden HS240
- Chargement opérationnel 500 x 500 mm
- Hauteur composant max +60/-20mm ou +80mm/0mm
- Pompe à vide intégrée
- Circuit de filtration et recyclage du Galden
- Faible empreinte au sol de 1850 x 1250 mm

CONDENSO XS SMART Four de refusion par phase vapeur semi-automatique pour cartes de grands formats

Le Condenso XS Smart est doté d'un caisson à vide à fermeture verticale. Le flux de chargement et déchargement des produits est configurable selon un accès frontal ou latéral en îlot. Avec une charge utile de 5Kg sur une surface de processus de 650 x 650mm, il est une solution adaptée au brasage collectif de produits massifs.



- Idéal pour traiter les PCB à forte masse thermique et volumique
- Processus collectif ou unitaire des produits
- Transfert thermique efficace et homogène
- Le procédé d'injection assure un brasage reproductible et sous vide pour un taux de «voids» autour de 2%
- Chargement/déchargement manuel ou automatique
- Charge utile de 5Kg
- Surface de traitement 650x650mm
- Filtration du galden intégrée
- Traçabilité et connectivité MES disponible
- Disponible en chargement en version îlot ou en ligne

CONDENSO XM SMART Four de refusion par phase vapeur en ligne

Le Condenso XM est la version en ligne de la série Condenso Smart. Le flux de passage des produits est traversant depuis le processus amont vers le processus aval. Il permet toutefois un chargement manuel frontal. Avec une charge utile de 5Kg sur une surface de processus de 650 x 650mm, il est une solution adaptée au brasage collectif de produits massifs.



- Idéal pour traiter les PCB à forte masse thermique et volumique
- Processus collectif ou unitaire des produits
- Transfert thermique efficace et homogène
- Le procédé d'injection assure un brasage reproductible et sous vide pour un taux de «voids» autour de 2%
- Flux traversant en ligne
- Souplesse d'utilisation préservée grâce au chargement manuel frontal et convoyeur de retour des porteurs intégré avec une charge utile de 5Kg
- Surface de traitement 650x650mm
- Filtration du galden intégrée
- Traçabilité et connectivité MES disponible
- Disponible en chargement en version îlot ou en ligne

CONDENSO SMART LINE

Four de refusion par phase vapeur pour la production de masse

Le Condenso Smart line est la solution ultime en ligne pour des besoins de production de masse. Il est doté de trois chambres processus destinées à réduire le temps de cycle. Avec une charge utile de 5Kg sur une surface de processus de 650 x 650mm, il est une solution adaptée au brasage collectif de produits massifs.



Solution requise pour la production de masse avec processus collectif des produits
Idéal pour traiter les PCB à forte masse thermique et volumique

Transfert thermique efficace et homogène

Le procédé d'injection assure un brasage reproductible et sous vide pour un taux de «voids» autour de 2%

Flux traversant en ligne

Trois chambres de processus pour réduire le temps de cycle

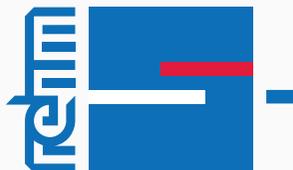
Convoyeur de retour des porteurs intégré dont une charge utile de 5Kg

Surface de traitement 650x650mm

Filtration du galden intégrée

Traçabilité et connectivité MES disponible

► Brasage par conduction avec ou sans vide



THERMAL SYSTEMS

NEXUS

Système de brasage par conduction

Le système de brasage Nexus de Rehm Thermal Systems garantit une soudure sans voids grâce à l'utilisation de la chaleur par contact sous vide. Conçu pour répondre aux exigences des électroniques de puissance et des semi-conducteurs, il offre une qualité optimale pour des productions en petite ou moyenne série, ainsi qu'en laboratoire.



Soudure sans voids

Températures élevées : Opère jusqu'à 400 °C (450 °C en option) pour une large gamme d'applications

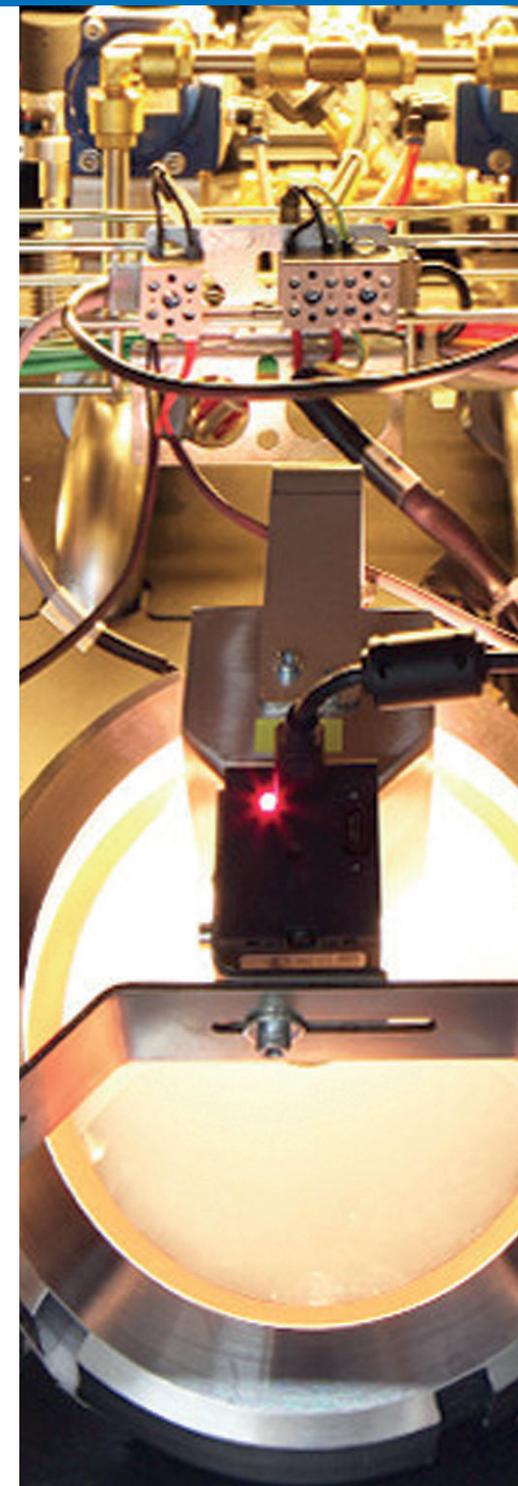
Atmosphère contrôlée : Utilisation de gaz inertes (N2, H2) ou formiques pour une soudure sans oxydation

Précision thermique : Uniformité de température sur la plaque chauffante avec des gradients contrôlés

Flexibilité des processus : Compatible avec des pâtes et préformes avec ou sans flux

Gestion des résidus : Système optionnel pour le nettoyage et la désactivation des résidus de flux

Rapidité de cycle : Chauffage jusqu'à 150 °K/min et refroidissement jusqu'à 180 °K/min



NETTOYAGE ET LAVAGE

► Lavage des pochoirs et écrans de sérigraphie

SYSTRONIC 
SUCCESS TOGETHER

CL420 PCB Machine de nettoyage des écrans de sérigraphie – 2 réservoirs

La CL420 permet le nettoyage et le rinçage par aspersion des pochoirs, racles et PCB en défaut de sérigraphie. Sa cuve process couplée à ses deux réservoirs et filtrations et sa soufflerie chauffante garantissent le lavage, le rinçage et le séchage de vos pochoirs, et PCB de quantité journalière petite et moyenne.



Pour nettoyage écrans/pochoirs, racles de sérigraphie, CI et CI équipé 1ère face

Dimensions pochoirs/écrans jusqu'à 800 x 800 x 40 mm

Lavage/rinçage/séchage automatique

Réservoir de lavage avec résistance de chauffe

Réservoir de rinçage avec mesure de résistance de l'eau DI

Connexion possible avec unité de régénération d'eau DI

Programmation par écran tactile

Système de filtration en boucle fermée

Valve d'extraction d'air

Utilisation simple, rapide et économique, cuve et pompe inox pour durabilité et robustesse

CL410 Machine de nettoyage des écrans de sérigraphie - 1 réservoir

La CL410 permet le nettoyage par aspersion des pochoirs et racles de sérigraphie. Sa cuve process couplée à son réservoir, sa filtration et sa soufflerie chauffante garantissent le lavage et le séchage de vos pochoirs pour de petites quantités journalières.



Pour nettoyage écrans/pochoirs, racles de sérigraphie,

Dimensions pochoirs/écrans jusqu'à 800 x 800 x 40 mm

Lavage/séchage automatique

Programmation par écran tactile

Temps de cycle court

Système de filtration en boucle fermée

Valve d'extraction d'air

Utilisation simple, rapide et économique

Fabrication cuve et pompe inox pour durabilité et robustesse

CL420 MTO Machine de nettoyage des écrans de sérigraphie - 2 machines en 1

La CL420 MTO est la référence du marché dès lors qu'il s'agit de lavage de pochoirs utilisés avec de crèmes plombées et sans plomb et les risques de contamination croisées associées. Elle reprend la construction de la CL420 et est à l'équivalence du fonctionnement de deux CL420 placées cote à cote contrôlée par une seule IHM.



Pour nettoyage écrans/pochoirs, racles de sérigraphie, CI et CI équipé 1ère face

Séparation physique procédé plomb et sans plomb - pas de contamination croisée

2 machines en 1, un contrôleur IHM

Lavage/rinçage/séchage automatique

Connexion possible avec unité de régénération d'eau DI

Programmation par écran tactile

Système de filtration en boucle fermée

Valve d'extraction d'air

Utilisation simple, rapide et économique

Traçabilité intégrée, cuve et pompe inox pour durabilité et robustesse

CL533

Machine de nettoyage des écrans de sérigraphie en ligne

La CL533 est une nouvelle génération de machines de nettoyage multi-chambres autonome. Ce système couvre différentes techniques de nettoyage. Le système de base se compose de chambres de traitement séparées pour le nettoyage, le rinçage et le séchage. Dans cette version, le système peut être utilisé pour le nettoyage des pochoirs, des raclettes, des cartes en défaut de sérigraphie. Le chargement et déchargement des pochoirs est assuré par un bras motorisé.



Système autonome

Construction modulaire

Chambre de nettoyage, de rinçage et de séchage séparée

Nettoyage combiné par pulvérisation sous air, pulvérisation en immersion ou par ultrasons

Traçabilité intégrée

Utilisation de différents produits de nettoyage dans des chambres séparées

Pas de contaminations croisées des crèmes plomb, sans plomb

Extension modulaire de l'autonomie

Fabrication cuve et pompe inox pour durabilité et robustesse

► Lavage des cartes électroniques équipées

SYSTRONIC  [®]
SUCCESS TOGETHER

CL902

Machine de défluxage des cartes électroniques

Le système de nettoyage SYSTRONIC CL902 est le système idéal pour nettoyer vos cartes en défaut de sérigraphie et cartes assemblées. Le système de nettoyage automatique à chambre unique en acier inoxydable pulvérisé via quatre bras de pulvérisation rotatifs dans un circuit fermé. Le système se compose d'un circuit de nettoyage fermé, d'un circuit de rinçage fermé, d'une unité de séchage et d'une pompe de vidange séparée.



Pour lavage/defluxage cartes montées, cartes en défaut de sérigraphie

Lavage, rinçage, séchage intégrés

Compatible avec tous agents de nettoyage aqueux,

Capacité de chargement 500x500x600mm

Lavage et rinçage avec circuit de pompage et filtration indépendants

Résistance de chauffe, agitateur, et mesure de concentration aqueuse intégrables

Mesure de la conductance de l'eau de rinçage

Connexion possible avec unité de régénération d'eau DI

Traçabilité intégrée

Fabrication cuve et pompe inox pour durabilité et robustesse

CL950

Nettoyage en racks des cartes électroniques équipées

Le système de nettoyage SYSTRONIC CL950 est le système idéal pour le nettoyage en racks des cartes en défaut de sérigraphie, des cartes assemblées ou bien encore de laver vos caisses de stockage. Le système de nettoyage automatique à chambre unique en acier inoxydable pulvérisé en circuit fermé sur un outillage adaptable à vos racks.



Grande capacité d'accueil flexible pour les articles à nettoyer

Peu d'espace nécessaire

Taille de la chambre utilisable jusqu'à 780 x 780 x 780mm

Processus multiphase entièrement automatisé

Programmable via un écran tactile

Temps de nettoyage court

Système de filtre fin dans le cycle de nettoyage

Système de nettoyage facile à utiliser, rapide et économique

CL600

Machine de nettoyage en ligne de cartes électroniques équipées ou de DBC

Le système de nettoyage SYSTRONIC CL600 est le système optimal pour votre nettoyage en ligne de cartes électroniques équipées ou de DBC (Die Bonded on Copper)



Le système est personnalisé en fonction de vos besoins.

Le système est commandé par un panneau tactile et une interface graphique conviviale.

C'est le modèle parfait pour les débits très élevés.

► Lavage des pièges à flux et cadres de vagues

SYSTRONIC 
SUCCESS TOGETHER

CL830

Machine de nettoyage de cadres de vague et de pièges à flux

La CL830 est un système de lavage en immersion sous air. Ce processus est particulièrement adapté au lavage des cadres de soudure des filtres condensateurs pièges à flux.



Processus de nettoyage automatique

Efficacité de nettoyage accrue grâce à la recirculation permanente du liquide de nettoyage et le procédé d'immersion et l'effet des bulles d'air

Système compact et peu encombrant

Fonction rinçage optionnelle

Faibles coûts d'investissement

Manipulation facile

Faible effort de maintenance

Version CL831 avec dimensions personnalisables

► Lavage accessoires sérigraphie et pièces mécaniques

SYSTRONIC 
SUCCESS TOGETHER

CL100US

Nettoyage des racles et des outillages

Ce système de nettoyage compact a été spécialement conçu pour le nettoyage des racles et des outillages. 10 vibrateurs assurent l'agitation ultrasonique. En outre, le nettoyage peut être soutenu par une immersion sous pression, qui est dirigée vers les pièces en alternance avec les ultrasons.



Faible volume d'investissement

Peu de besoin d'espace

Taille de la pièce 260 x 560 x 485mm (dimensions supérieures possibles)

Processus entièrement automatisé

Programmable via un écran tactile

Temps de nettoyage court

Système de nettoyage facile à utiliser, rapide et économique

ÉQUIPE TECHNIQUE ACELONIX

L'application

Un service d'ingénieur d'application toujours à votre écoute pour la mise en place et l'accompagnement de vos projets.

Que ce soit pour une mise en route d'un équipement, pour une formation ou encore pour une mise au point d'un process sur vos produits, nous sommes disponibles pour vous aider.

Nous développons des partenariats très importants avec nos fournisseurs pour acquérir un maximum de connaissances et de compétences sur nos services.



DÉTOURAGE

- ▶ Séparation par détourage mécanique

**ASYS
GROUP**

DIVISIO SÉRIE 2000 Dégrappage automatique pour PCB grands formats

La série DIVISIO 2000 est particulièrement adaptée aux productions de grande mixité ou de larges formats. Son plateau rotatif à deux stations de travail permet de traiter simultanément le chargement/déchargement et le détourage de deux produits identiques ou différents



Chargement/déchargement manuel du produit en temps masqué

Table de travail rotative à deux positions. (1 en process, 1 en accès opérateur)

Détourage par fraise ou par disque

Outillage spécifique produits ou par chandelles magnétiques

Précision de détourage de +/- 0,08mm

Système d'aspiration des résidus

Création de programme par importation des données CAO ou apprentissage

Changement automatique d'outil de détourage (2 par machine)

Surface de travail DIVISIO 2000 : 460mm x 360mm (L x l) / Surface de travail DIVISIO 2100 : 460mm x 460mm (L x l) / Surface de travail DIVISIO 2300 : 720mm x 500mm (L x l)

DIVISIO 5100 Dégrappage automatique en ligne sans outillage pour PCB

La DIVISIO 5100 Flexible offre un détourage flexible à grande vitesse sur une large surface de travail. La carte équipée est acheminée sur convoyeur, positionnée dans la machine. Sous le convoyeur une fraise montée sur un système d'axes X/Y/Z assure le fraisage. Les circuits unitaires sont maintenus durant le fraisage par une pince asservie et déposés après séparation sur un tapis, un plateau ou bien vers l'assemblage final.



Détourage par le dessous de la carte équipée

Tête motorisée XYZ et Téta pour la préhension des unitaires

Pince motorisée pour le maintien modulaire des unitaires de différents formats

Changement automatique de l'outil de détourage

Contrôle de processus autonome

Maintenance prédictive

Réalisation de programmes 100% déporté

Création de programme par importation des données OBD++

Format PCB jusqu'à 460mm x 460mm

- ▶ Séparation par détourage laser

**ASYS
GROUP**

POLYPHOS DP 9000 SERIES

Dégrappage par laser

La Polyphos DP 9000 series est une plateforme laser multi-modale. Elle permet la découpe, le perçage, le gravage, l'ablation, le marquage selon les besoins de l'application. Elle est adaptée aux exigences de précision et de répétabilité attendus pour la découpe des différents matériaux PCB (FR, Polyimide etc..) et le micro usinage (Céramique...).



Différentes sources laser disponibles CO2, UV, Vert.

Découpe sur flex et PCB jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur

Micro-usinage sur céramique, singulation LED, découpe de verre

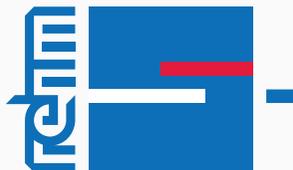
Capabilité process +/- 50µm @ 3sigma sur applications de détournage

Capabilité process <+/- 10µm @ 3sigma sur micro usinage

Surface de travail de 460 x 320mm selon le type

DOSAGE ET DISPENSE

► Dispense et vernissage sélectif



THERMAL SYSTEMS

PROTECTO XC Robot de vernissage sélectif et dispense pour PCB

Le Protecto XC est un système compact et de hautes performances de vernissage. Il est particulièrement adapté aux petites et moyennes séries avec un objectif préservé de maîtrise du processus de vernissage des cartes électroniques.



Processus de vernissage maîtrisé

Robot compact facilement intégrable en ligne ou en îlot

Dimensions max des PCB : LxH : 400 x 450 x 80 mm et jusqu'à 2 laqueurs dans un seul robot

Accessibilité optimum avec buse étroite sur 80mm de hauteur

Une seule valve Stream-Coat® pour un processus de Pulvérisation, dispensing, Jetting

Maintenance facilitée au travers de solutions innovantes

Logiciel moderne avec opération tactile et trackball 3D.

Programmation guidée rapide et intuitive en ligne et hors ligne

Traçabilité et connectivité MES

Le meilleur ratio investissement-performances

PROTECTO XP Robot de vernissage sélectif et dispense pour PCB grands formats

Le Protecto XP est particulièrement adapté aux exigences de précision, stabilité et productivité pour des tâches automatiques de vernissage. Il est conçu pour une programmation intuitive, une bonne maintenabilité et flexibilité.



Applicateur multifonctionnel par jet, dispense, et pulvérisation

Dimensions max. de processus : LxH : 620 x 508 x 100 mm

Jusqu'à 4 laqueurs dans un seul robot

Système d'alignement par caméra

Précision et répétabilité de vernissage

Vernissage tout en un avec les buses brevetées Stream-Coat®

Programmation guidée rapide et intuitive en ligne et hors ligne

Maintenance minimale requise au travers de solutions innovantes

Traçabilité et connectivité MES

► Préparation des résines bi-composants pour l'encapsulation

Atlas Copco

BCF802 Alimentation de cartouche renforcée

Le Boosted Cartridge Feed BCF802 de Atlas Copco est conçu pour alimenter les unités de distribution rapidement. Idéal pour les applications nécessitant des matériaux très visqueux, ce système garantit une production ininterrompue grâce à des cartouches à changement rapide.



Dimensions compactes : largeur 260 mm, profondeur 300 mm, hauteur 800/930 mm

Débit de la pompe à piston par double course : 35 ml

Pression maximale d'alimentation en matériau : 150 bars

Système de décompression intégré pour éviter les pertes de matériau

Panneau de commande multi-touch avec écran capacitif de 10,1 pouces

Interface utilisateur graphique basée sur des widgets

Contrôle assisté par capteur des quantités résiduelles et des pressions de pompe

Surveillance continue des paramètres clés tels que la disponibilité de la machine

Option de test des composants via un scanner ou un capteur de couleur

Interface de visualisation EVIS avec port USB

A90 C Alimentation à partir de cartouches Semco et Euro

Le système d'alimentation en matériaux A90 C de Atlas Copco est idéal pour les cartouches standard Semco ou Euro. Compact et facile à utiliser, il offre une alimentation fiable même pour de petites quantités de matériau.



Design compact et peu encombrant

Fonctionnement avec de l'air comprimé

Surveillance par LED du niveau de remplissage de la cartouche

Fenêtre de visualisation pour vérifier la présence de la cartouche

Remplacement facile des cartouches

Modèles disponibles pour différentes tailles de cartouches Semco (6 oz, 12 oz, 20 oz, 32 oz) et Euro (310 ml)

Système sans interférence pour l'alimentation en petites quantités

Fonction de vidange sous vide pour une alimentation sans bulles (A90 CV)

Réduction de 90 % des déchets de matériau par changement de cartouche (A90 CV)

Douille de docking innovante avec insert filtrant pour le modèle A90 CV

PAILFEED 803 Pompe vide-fût pour matière à viscosité élevée pour l'encapsulation électronique

Le système d'alimentation 803 de Scheugenpflug est conçu pour transporter la matière de moyenne à haute viscosité de manière fiable et propre vers l'unité de distribution. Ce système est idéal pour les applications nécessitant de la matière très visqueuse.



Dimensions compactes : 260 mm de largeur, 300 mm de profondeur, 800/930 mm de hauteur

Débit de pompe à piston par double course : 35 ml

Pression maximale d'alimentation en matériau : 150 bars

Système de décompression intégré pour éviter les pertes de matériau

Panneau de commande multi-touch avec écran capacitif de 10,1 pouces

Contrôle assisté par capteur des quantités résiduelles et des pressions de pompe

Surveillance continue des paramètres clés tels que la disponibilité de la machine

Option de test des composants via un scanner ou un capteur de couleur

Interface de visualisation EVIS avec port USB

PAILFEED ABRASIVE PFA2001

Pompe vide-fût de matière abrasive pour l'encapsulation électronique

Le système d'alimentation PailFeed Abrasive PFA2001 de Scheugenpflug est conçu pour transporter la matière de viscosité moyenne à élevée de manière fiable et propre vers l'unité de distribution. Ce système est idéal pour les applications nécessitant la matière haute-ment abrasive.



Dimensions compactes : largeur 260 mm, profondeur 300 mm, hauteur 800/930 mm

Débit de la pompe à piston par double course : 35 ml

Pression maximale d'alimentation en matériau : 150 bars

Système de décompression intégré pour éviter les pertes de matériau

Panneau de commande multi-touch avec écran capacitif de 10,1 pouces

Contrôle assisté par capteur des quantités résiduelles et des pressions de pompe

Surveillance continue des paramètres clés tels que la disponibilité de la machine

Option de test des composants via un scanner ou un capteur de couleur

Interface de visualisation EVIS avec port USB

LIQUIDPREP LP804

Système pour la préparation des résines d'encapsulation autonivelantes

Le système de préparation et d'alimentation LiquiPrep LP804 de Scheugenpflug est conçu pour une fiabilité maximale dans la préparation et l'alimentation des adhésifs auto-nivelants et des matériaux de potting. Il assure une qualité homogène et sans bulles des matériaux, même pour les viscosités élevées allant jusqu'à 70,000 mPa_s.



Traitement en atmosphère sous vide jusqu'à une pression finale de 2 mbar

Contrôle de la température du réservoir de matériau et de tous les composants d'alimentation

Alimentation continue via une puissante pompe à double membrane

Unité de commande EVIS pour une utilisation simple et une activation rapide des fonctions

Surveillance continue des paramètres du processus

Traitement des matériaux hautement visqueux et abrasifs

Fonction de remplissage par gravité pour les matériaux très visqueux

Maintenance réduite

Mélange et circulation pour dégazage et prévention de la sédimentation

FÛT 200 L

Station de mélange pour fût de 200 L

La station de mélange pour fûts de Scheugenpflug est conçue pour les applications nécessitant une consommation élevée de matériaux. Elle permet de préparer et de tempérer des matériaux de potting homogènes, même après des pauses de production.



Traitement sans bulles de contenants de 200 litres

Évacuation complète des fûts avec une pompe à vide puissante

Fonctionnement sûr grâce à une unité de levage et un contrôle de sécurité à deux mains

Mélange réglable du composé de potting

Contrôle de la température du réservoir de matériau

Surveillance du niveau de remplissage avec deux affichages de statut

Option de potting sous vide jusqu'à 100 mbar

Convient aux médias hautement visqueux jusqu'à 70 000 mPa_s

Alimentation directe du matériau de potting au distributeur (en option)

Prêt pour les médias remplis et abrasifs



► Pompes de dosage pour résines mono et bi-composants

Atlas Copco

DOSPL DPL2001

Dispense optimisée à faible volume

La pompe à faible volume DosPL DPL2001 de Scheugenpflug est conçu pour des applications nécessitant des micro-doses précises, idéales pour les composants électroniques miniaturisés. Il permet une distribution fiable et rapide, même pour les plus petites quantités de matériau.



- Application de volumes minimes allant jusqu'à 0,003 ml pour les matériaux 1C
- Volume maximal de 2 ml pour les matériaux 1C et 4 ml pour les 2C
- Précision de distribution élevée
- Vitesse de distribution flexible
- Surveillance complète du processus
- Système de valve sans déplacement
- Temps de commutation de valve court
- Convient aux matériaux remplis et abrasifs
- Compatible avec le potting, le scellement et la liaison adhésive
- Surveillance continue de la pression de distribution

DOSPL DP2001

Dispense optimisée haute performance

La pompe haute performance DosP DP2001 de Scheugenpflug est conçu pour répondre aux exigences des industries électroniques automobiles, industrielles, médicales et grand public, offrant les plus courts temps de cycle et des qualités de distribution optimales. Ce système est capable de traiter une large gamme de matériaux, y compris les adhésifs très liquides, les scellants et les résines de potting.



- Vitesse de distribution jusqu'à 10 fois supérieure
- Comportement de démarrage-arrêt précis
- Surveillance complète du processus
- Système de valve fiable sans membrane
- Temps de commutation de valve très court
- Puissants moteurs servo pour une transmission de puissance optimale
- Distribution de matériaux monocouches de 0,06 ml à 20 ml
- Distribution de matériaux bicomposants de 0,1 ml à 40 ml
- Contrôle de la pression de distribution
- Ratio de mélange adaptable aux caractéristiques spécifiques de production

DOS P

Doseurs volumétrique à piston

Les doseurs volumétriques à piston Dos P016 / 050 / 100 / 300 / TCA sont des systèmes de dosage volumétriques ultra-précis, conçus pour la préparation des matières 1C et 2C. Les cylindres de dosage parfaitement dimensionnés permettent de distribuer des volumes de matière reproductibles. Pour les matières 2C, le vidage parallèle des deux cylindres dans le tube mélangeur commun crée un rapport de mélange constant à tout moment et donc, une sécurité de processus très élevée.



- Pression parallèle des cylindres permet un rapport de mélange homogène et constant
- Surveillance par capteurs des valves d'entrée et de sortie et du remplissage des cylindres
- Chauffage du tube mélangeur
- Modèles disponibles : P016, P050, P100, P300
- Volume maximal par tir : 35 à 318 ml
- Surveillance par capteur des vannes
- Option de chauffage du mélangeur
- Maintenance simplifiée
- Longue durée de vie
- Surveillance de l'aiguille de distribution par caméra (optionnelle)

DOS P-A

Doseur volumétrique continu à piston

Le distributeur à piston volumétrique Dos P-A de Scheugenpflug est idéal pour l'application rapide de grandes quantités de matériaux. Conçu pour des processus nécessitant des temps de cycle courts, ce système permet un potting ininterrompu grâce à une décharge alternée des cylindres.



Mécanisme de levage double pour une décharge alternée

Ratio de mélange constant

Surveillance par capteur des vannes d'entrée et de sortie

Contrôle de la température avec chauffage du tube mélangeur (en option)

Convient pour les applications atmosphériques et sous vide

Compatible avec des matériaux liquides et hautement visqueux

Capacité à traiter des matériaux remplis et abrasifs

Production ininterrompue

Longue durée de vie

Applications typiques : potting, scellement, liaison adhésive

DOS P-X

Doseur volumétrique à multiples pistons

Les doseurs volumétriques multi-buses de Scheugenpflug sont conçus pour des applications à haut débit nécessitant une grande précision et une efficacité maximale. Idéals pour les industries où les temps de cycle et la quantité de production sont essentiels, ces systèmes de distribution utilisent des unités de distributeur interconnectées fonctionnellement pour garantir une performance exceptionnelle tout en réduisant les coûts énergétiques.



Débit élevé par unité de temps (jusqu'à 48 buses de potting possible)

Mécanisme de levage commun pour une consistance de la quantité et du ratio de mélange

Contrôle individuel des buses pour une flexibilité maximale

Intégration possible dans les applications robotiques

Solution de distribution évolutive

Surveillance par capteurs des vannes d'entrée et de sortie

Température contrôlée avec chauffage du tube mélangeur (en option)

Précision de distribution même sous vide

Consommation d'énergie réduite

► Systèmes de dosage de résines sous pression atmosphérique

Atlas Copco

POSTE DE TRAVAIL MANUEL

Système de dosage de table pour résines d'encapsulation

Les postes de travail manuels sont une solution d'entrée de gamme économique et fiable pour les tâches de potting simples et les petites séries. Ils se composent de modules standardisés de différentes classes de performance. La variante de base comprend une station de préparation et d'alimentation de matière et un système de dosage avec un statif.



Système complet équilibré composé de composants individuels performants

Changement plus simple et plus rapide des composants et des séries

Potting de géométries de composants complexes

Poste de travail avec statif

Commande par le biais de l'alimentation de la matière pour Dos A220, Dos A280, LiquidPrep LP804

DISPENSINGCELL DC803

Robot de dosage multifonction

La cellule de distribution DispensingCell DC803 de Scheugenpflug est conçue pour les applications les plus exigeantes, offrant des performances élevées pour la production en série. Sa conception modulaire et ses nombreuses options d'équipement permettent une configuration flexible et une adaptation rapide aux changements de processus et de tailles de série.



Axes XYZ pour une distribution précise

Conception modulaire pour une planification système adaptée à la demande

Options complètes de surveillance et de contrôle qualité

Interface utilisateur UVIS5 intuitive

Vitesse élevée des axes pour des temps de cycle courts

Mesure de l'aiguille et unité de pesée intégrées

Inspection en temps réel des cordons avec RTVision

Adaptable à différents niveaux d'automatisation

Large gamme d'applications : encapsulation de contours, potting, collage, scellement

Capacité d'intégration et de mise à niveau

CNCELL

Robot de dosage en ligne pour applications de potting et gasketing

La cellule de distribution CNCCell de Scheugenpflug est une solution multifonctionnelle et flexible pour les processus de distribution. Conçue pour des productions de moyenne et grande série, elle offre une modularité et une performance exceptionnelles, garantissant des temps de cycle courts et une qualité de distribution optimale.



Axes XYZ pour une distribution précise des contours

Construction modulaire adaptable à différents niveaux d'automatisation

Large gamme d'équipements système variables

Accès facile via des rideaux lumineux de sécurité ou des systèmes de porte

Interface utilisateur conviviale via la visualisation UVISneo

Mesure de l'aiguille et unité de pesée intégrées pour un contrôle de qualité précis

Interface utilisateur graphique intuitive basée sur des widgets

Inspection en temps réel des cordons avec RTVision

Options complètes de surveillance

Systèmes de dosage sous vide

Atlas Copco

VDS U

Machine semi-automatique pour le potting sous vide et collectif des composants

La flexibilité dans la fabrication électronique est, entre autres, un domaine relevant des systèmes universels qui permettent de réagir rapidement aux changements de produits. Le système de dosage sous vide Universal qui, généralement, dispose de trois axes de déplacement et d'un positionnement automatique du gobelet, est une solution idéale pour la production en série de composants de taille moyenne à grande.



Performance élevée grâce au potting de plusieurs composants par opération de vidée d'air

Réalisation d'une qualité de composants élevée malgré des géométries de pièces compliquées et des programmes de potting complexes

Indispensable pour des composants fiables et ultra-fonctionnels

Système d'axe XYZ avec encodeur

Pompe à vide performante pour une vidée d'air efficace

Options fondamentales de garantie de la qualité

Création intuitive de programme de dosage

Visualisation : UVISneo

VDS P

Machine en ligne pour le potting sous vide et collectif des composants

Le système de distribution sous vide VDS P de Scheugenpflug est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de qualité et de complexité des pièces. Il est idéal pour la production en série de composants nécessitant un potting sans bulles et homogène.



Temps de cycle courts grâce au potting de multiples composants par évacuation

Haute qualité des composants malgré des géométries complexes

Distribution sous vide avec un système d'axes XYZ

Pompe à vide puissante pour une évacuation efficace

Unité de distribution et tubes chauffés

Opération intuitive avec UVIS 5

Solution polyvalente pour divers types de pièces

Compatible avec les résines auto-nivelantes

Indispensable pour les composants de sécurité et hautement fonctionnels

Inspection en temps réel des cordons avec RTVision

▶ Étanchéité et système de dispense de mousse monocomposant

CeraCon

CERAPUR®

Étanchéité par mousse monocomposant

Les matériaux d'étanchéité CeraPUR® sont des élastomères monocomposants sans solvant et à réticulation très rapide. Ils sont moussés mécaniquement, traités à température ambiante dans une atmosphère standard et permettent l'application efficace, écologique et fiable de joints.



Processus de moussage mécanique sans durée de vie en pot, sans rinçage et sans tir d'essai

Structure essentiellement à cellules fermées : étanchéité extrême

Excellente résistance à l'hydrolyse

Très bon comportement de récupération (compression rémanente)

Résistance extrême à la déchirure

Durcissement rapide : temps de cycle inférieur à 2 secondes

Résistance à la température -40° C à 105° C, à court terme jusqu'à 175° C

La dureté peut être adaptée à un large éventail d'applications différentes

Conforme à la directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2)

CERAFLOW®

Systèmes de dosage de mousse monocomposant

Le système d'étanchéité en mousse CeraCon se compose d'un matériau d'étanchéité à un seul composant CeraPUR®, qui est pompé dans la machine CeraFLOW®, où il est mélangé avec de l'air comprimé et déchargé, par exemple, via une valve de distribution guidée par un robot.



Procédé de moussage mécanique sans vie en pot, sans rinçage et sans essai

La douceur de la mousse est réglable en continu

Temps de démarrage courts

Faibles besoins de maintenance

Disponibilité élevée du système grâce à des unités d'échange rapides

Possibilité d'obtenir des perles de très petites dimensions

Pas de déchets dangereux

Dimensions du système (L x P x H) : environ 1 850 x 900 x 1 925 mm

Contrôle automatique intelligent du processus

SYSTÈMES THERMIQUES INDUSTRIELS

► Systèmes thermiques industriels

CeraCon

CERATHERM® BATCH

Armoires chauffantes avec circulation d'air chauffé électriquement

La robustesse et la qualité industrielle de nos armoires chauffantes standardisées permettent de les utiliser également dans des environnements de production difficiles. La porte automatique facilite le chargement et le déchargement. Les fumées des composants volatils peuvent être extraites de l'armoire par des raccords de ventilation et d'extraction. Pour tenir compte des exigences de température et de processus spécifiques au client, nous pouvons construire des modèles individuels.



Utilisable universellement, indépendamment des dimensions du produit

Un système rentable pour le traitement de petites quantités de pièces

La porte automatique facilite le chargement manuel

CERATHERM® TUNNEL

Systèmes de fours continus horizontaux

Les systèmes de fours continus horizontaux de CeraCon ont été développés pour permettre un traitement thermique précis, rentable et automatisé des pièces. Nos systèmes de tunnel peuvent être équipés de différents types de convoyeurs. Grâce à leurs dimensions standardisées et aux composants utilisés, ils peuvent être utilisés pour une variété de produits et de processus d'application. Ils constituent la solution idéale si le temps d'exposition à la température est plutôt court ou si la durée du cycle est plus longue.



Disponibles en version standard

Possibilité de réaliser différents systèmes de convoyage

Une première étape rentable dans les systèmes automatisés

CERATHERM® CATENA NEO ET CATENA PRO

Systèmes de fours verticaux avec chaînes

Les systèmes verticaux de CeraCon utilisent la hauteur disponible de la pièce et économisent ainsi beaucoup d'espace. Des chaînes verticales soulèvent les supports de produits à l'aide de chariots, les prennent de la position d'entrée et les transportent dans le système de traitement thermique. Au sommet du système de four, les pièces sont transportées de l'autre côté et descendent par étapes, avant de ressortir.



Les supports de produits de votre ligne de production peuvent être utilisés directement pour le transport

Individualisation grâce à des packs optionnels et des solutions spéciales personnalisées

Facile à intégrer dans les lignes de production en tant que solution en ligne, en dérivation ou autonome

Extrêmement peu encombrant

Possibilité de répondre à des exigences complexes en matière de processus de chauffage en reliant plusieurs systèmes verticaux

Prix attractifs, délais de livraison courts et grande flexibilité

CERATHERM® STACK

Systèmes de fours avec empilage vertical

Les systèmes d'empilage sont également basés sur le principe vertical des courses ascendantes et descendantes, incluant un mécanisme de transfert des produits d'un côté à l'autre. Les pièces sont toutefois transportées à l'aide d'une technique d'empilage spéciale, qui favorise particulièrement la trempe des pièces plates. Il est possible d'établir différentes zones de température à l'intérieur des parcours individuels. Nos systèmes d'empilage sont également adaptés à une utilisation en salle blanche en standard.



4 - 12 zones de température

Plage de température de chauffage comprise entre 50 °C et 180 °C

Plage de température de refroidissement entre 20 °C et 50 °C

Précision de la température de $\pm 5K$ (précision supérieure en option)

Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 7, en standard

Standardisé et flexible à la fois

Particulièrement utile pour le traitement des produits plats

Surface au sol de 2 160 x 1 410 mm

CERATHERM® MULTILEVEL

Systèmes de fours verticaux et horizontaux

Plusieurs tunnels thermiques horizontaux sont configurés verticalement les uns au-dessus des autres et réunis pour former un système horizontal à plusieurs niveaux. Aux deux extrémités des tunnels se trouvent des ascenseurs ou des robots qui transportent les supports de produits d'un niveau à l'autre. Le transport horizontal à l'intérieur de chaque niveau s'effectue au moyen d'un système de bande transporteuse ou, sur la base d'une abrasion minimale, au moyen d'un système «push-to-move» sous la forme d'un convoyeur à rouleaux. Chaque niveau constitue une zone de température individuelle.



Chaque niveau peut fonctionner de manière autonome

Des versions sur mesure sont possibles (y compris pour une utilisation en salle blanche)

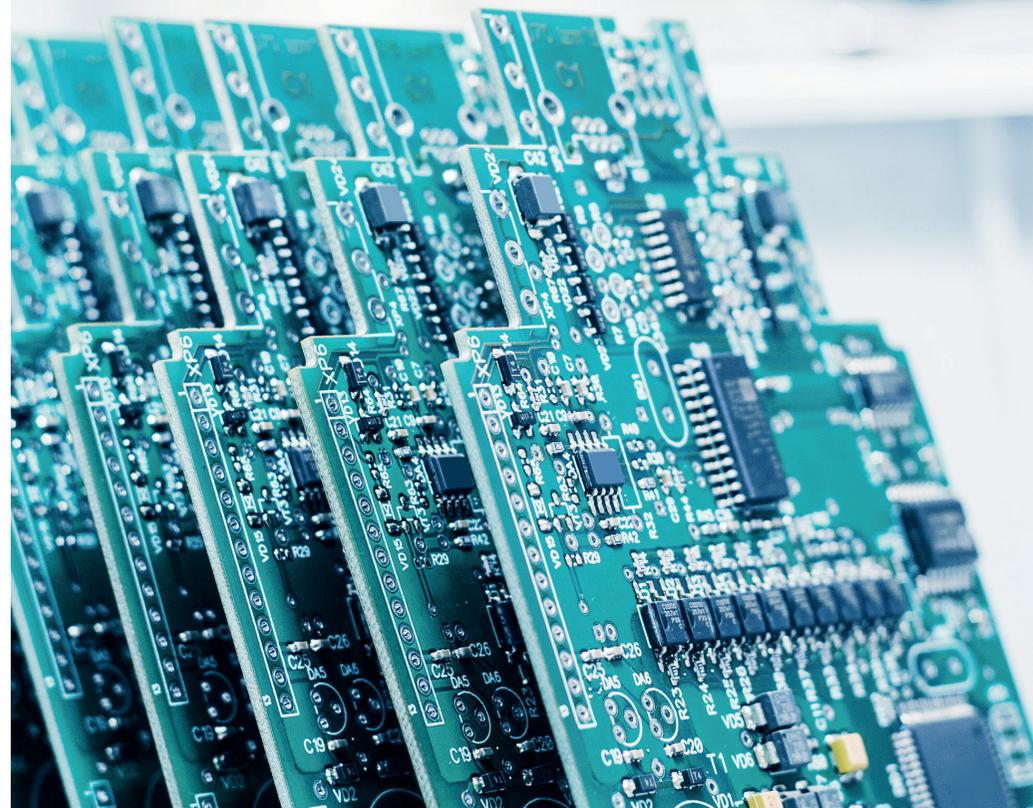
ÉQUIPE TECHNIQUE ACCELONIX

Le benchmarking

Accelonix vous propose des essais grandeur nature sur nos équipements.

Vous venez avec vos produits, dans nos locaux ou chez nos fournisseurs et nous réalisons ensemble les essais souhaités afin de répondre à toutes vos questions techniques.

Cette démarche vous permettra d'appréhender au mieux l'équipement et vous projettera dans une utilisation future sur votre site.



RÉPARATION BGA, QFN...

► Station de réparation BGA, QFN...



IR-E1 EVOLUTION Station de réparation SMD/ BGA compact

L'IR-E1 Evolution est une station de réparation abordable et efficace, conçue pour des opérations précises sur des PCB jusqu'à 12"/300 mm. Idéale pour les réparations d'entrée de gamme, elle intègre un chauffage infrarouge focalisé, un préchauffage à quartz et un support de travail monté sur banc, assurant un excellent contrôle thermique et une manipulation facilitée.



Chauffage avancé à infrarouge focalisé sur composant

Préchauffage PCB infrarouge à quartz

Support de travail monté sur banc

Détection de température en boucle fermée, sans contact

Contrôle thermique automatique avancé

Sonde d'aspiration manuelle intégrée

IR-E2 EVOLUTION Station de réparation BGA/ SMT pour PCB petits/moyens

L'IR-E2 Evolution est une station de réparation compacte et efficace, conçue pour les PCB de petite et moyenne taille (jusqu'à 12"/300 mm). Équipée d'un chauffage infrarouge focalisé et d'un préchauffage à double zone, elle assure des réparations précises pour tous types de composants BGA et SMT. Grâce à son contrôle thermique avancé et à ses outils de manipulation professionnels, elle est idéale pour des opérations fiables et rapides.



Chauffage avancé à infrarouge focalisé sur composant

Préchauffage PCB infrarouge à quartz, avec double zone

Capacité PCB jusqu'à 12"/300 mm

Système de prisme à faisceau divisé pour une visualisation simultanée des PCB et composants

Pick-and-place précis des composants jusqu'à 10 µm

Manipulation professionnelle des PCB

Support intégré pour composants et application de flux

Détection de température en boucle fermée, sans contact

Contrôle thermique automatique avancé

IR-E3 EVOLUTION Station de réparation IR pour tous les composants BGA/ SMT

L'IR-E3 Evolution est une station de réparation compacte et performante, idéale pour les PCB de taille moyenne (jusqu'à 18"/450 mm). Dotée d'un chauffage infrarouge focalisé et d'un préchauffage multi-zones, elle garantit des opérations de dessoudage, positionnement et resoudage précises pour tous types de composants BGA et SMT.



Chauffage avancé à infrarouge focalisé sur composant

Préchauffage PCB infrarouge à quartz, jusqu'à 3 zones

Système de prisme à faisceau divisé pour visualisation simultanée des PCB et composants

Pick-and-place de composants avec précision jusqu'à 10 µm

Manipulation précise des PCB

Support pour composants et application de flux intégré

Détection de température en boucle fermée, sans contact

Contrôle thermique automatique avancé

Caméra d'observation du processus de refusion

Refroidissement PCB à air forcé

IR-E6 EVOLUTION

Station de réparation BGA/ SMT pour PCB XL

L'IR-E6 Evolution est une station de réparation conçue pour les PCB de grande taille (jusqu'à 24x620 mm). Elle utilise un chauffage infrarouge focalisé et un préchauffage multi-zones pour dessouder, positionner et resouder tous types de composants SMD. Son contrôle thermique précis et ses fonctionnalités automatisées garantissent efficacité et fiabilité pour les applications BGA, QFN, LED et plus encore.



Chauffage avancé à infrarouge focalisé sur composant, monté sur portique

Préchauffage PCB à quartz infrarouge, avec 3 zones indépendantes

Capacité PCB jusqu'à 620 mm (24")

Système de prisme à faisceau divisé pour une visualisation simultanée du PCB et des composants

Précision de pick-and-place des composants jusqu'à 10 µm

Manipulation précise des PCB

Support pour composants et application de flux intégré

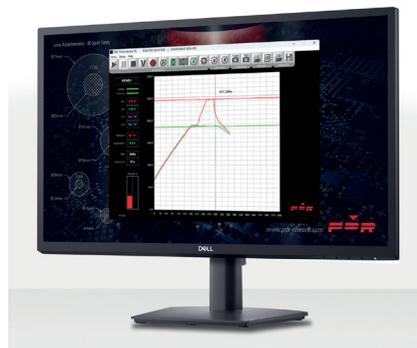
Détection de température sans contact, en boucle fermée

Contrôle thermique automatique avancé du processus

THERMOACTIVE SOFTWARE

Logiciel accessible pour la réparation BGA

Découvrez une précision et une efficacité inégalées dans vos processus de réparation BGA grâce au logiciel ThermoActive V8 de PDR Rework. Conçu pour une gestion thermique avancée, ce logiciel assure des réparations BGA/SMD impeccables grâce à des fonctionnalités innovantes et adaptées à vos besoins.



Profilage automatique révolutionné

Contrôle thermique avancé

Interface intuitive

Surveillance thermique en temps réel et en boucle fermée

Journalisation complète des données

Efficacité accrue

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES

► Plateforme de gestion

ASYS GROUP

SYNAPTICA OS

Plateforme de gestion pour la production électronique

Synaptica OS d'ASYS est une plateforme complète de gestion des opérations de fabrication (MOM). Elle centralise le contrôle des machines, optimise les flux de production et intègre des solutions avancées pour la logistique des matériaux. Idéale pour l'industrie 4.0, elle améliore l'efficacité, la traçabilité et la flexibilité des usines électroniques.



Gestion des équipements

Surveillance des performances : analyse en temps réel de l'OEE

Gestion intelligente des tâches

Caméra embarquée : Surveillance en direct des processus critiques avec analyse vidéo des erreurs

Communication simplifiée

Support du standard IPC CFX : connectivité verticale facilitée pour l'intégration des machines dans l'usine intelligente

Planification des commandes : visualisation Gantt pour une gestion fluide et simulation des scénarios de production

Approvisionnement synchronisé : contrôle automatisé des flux de matière

Affichage des informations d'état ou les valeurs mesurées, selon les machines

► Puces et fils (Bonding)

PARMI

XCEED MICRO Inspection automatique pour les semiconducteurs

Xceed MICRO est une machine de 2D et 3D AOI précise et à grande vitesse. Il est optimisé pour les inspections requises dans les processus d'assemblage de PCB, lead-frame, FC, SiP les procédés d'assemblage tels que die attach, cu clip attach, underfill, solder paste et ball attach. «Xceed MICRO» offre une capacité d'inspection 2D précise tout en effectuant des inspections 3D à haute vitesse (hauteur, inclinaison, levage et volume) avec son faisceau laser hautement focalisé. En outre, 'Xceed MICRO' est la seule machine capable d'inspecter simultanément des matières étrangères / la contamination et le flambage de la surface du « Die », « lead Frame » et des PCB.



Balayage laser extrêmement rapide

Double laser hautement focalisé pour la génération de données 3D

Le laser 3D peut inspecter des surfaces très réfléchissantes (bare die, IPD, die attach, and underfill fillet)

Large bande passante sur une large gamme de couleurs, de rugosités et de matériaux

Taux de faux défauts quasiment nul

CRÈME À BRASER (SPI)

► SPI 3D

PARMI

SIGMAX SPI 3D

Doté d'une technologie de mesure innovante couplée à un temps de cycle le plus rapide de l'industrie et d'outils de diagnostic procédés exclusif, la SIGMA X maximise votre retour sur investissement et votre rentabilité en apportant des réponses à l'amélioration de la qualité de sérigraphie et du rendement de la ligne de fabrication CMS.



Technologie exclusive de mesure par triangulation - élimine les zones d'ombre

Mesure de hauteur, surface, volume, offset, et court circuit pour tous types de pâtes à braser, mesure déformation et élongation PCB

La plus haute cadence de l'industrie avec une vitesse d'inspection de 100cm²/sec @10X10µm, une mesure en temps réel et un accès immédiat aux résultats

Reprise ou ajout pâte à braser ou dépose de points de colle par valve de Jetting

Surface de travail X,Y de 480 x 350 mm sur modèle SIGMA X Orange STD

Surface de travail X,Y de 580 x 510 mm sur modèle SIGMA X Orange LARGE

Disponible en convoyeur 3 segments et convoyeur double voie (dual lane)

INSPECTION CARTES ÉQUIPÉES (AOI)

▶ 3D AOI

PARMI

XCEED NEW GENERATION

AOI 3D avec IA

Cette nouvelle plateforme est basée sur une technologie exclusive de triangulation optique utilisant deux lasers. Cette technologie secondée par un capteur 3D de texture des couleurs innovant fournit un principe d'inspection 3D intelligent, pour de résultats justes, indépendants de la couleur, de la surface de vos cartes électroniques et qui assure un très faible nombre de faux défauts. Avec sa nouvelle fonctionnalité «AI Auto Teaching» vous gagnerez jusqu'à 90% de temps de développement.



Technologie adaptée à l'analyse Pre et Post brasage et analyse 100% 3D des assemblages CMS

Inspection position et hauteur broches connecteurs Press Fit

Inspection des composants traversants THT et soudures vague

Taux de faux défaut extrêmement faible grâce à la vraie détection de forme 3D

Détection des défauts sur les composants, les brasures, les corps étranger et contamination et déformation du PCB

Importation des Gerber et CAD

Différentes surfaces de travail disponibles jusqu'à LxI : 810 x 610mm et 1200 x 450mm pour les PCB LED

AI Auto Teaching jusqu'à 90% de gain de temps de développement

XCEED MP 3D AOI + 3D SPI

Une nouvelle ère de machine d'inspection 3D avec cette plateforme AOI 3D Xceed qui excelle dans l'inspection AOI 3D Pré et Post brasage et qui aujourd'hui est configurable en version multifonctions pour l'inspection de la crème à braser SPI, des composants et brasures AOI, des fluides cohésifs (époxy, underfill), à l'inspection du vernissage sélectif et à la détection de corps étrangers et des contaminations.



Technologie adaptée à l'analyse Pre et Post brasage et analyse 100% 3D

Inspections possibles : SPI et AOI 3D, inspection des fluides époxy, underfill, vernissage sélectif, détection de corps étrangers et des contaminations

Combinaisons configurables selon vos besoins et vos applications

Un seul cœur Logiciel AOIworks TM compatible avec l'ensemble de la gamme. Maximisez votre flexibilité et optimiser vos coûts en ressource humaine et formation

ÉQUIPE TECHNIQUE ACCELONIX

Le SAV

Nos techniciens répondront à toutes vos urgences grâce à :

- Un service hotline disponible les jours ouvrés de 8h00 à 18h00 pour prendre rapidement en charge vos demandes.
- Un service back-office pour la prise en compte de vos demandes de pièces.
- Une équipe d'intervention sur site.

Vous pouvez contacter le SAV par courriel à :
support@accelonix.fr

ou par téléphone au :
02 32 35 64 84

Accelonix

► Vernis 2D et 3D

PARMI

modus

high-tech electronics GmbH

PCI 100 Inspection haute résolution des vernis

Le PCI 100 est un système AOI haute vitesse pour l'inspection des vernis, mesurant la couverture et l'épaisseur. Il détecte les bulles et contaminants grâce à un capteur laser et une unité de vision innovante, offrant précision et rapidité en un seul scan.



- Inspection de la couverture, des contaminations et des bulles sur les revêtements
- Mesure de l'épaisseur du vernissage sur PCB et des composants avec capteur laser
- Inspection sur composants hauts avec mouvement Z-axis
- Mesure précise de l'épaisseur des vernis
- Caméra haute résolution avec une résolution de pixels de 16,7_μm
- Éclairage LED UV pour inspection et LED blanche pour détection de bulles
- Distance de travail de l'unité de vision jusqu'à 80mm depuis la surface PCB
- Acquisition simultanée des images avec éclairage LED UV et blanc
- Programmation simplifiée via désignation des zones de vernissage sur l'image scannée
- Fonction de masquage automatique des vias pour accélérer la programmation

AOI 1200-IDA-UV Inspection des vernis en ligne simple ou double face

L'inspection automatique modus AOI assure l'examen rapide et complet de toutes les surfaces vernies en simple ou double face. La combinaison de l'éclairage multi-couleur LED, éclairage UV et le scanner couleur à haute résolution permet une inspection claire. Grâce à la technique d'analyse complète de l'imagerie, la détection à part entière est assurée.



- Analyse par zone de vernissage (région)
- Inspection automatique en ligne simple ou double face
- Scanner couleur à haute résolution
- Reconnaissance de DMC / code à barres intégrée
- Vitesse d'analyse de 25mm/Sec
- Solution économique

1200-DS-UV Inspection vernis hors ligne simple ou double face

La MLD1200-DS est un appareil hors ligne d'inspection AOI double face. Elle a deux scanners d'image éclairés par plusieurs LED et un éclairage UV pour l'inspection Vernis simple et double face.



- Inspection simple ou double faces simultanées
- Inspection pâte à braser (SPI)
- Inspection composants avant et après four (AOI)
- Inspection Vernis
- Solution 2D économique

► Inspection THT

PARMI

modus

high-tech electronics GmbH

1200-DS Inspection AOI double face

La MLD1200-DS est un appareil hors ligne d'inspection AOI double face. Elle a deux scanners d'image éclairés par plusieurs LED et un éclairage UV pour l'inspection Vernis simple et double face.



Inspection simple ou double faces simultanées

Inspection pâte à braser (SPI)

Inspection composants avant et après four (AOI)

Inspection Vernis

Solution 2D économique

AOI 1200-IDA Inspection AOI 2D en ligne

L'inspection automatique modus AOI assure l'examen rapide et complet de toutes les surfaces. La combinaison de l'éclairage multi-couleur LED et le scanner couleur à haute résolution permet une inspection claire. Grâce à la technique d'analyse complète de l'imagerie, la détection à part entière est assurée.



Analyse des composants en AOI 2D en ligne

Inspection automatique en ligne simple ou double face

Scanner couleur à haute résolution

Reconnaissance de DMC / code à barres intégrée

Vitesse d'analyse de 25mm/Sec

Solution économique

XCEED BSI Inspection 3D des composants traversants

Xceed BSI est l'une des dernières innovations PARMi pour cette plateforme Xceed AOI 3D. La tête d'inspection est placée sur la partie basse de la machine. Les soudures des composants traversants peuvent être inspectées sans que le PCB ne soit retourné au préalable. La Xceed BSI peut être utilisée avant vague pour détecter la position de broches des composants et après vague pour les soudures.



Spécialisée pour inspecter les composants traversants (THT) et les broches

Adaptée à l'inspection pré vague et post vague

Tête de mesure placée sur la partie basse de la machine (Bottom Side Inspection). Pas de retournement du PCB.

Inspection précise et rapide de tous types de broches, des non-conformités des soudures, des court-circuits

Les composants CMS peuvent être aussi inspectés

MCS10 Inspection hors ligne par caméra

L'inspection optique avec ce système de caméra autonome permet une utilisation peu coûteuse et flexible. La haute définition (jusqu'à 42 mégapixels) est contrôlée et analysée à l'aide de l'application AOI Modus pour PC.



Contrôle d'inspection multiple pour vérifier l'intégrité de l'assemblage mécanique, présence, emplacement, positionnement des connecteurs, étiquettes adhésives, fixation et lecture des codes à barres ou Data-Matrix.

Système caméra jusqu'à 42 Mpix

Combinaison possible de plusieurs caméras pour une plus grande flexibilité et une plus grande résolution d'inspection

MCS42-SEL-AL Systèmes d'inspection et d'assistance à l'insertion de composants traversants par Caméra

Le MCS42 est un système AOI basé sur une caméra de 42 mégapixels, permettant une inspection en ligne flexible et économique des processus de production.



Les tests typiques sont : l'assemblage mécanique, la présence, l'emplacement et l'orientation des composants, des étiquettes, des fixations, la lecture des codes à barres et des codes Datamatrix et l'inspection avant ou après Vague des composants traversants

Caméra : C42 Résolution 42 mégapixels (autres résolutions disponibles)

Source de lumière : aucune unité d'éclairage externe n'est nécessaire

Objectif : 1: 1,4 - 25,5 mm, autres objectifs en option

Plage de fonctionnement avec objectif standard : plage de fonctionnement jusqu'à 420 mm x 300 mm [16,52 x 11,80 pouces et distance minimale par rapport à la caméra 280 mm [11,02 pouces]

Vitesse de test : acquisition d'images, y compris l'analyse (4 secondes)

Existe en version en ligne à positionner sur un convoyeur

INSPECTION DES PCB PAR RAYONS X

► Inspection manuelle 2D/3D des PCB par Rayons X

comet yxlon

COUGAR EVO Système compact d'inspection 3D par rayons X

Le système d'inspection Cougar EVO offre une solution compacte et efficace permettant d'effectuer des tâches d'inspection 2D-3D par Rayons X rapidement et sans effort. Ce système a été conçu pour s'intégrer parfaitement dans l'industrie SMT et des semi-conducteurs ainsi que dans les laboratoires, le tout sur seulement un mètre carré.



Inspections fiables, rapides et répétables

Filtres dynamiques faciles à utiliser : Comme le eHDR

Meilleure laminographie : visualisation détaillée en 3D

Kit de réduction de dose et mode détecteur à faible dose : minimisant l'exposition aux rayons X.

Empreinte au sol la plus petite du marché

Inspection SMT et semi-conducteurs : Adaptée aux inspections de PCB, BTC, BGA, LGA, QFN/QFP, THT, IGBT, LED, MEMS, MOEMS...

Détecteurs à panneau plat de grande taille : Champ de vision jusqu'à 50% plus large

Communication directe avec les systèmes d'inspection AOI / AXI en ligne.

CHEETAH EVO

Inspection 3D par rayons X hautes performances

La Cheetah EVO représente le choix judicieux pour répondre aux exigences de qualité dans l'inspection par rayons X 3D. Elle permet une inspection efficace et fiable dans l'industrie SMT et des semi-conducteurs, ainsi que dans les laboratoires, offrant des inspections fiables, rapides et répétables, manuellement ou automatiquement.



Calcul automatique des voids avec VoidInspect

Filtres dynamiques faciles à utiliser : Comme le eHDR, pour une amélioration de l'image.

Meilleure laminographie : visualisation détaillée en 3D

Kit de réduction de dose : Surveillance de la dose et mode détecteur à faible dose pour les composants sensibles.

Tube à rayons X refroidi par eau en option

Capacité de charge élevée en option (< 20 kg)

Inspection SMT et semi-conducteurs : Adaptée aux inspections de PCB, BTC, BGA, LGA, QFN/QFP, THT, IGBT, LED, MEMS, MOEMS...

Communication directe avec les systèmes d'inspection AOI / AXI en ligne.

Détecteurs à panneau plat de grande taille : Offrant jusqu'à 50% plus large

COMPTAGE DES COMPOSANTS

▶ Comptage par rayons-X



XRH COUNT

Comptage des composants CMS par rayons X

VCcount a rendu le comptage des composants électroniques plus rapide, fiable et économique avec le compteur sans contact XRHCount. Contrairement aux compteuses manuelles, il détecte automatiquement les codes-barres et met à jour les stocks dans l'ERP, améliorant ainsi la productivité.



Écran tactile et Interface utilisateur intuitive

Certifié NFC74100 suivant les normes machine à Rayon X françaises

Tiroir automatique

Impression d'étiquettes automatisée

Position de travail ergonomique pour l'opérateur

Prise en charge des composants sur bobines, tubes ou autres conditionnements

Reconnaissance automatique du type de composant

Comptage sans contact rapide et précis (moyenne de 8.5 s par bobine) des composants CMS par rayons X (2s par bobine avec l'option Quad Count)

Compatibilité avec les principaux logiciels de gestion des stocks

Faible empreinte au sol : 1.25m x 0.85m

XRH COUNT INLINE

Comptage des composants CMS par rayons X en ligne

Le XRHCount inline est un compteur de composants par rayons-X intégré aux lignes de production, offrant un chargement et déchargement automatisés. Il utilise l'analyse des mégadonnées et l'IA pour la maintenance prédictive et la gestion des systèmes.



Intégration à l'usine intelligente

Capacités de maintenance prédictive

Suite de statistiques et de maintenance

Surveillance complète du système : Suit des valeurs clés telles que les heures d'utilisation du tube à rayons X, les défauts de barrières lumineuses, les urgences, les cycles de tiroirs et les mises à jour logicielles pour une maintenance préventive

Fonctionnement automatisé : Capable de chargement et de déchargement automatiques, s'intégrant parfaitement aux lignes de production

Suivi et analyse des données : Surveille divers indicateurs opérationnels pour faciliter la maintenance préventive et l'optimisation des performances du système

Communication de données en temps réel

Dimensions du système : 830 x 660 x 2250 mm et temps de cycle de 10 sec./bobine

TEST ÉLECTRIQUE

► Testeurs à sondes mobiles



APT 1400F Testeur à sondes mobiles simple face Takaya

Le TAKAYA APT-1400F représente la nouvelle génération de systèmes de test à sonde mobile (manuel ou en ligne avec convoyeur intégré), offrant des performances sans précédent en termes de vitesse de test, de précision de positionnement et de couverture de test. Il a été spécialement conçu pour le test de cartes à circuits complexes et de grandes quantités. L'APT-1400F dispose de 6 sondes mobiles, dont 2 sondes verticales qui permettent d'accéder à des points de contact jusqu'alors inatteignables. Le maintien des cartes dans la zone de test est assuré par un système de clamping ajustable faisant office d'outillage universel de maintien des cartes quelque soit la forme du PCB.



- Test de court-circuit électrique
- Test de circuits ouverts
- Test capacitif avec sondes Open Checker
- Test électrique des composants analogiques de la carte
- Mise sous tension et test fonctionnels
- Test Boundary Scan
- Test d'analyse de signature
- Test vision
- Test des couleurs de LED

APT 1600FD Testeur à sondes mobiles double face Takaya

La série APT-1600FD est un système de test à sonde mobile double face qui déploie les sondes mobiles des deux côtés d'une carte électronique. Le testeur existe en version Manuel ou en ligne avec convoyeur intégré et configurable jusqu'à 10 sondes électriques mobiles. Grâce au contact de sondage simultané des deux côtés, la série APT-1600FD peut contribuer à une augmentation notable de la couverture de test dans le plus court laps de temps possible. Le maintien des cartes dans la zone de test est assuré par un système de clamping ajustable faisant office d'outillage universel de maintien des cartes quel que soit la forme du PCB.



- Test de court-circuit électrique
- Test de circuits ouverts
- Test capacitif avec sondes Open Checker
- Test électrique des composants analogiques de la carte
- Mise sous tension et test fonctionnels
- Test Boundary Scan
- Test d'analyse de signature
- Test vision grâce à 2 caméras embarquées
- Test des couleurs de LED

APT-2400F Testeur à sondes mobiles simple face

Les testeurs Takaya APT-2400F offrent des solutions innovantes pour l'inspection des circuits imprimés miniaturisés, garantissant une détection précise des défauts, même dans les environnements complexes. Ces systèmes modulaires s'adaptent aux besoins de prototypage, production et analyse de défaillances.



Système 4 têtes, 6 sondes mobiles : Accès à des points complexes et détection optimisée

Technologie IC-OPEN : Détection avancée des défauts de soudure IC et BGA

Zero-Impact Probe Control : Réduction des contraintes sur les PCB avec un contrôle précis des sondes

Inspection 3D et vision haute résolution : Analyse précise et cartographie en 3D

Capteur de température intégré : Mesure fiable pour composants sensibles

Capteur couleur LED : Identification précise des nuances lumineuses

Nettoyage automatique des sondes : Réduction des erreurs et tests fiables

Prêt pour l'industrie 4.0 : Intégration fluide avec les réseaux MES

Test électrique avancé : In-circuit, fonctionnel, et analyse des courants de fuite

APT-2600FD

Testeur à sondes mobiles double face

Le Takaya APT-2600FD combine des tests simultanés double-face et des technologies avancées pour optimiser l'inspection des PCB assemblés. Idéal pour la production et le prototypage, il garantit une couverture de test maximale tout en réduisant les coûts.



Test double-face simultané : Jusqu'à 6 sondes sur le dessus et 4 en dessous

Technologie IC-OPEN : Détection avancée des défauts de soudure IC et BGA

Zero-Impact Probe Control : Réduction des contraintes sur les PCB avec un contrôle précis des sondes

Inspection 3D et vision haute résolution : Analyse en profondeur et lecture de marquages complexes

Capteur de température intégré : Détection des défaillances des semi-conducteurs

Capteur couleur LED : Inspection stable et précise des nuances lumineuses

Nettoyage automatique des sondes : Tests fiables grâce à l'élimination des résidus

Prêt pour l'industrie 4.0 : Intégration réseau fluide et suivi rapide des défauts

Mesure de hauteur des composants : Détection des pièces mal positionnées ou des déformations de PCB

► Testeur lit à clous

TERADYNE

NANO TEST AUTOMATION

Testeur ICT compact en ligne

Nano Test Automation de Teradyne est une solution de test automatisée polyvalente et accessible pour les lignes de production moyennes à faibles avec une grande diversité de produits. Il intègre la performance de la série TestStation dans un format compact, révolutionnant les tests dans divers secteurs. Conçu pour les exigences modernes, il offre une interface innovante et un kit de fixation imbriqué, le rendant tourné vers l'avenir..



Nano Test Automation offre une flexibilité inégalée, adaptée à une gamme variée de produits et d'échelles de production

Le système réduit les coûts tout en maintenant une haute performance, sans interface sous vide

Nano est configurable et évolutif, prêt à répondre aux demandes changeantes du marché

Orientation vers la durabilité : Nano favorise l'efficacité énergétique et l'éco-responsabilité

Modèles Nano 101e et Nano 51e : Ces modèles offrent respectivement jusqu'à 2 560 et 1 280 points de test maximum, avec des capacités de test avancées complètes

TESTSTATION LHS

Testeur ICT compact

Le système de test In circuit TestStation LHS est une version évolutive à moindre coût, à faible encombrement de Teradyne. Compatible avec les adaptateurs TestStation LH existants. La TestStation LH intègre la technologie de protection SafeTest de Teradyne pour des tests In Situ sous tension précis, fiables et sûrs.



Disponible en version manuel ou bien en version ligne avec convoyeur et passeur de cartes

Taux de faux défaut très faible

Technique fiable et répétitive en production

Assurance d'un debug plus rapide ainsi qu'une assurance qualité pour le test

Accepte en option des instruments PXI qui pourront utiliser le matricage pour accéder à l'ensemble des points de test de la machine

Configurable entre 128 et 4096 points de test

TESTSTATION LH Testeur ICT compact

Le TestStation LH est le plus compact et le plus répandu des testeurs de la gamme, il utilise la technologie SafeTest (brevet TERADYNE) qui permet la surveillance en temps réel de l'ensemble des courants et tensions injectés sur la carte en test.



Disponible en version manuel ou bien en version ligne avec convoyeur et passeur de cartes

Taux de faux défaut très faible

Technique fiable et répétitive en production

Assurance d'un debug plus rapide ainsi qu'une assurance qualité pour le test

Accepte en option des instruments PXI qui pourront utiliser le matricage pour accéder à l'ensemble des points de test de la machine (Jusqu'à 3680 points).

TESTSTATION MULTI-SITE INLINE

Testeur ICT en ligne

Le Testation Inline Handler est un système de test en ligne intégrant les dernières générations de testeur Multi-têtes pour du test en parallèle de plusieurs produits.



Système Multitêtes pour le test en parallèle

Prêt pour intégration en ligne

Temps de Test 2 à 4 fois plus rapide que sur un système conventionnel

Prend en charge jusqu'à 5 emplacements de carte par Tête de test, configurables uniquement, à broches numériques pures, hybrides ou à haute densité

Jusqu'à 2560 points par tête de test

TESTSTATION MULTI-SITE OFFLINE

Testeur ICT double tête hors ligne

Le Testation Multi-Site Offline est un système de test hors ligne intégrant les dernières générations de testeur Multi-têtes pour du test en parallèle de plusieurs produits. Le TSA peut avoir jusqu'à 4 têtes pour le test en simultané de plusieurs cartes en flan.



Système avec double tête de test

Emprise au sol 40% inférieure à un système standard

Facilement configurable en pure «analogue» ou bien en Testeur «Multistratégie» InCircuit

Entre 2 et 4 fois plus rapide qu'un système de test conventionnel

Maintenance très simple

TESTSTATION TSO TestStation TSO

Le Teststation TSO est la version intégrable dans un passeur de carte du commerce pour une mise en ligne du test en parallèle.



TESTSTATION TSI TestStation TSI

Le TSI est sa version ASSYNCHRONE.

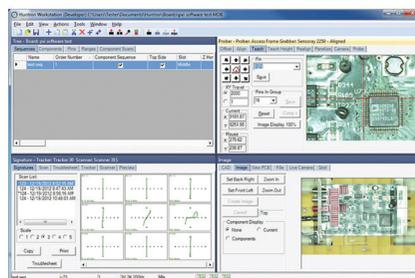




WORKSTATION SOFTWARE

Logiciel de contrôle des systèmes d'analyse de signature pour la réparation

Le logiciel Huntron Workstation stocke et gère efficacement vos données de test de référence. Les données de test et le flux de travail organisé permettent une procédure de réparation normalisée. L'avantage est une durée d'apprentissage réduite, une procédure de test étape par étape pour les cartes de circuits imprimés non documentées.



Explorez les circuits défectueux et interprétez vos résultats

Une fois les signatures du modèle de base sauvegardées, les cartes de circuits imprimés défectueux ou suspects sont analysées et les résultats du test sont affichés dans la «Fiche de problèmes» de la station de travail.

Les résultats de la feuille de travail peuvent être enregistrés dans un rapport complet ou sous forme de texte ASCII.

TRACKER 3200

Solution puissante pour le test électrique et le dépannage

Le Huntron Tracker 3200S est une solution puissante de test et de dépannage. Il est doté de paramètres de plage variables qui permettent de combiner des centaines de tensions, résistances et fréquences.



Utilise le logiciel inclus Huntron Workstation pour stocker les signatures Tracker

Peut être utilisé comme unité autonome à l'aide des commandes pratiques du panneau avant et de l'écran tactile LCD

Générateur d'impulsions intégré pour tester des dispositifs à porte tels que des relais et des TRIAC

Huntron SigAssist® affiche les valeurs calculées telles que la résistance et la capacité

Numérise jusqu'à 128 broches avec des options communes sélectionnables à l'aide des connexions IDC du panneau avant

Connectez-vous à un Huntron Access Prober pour une automatisation complète des tests

TRACKER 2800 & 2800S

Instrumentation pour le test électrique et la réparation

La série 2800 de Huntron Trackers est conçue pour compléter les instruments de test conventionnels dans les processus de débogage et de dépannage. En utilisant la méthode de test hors tension éprouvée connue sous le nom d'Analog Signature Analysis, il élimine le risque d'endommager davantage le circuit, ce qui se produit souvent lorsque l'alimentation est appliquée. Ils sont adaptés aux cartes de signaux actuelles où les signaux analogiques et numériques sont mélangés et constituent le complément parfait de votre atelier de dépannage électronique.



Mesure et comparaison (V/I) jusqu'à 40 « pins » en simultané

Source sinusoïdale

Large gamme de fréquence, tension, résistance

Liaison vers le produit sous test par câble et IC clips

ACCESS ET ACCESS 2 PROBER

Plateformes de sondes mobiles de précision à une tête pour réparation

Les sondes d'accès Huntron Access connectées à un système Huntron Tracker permettent de réaliser des tests automatisés et économiques sur des dispositifs encombrants à montage en surface et autres, ceci sur vos cartes les plus complexes. Le sondage automatique augmentera de dix fois la vitesse du test par rapport au sondage manuel. Les sondes d'accès peuvent être connectées à un Tracker 3200S ou avoir un Tracker installé en interne pour une plate-forme de test tout-en-un. Tous les probers Huntron Access sont certifiés CE et ETL.



Taille maximale du circuit imprimé : 49,3 cm x 35,6 cm (19,4 po x 14 po) ACCESS 2 : 56 cm x 58 cm (22 po x 23 po)

Accès maximum à la zone de sondage de la carte : 38,9 cm x 33,8 cm (15,3 po x 12,9 po) ACCESS 2 : 46,2 cm x 56,9 cm (18,2 po x 22,4 po)

Hauteur maximale des composants : 2,375 po (6 cm) ACCESS 2 : 4 po (10 cm)

Résolution minimale 0,0003937" (10 µm)

Système de caméra : Caméra couleur CCD couleur haute résolution interfacée via une carte d'acquisition USB interne

Accès physique ACCESS : 26,5" de large x 13" de haut x 24,5" de diamètre (67,3 cm de large x 33,1 cm de hauteur x 62,3 cm de profondeur)

ACCESS 2 : 36" L x 15,7" H x 29" D (91,4 cm L x 39,9 cm H x 73,7 cm D)

ACCESS DH

Automatisation des mesures fonctionnelles

Le Access DH Prober est un système à deux têtes Mobiles qui convient le mieux aux tests de carte de circuit imprimé dans lesquels une mesure entre deux points est nécessaire. L'Access DH se trouve dans sa propre armoire avec beaucoup d'espace en dessous pour un PC monté en rack et d'autres instruments de test. Sa conception à architecture ouverte vous permet d'utiliser la technologie des sondes mobiles avec de nombreuses méthodes de test différentes où la mesure automatique de la carte a du sens. Grâce à l'intégration et adaptation de la tête de test selon les besoins (RF, 20 points de test supplémentaires, etc) et l'intégration d'instrumentation de mesure, il permet d'automatiser vos test fonctionnels.



Taille maximale du circuit imprimé 58 cm x 68,6 cm (23" x 27")

Surface de palpation maximale de la carte 30,5 cm x 48,3 cm (12 po x 19 po)

Hauteur maximale du composant 4.8" (15.2cm)

Résolution minimale 0.00002" (0.4 µm)

Espacement de sonde à sonde : 1,27 mm minimum

Système de caméra Deux caméras CCD couleur USB haute résolution

Dimensions : 39" L x 61" H x 53" D (99,1 cm L x 154,9 cm H x 134,5 cm D)

TESTEURS DE CÂBLES ET HARNAIS

▶ Basse et haute tension

CIRRIS[®]

SYSTEMS

TESTEUR 4200

Testeur de câble basse tension de table

Le testeur de câbles et de faisceaux de table 4200 intègre des capacités impressionnantes dans un boîtier compact et facile à utiliser qui convient à presque tous les budgets.



Assurer la qualité des assemblages: bien plus qu'un simple scanner de continuité, le 4200 vous permet de tester en profondeur tous les aspects de vos câbles ou faisceaux. Avec une plage de résistance allant de 0,005 à 100 000 ohms, vous pouvez véritablement vérifier la qualité de vos connexions.

Des composants intégrés dans vos câbles ? Aucun problème. Le 4200 teste les résistances, les diodes, les condensateurs et peut même vérifier l'appariement des câbles à paires torsadées.

S'étend pour répondre à vos besoins : Les boîtiers d'extension vous permettent d'étendre votre 4200 de 128 à 1024 points de test, par incréments de 128 points.

Cartes adaptateur interchangeables : choisissez parmi plus de 200 adaptateurs standard qui se connectent directement au testeur, éliminant ainsi le besoin de câbles d'adaptateur compliqués.

Composants Testables : Résistances, Diodes, Capacités

TESTEUR 4250

Testeur de câble haute tension de table nouvelle génération

Comme tous les testeurs Cirris, le 4250 peut tester de manière fiable les câbles pour les erreurs de câblage. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour améliorer l'expérience de test. Doté d'un écran tactile capacitif couleur et du nouveau logiciel Cirris OS, le 4250 est l'un des testeurs de câbles les plus performants du marché.



Haute tension : Testez avec des tensions allant jusqu'à 2000 VDC ou 1000 VAC (norme 1500 VDC)

Tous les tests essentiels : teste les ouvertures, les courts-circuits, les câblages incorrects et les erreurs intermittentes. Testez également des composants tels que des résistances, des diodes et des condensateurs

Tests rapides : une technologie innovante et des algorithmes efficaces réduisent le temps consacré aux tests

Extensible pour les grands assemblages : les boîtes d'extension permettent jusqu'à 1024 points de test (128 points par boîte)

Mise en réseau intégrée : partagez facilement des programmes de test et des imprimantes entre plusieurs unités

Personnalisation du programme de test

Transition à partir de 1100 - Utilisez les programmes de test et les rapports déjà configurés pour le 1100H + sur le 4250

TESTEUR 8100

Testeur de faisceau à faible tension

Ce testeur de faisceaux à faible tension conçu, offre une grande flexibilité et facilité d'utilisation grâce à son logiciel Easy-Wire®. Il permet aux opérateurs de visualiser des images de connecteurs avec des emplacements de broches cibles, simplifiant ainsi les processus d'assemblage et de rework. Compact et robuste, il s'adapte aux environnements de production exigeants tout en restant non-intrusif. Évolutif, le 8100 peut tester de 256 à 100 000 points, et il est compatible avec les anciens programmes CR. Son alimentation USB offre une portabilité pratique pour une utilisation mobile.



Évolutif de 256 à 100 000 points de test selon les besoins

Compatibilité CR pour utiliser des programmes de test existants

Interface avec Cirris Smart-Lights® ou systèmes traditionnels

Utilise le logiciel puissant Easy-Wire® pour la gestion des tests

Assistance graphique pour faciliter l'assemblage et le rework

Tests flexibles pour composants passifs : résistances, diodes, condensateurs

Mesures sensibles avec les Cirris Advance Instructions

Intégration PC Windows pour un fonctionnement simplifié et connecté

Portabilité via alimentation USB pour une utilisation mobile

Conception robuste pour résister aux environnements de production

EASY WIRE CH2

Test faisceaux électriques (Haute tension)

Le CH2 est un testeur de harnais polyvalent avec la capacité intégrée de tester la haute tension et les composants. Il est assez compact pour être facilement utilisé dans l'atelier de production, tout en étant aussi capable de répondre aux spécifications des essais militaires. En plus d'être facile à comprendre, le CH2 vous offre un haut niveau de contrôle pour les essais.



Le plus compétent des Testeurs Cirris : essais rapides pour vérifier la tension des câbles, des éléments, commutateurs, relais, et plus encore

Extensible pour les Grands Assemblages : jusqu'à 100.000 points (160 points par boîte scanner, jusqu'à 800 points par unité)

Facile à Comprendre : maîtrisez le système en quelques jours. Des formations sont disponibles si nécessaires

Configuration des essais rapide : Cirris SmartLights™ fournit un soutien mécanique rapide pour changer la configuration des essais

Compact : unité de base contient 800 points d'essai, pèse 18kg, et son empreinte est de seulement 43cm x 43cm x 15cm

Normes d'Essai : répond aux exigences des normes d'essai suivantes : IPC/WH-MA-A-620, MILSTD-202G, MIL-HDBK-83575, MIL-STD1344A(5), et MIL-C-45224D

Assemblage guidé : instruction graphique sur l'écran et des instructions LED sur le tableau du harnais guident les opérateurs lors de l'assemblage

Rapports très complets : les rapports des essais peuvent être personnalisés pour une meilleure organisation et compréhension

TESTEUR EASY TOUCH

Testeur haute tension avec PC Windows intégré

En tant que fabricants de câbles et de faisceaux, vous avez besoin de systèmes de test adaptés aux environnements de production et ne nécessitant pas beaucoup de maintenance. Ces systèmes doivent mesurer et rapporter la valeur et indiquer aux clients que votre niveau de qualité est élevé. Easy-Touch Pro est un testeur de câble haute tension autonome conçu pour une intégration aisée dans votre processus de fabrication. Propulsé par un PC Windows® et le logiciel Cirris Easy-Wire™.



PC intégré - PC Windows 10 intégré et écran tactile capacitif de 10,4 pouces en couleur.

Réseau Windows : Partagez des programmes de test, des imprimantes et des fichiers en vous connectant à un réseau Windows

Autonome : Système indépendant capable de se déplacer dans l'atelier de production vers différentes stations d'essai

Rapports puissants : Les rapports de test peuvent être personnalisés pour une meilleure organisation et compréhension

Configuration et création de test rapide : Adaptateur Cirris

Capable de tests complexes : Haute tension, tests de composants, et plus

Extensible pour les grands assemblages : jusqu'à 1024 points de test (128 points par boîte).

LOGICIEL EASY WIRE

Logiciel pour test et assemblage de câbles et harnais

Easy-Wire vous permet de piloter des testeurs CIRRIIS. Du début des tests jusqu'au «reporting», le processus pas à pas est très simple à suivre.



La génération des schémas de câblage pour la documentation des cordons

La génération de rapports de test Personnalisés

Le guidage opérateur pour la fabrication des câbles

La collecte automatique de données statistiques

La visualisation graphique des connecteurs pour le diagnostic

L'importation de programmes issus d'autres marques de testeur

▶ Test fonctionnel



INSTRUMENTATION ET LOGICIEL

Instrumentation et logiciel pour le test fonctionnel



Châssis & Contrôleurs : plus de 20 Châssis différents pour accueillir les instruments PXI Format 3U ou 6U ou Mixte.

Entrée/Sortie Numérique : cartes d'entrées-sorties Numériques PXI 3U ou 6U avec des vitesses de test jusqu'à 200MHZ, niveaux logiques programmables. Les cartes dynamiques sont les plus performantes du marché

Logiciel de pilotage d'instrumentation très haut niveau avec séquenceur de test intégré. Logiciel de programmation graphique des formes d'onde pour les cartes numériques. Outils de migration des vecteurs issus de LASAR.

Mesure : instrumentation de mesure standard tels que Compteur-Timer, Multimètre, Numériseur, Analyseur de puissance RF en format PXI, PCI ou ISA.

Stimulus : générateurs de formes d'onde arbitraire, générateur de fonction, sources DC et module d'étalon haute précision pour les fonctions de vérification de calibration des bancs

Commutation : diverses cartes de commutation et de multiplexage format 3U et 6U.

Alimentations de Puissance Utilisateur au format PXI

GBATS

Banc de test fonctionnel générique

Le système est prêt à l'emploi sur base PXI. Configuration, intégration et self-test sont déjà faits. Il vous reste à réaliser la connexion avec votre objet à tester et d'écrire la liste de mesures suivant le cahier des charges. Une solution qui se trouve entre le module et les systèmes clés-en-mains.



Un seul système pour plusieurs applications

Meilleure taux d'utilisation de votre investissement

Moins de systèmes différents à stocker, à maîtriser et à maintenir

Doubler temporairement la capacité avec un deuxième interface

Système ouvert, permet d'intégrer toute instrumentation du marché

Réduire le temps de chiffrage pour le test

Réduire le temps de développement

Réduire le coût du test

TS900

Testeur de semiconducteurs base PXI

Le système de test TSX-900 PXI Pour les Semi-conducteurs est une plate-forme de test intégrée qui offre des fonctionnalités et des capacités systèmes comparables à celles des systèmes ATE propriétaires. Disponible en version de table, avec chariot intégré ou avec un manipulateur intégré, le TS-900 tire pleinement parti de l'architecture PXI pour constituer une solution de test économique et complète pour les applications de test de dispositifs, SoC et SiP.



Plate-forme intégrée de test de semi-conducteurs basée sur PXI

Le châssis PXI 3U à 20 emplacements offre jusqu'à 512 canaux d'E / S numériques avec capacité de PMU et de synchronisation par broche

Le système prêt à l'emploi offre une solution rentable pour les applications de test numériques et à signaux mixtes

Inclut les outils logiciels de test ICEasy - simplifiant la création de tests et la caractérisation de périphériques

Configurations multiples : plateau, chariot intégré et manipulateur intégré

TS-960E

Système de test PXI semi-conductor avec sous-système numérique de synchronisation par broche

Le système de test TSX-960 PXI Semiconductor est une plate-forme de test intégrée qui offre des fonctionnalités et capacités systèmes comparables à celles des systèmes ATE propriétaires. Disponible en tant que système de table ou avec un manipulateur intégré, le TS-960 tire pleinement parti de l'architecture PXI pour constituer une solution de test complète et rentable pour les applications de test de dispositifs, SoC et SiP.



Plate-forme intégrée de test de semi-conducteurs basée sur PXI

Le châssis PXI 3U à 20 emplacements offre jusqu'à 512 canaux d'E / S numériques avec capacité de PMU et de synchronisation par broche

Le système prêt à l'emploi offre une solution rentable pour les applications de test numériques et à signaux mixtes

Inclut les outils logiciels de test ICEasy - simplifiant la création de tests et la caractérisation de périphériques

Configuration de table et manipulateur intégré

TS-960E-5G

Système de test de production mmWave / 5G

Le système de test TS-960e-5G mmWave offre des performances éprouvées jusqu'à 50 GHz. Le système intègre les performances RF de laboratoire directement au dispositif sous test mmWave pour le test de production multi-site ou la caractérisation de dispositif pour les dispositifs mmWave. En outre, MTS propose une suite complète de tests numériques et paramétriques ainsi que le support d'interface SPI / I2C permettant de contrôler / surveiller fonctionnellement le périphérique testé.



Test de production et caractérisation de mmWave

Capacités de test CC, paramétriques et RF

Facteur de forme / encombrement compact et évolutif

Prend en charge jusqu'à 24 ports pour les tests multi-sites

Transmission du signal 50 GHz au périphérique testé

Suite de tests complète ICEasy Semiconductor

Intuitive ATEasy® - Environnement de test / environnement de test intégré



NPI

► Suite de logiciels pour NPI



FABXPERT® Génération de programmes pour le placement, l'inspection et le test

FabXpert® est une solution logicielle pour la gestion des données numériques dans l'industrie des circuits électroniques. Elle offre des modules spécialisés pour la fabrication et les tests, couvrant les données de conception à la production.



Disponibilité de nombreuses interfaces CAO

Visionneuse de PCB ultra-rapide et personnalisable

Lien entre la représentation graphique du PCB et le schéma électrique

Importateur efficace de listes de matériaux graphiques, formats texte et Excel

Menus d'édition orientés assistance utilisateur

Prise en compte des décalages de rotation des composants pour le placement

Distribution des composants par scénario, automatiquement créée à partir de la liste de matériaux

Outil de création pour les testeurs ICT classiques (Bed of Nails) et Flying Probe

Module DFT intégré, accessibilité et couverture de test

COVERAGEXPERT® Analyse interactive de la couverture de test

CoverageXpert® est un outil interactif, sans programmation, conçu pour évaluer la couverture de test d'une carte électronique et générer des rapports détaillés sur cette couverture.



Validation et analyse de l'accessibilité des produits

Comparaison des données CAO et BOM avec la couverture complète fournie pour plusieurs processus : AOI, ICT, FPT, inspection manuelle, SPI, etc.

Création de définitions de tests pour une couverture de test prédictive

Pour chaque composant, les tests associés sont affichés, et les scores de test résultants sont calculés en fonction des règles définies par classe de composant et type de test

La priorisation des scores met en évidence les composants qui semblent insuffisamment testés

Les règles de calcul des scores sont configurables, permettant des ajustements interactifs de l'analyse pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de la carte, de certains tests et testeurs spécifiques

Création de rapports aux formats PDF et HTML

DOCXPRESS® Création fiches d'instructions

DocXpress®, au cœur de notre suite logicielle, est dédié à la conception de fiches d'instruction pour la fabrication de circuits imprimés (PCB). Il simplifie et optimise la création d'instructions détaillées pour le processus de production, offrant des fonctionnalités dynamiques et conviviales adaptées à l'industrie électronique.



Création et modification dynamiques de la documentation

Configuration indépendante de chaque vue, regroupement de composants, couleurs, etc.

Sélection intuitive des composants avec un outil de requête convivial

Création et réutilisation de modèles de page, vues, et documentation

Importation d'images et de documents externes

Éditeur graphique intégré

Navigation utilisateur simplifiée avec des modes de conception et de navigation séparés

Lien dynamique avec le visualiseur de PCB

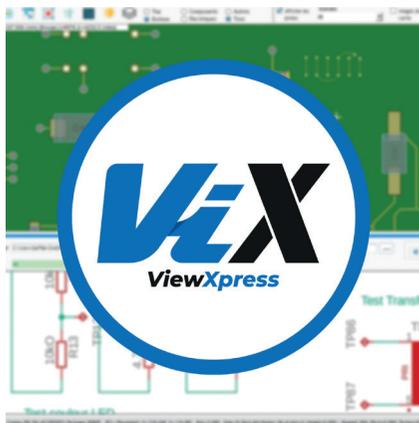
Intégration des images de PCB pour un affichage amélioré

Impression sous forme de PDF vectorisés

VIEWXPRESS®

Visualisateur de données cartes électroniques

ViewXpress® est le visualiseur de données pour la plateforme logicielle Accelonix. Il peut lire toutes les données de projet, des données CAO aux schémas électriques, en incluant la documentation créée avec le module DocXpress®.



Affichage de la vue des composants définis par les données CAO

Configuration des couleurs et formes à utiliser pour le dessin des composants

Zoom par roulette souris, sélection de zone, barre d'outils, menu contextuel, meilleur zoom... Scroll par "drag" de la souris dans la partie viewer

Sélection d'entité dans le viewer par clic souris et affichage des informations relatives à la sélection (Composants et netlist)

Recherche d'un composant et d'équipotentielle avec sélection automatique dans le viewer

Liaison entre la représentation graphique de la carte et le schéma électrique

Affichage de la liste des composants et de leurs attributs, de la liste des boîtiers et de leurs dessins

Sélection vue top ou bottom

REPAIRXPRT®

Station de diagnostic et de réparation

RepairXprt® est une station de réparation permettant aux utilisateurs des testeurs d'accéder à des fonctionnalités innovantes et uniques. En quelques clics le logiciel est opérationnel, configuration minimum et simplicité maximum.



Mode lecture automatique des fichiers Testeurs présents dans le répertoire configuré et extraction des pannes/défauts

Stockage des données de test dans une base de données permettant la traçabilité des cartes

Champ de saisie du code barre pour identification du produit à réparer et affichage de la liste des défauts du N° de série saisi

Pour un défaut donné, historique des réparations (codes réparations et commentaires) des défauts identiques.

Définition automatique du panneau à l'aide des données Testeur (disponible uniquement sur certains testeurs)

Affichage de la liste des broches d'un nœud, d'un composant.

Pour chaque panne réparée, saisie d'un code de réparation, Génération d'un ticket de réparation

INSPECTIONXPRESS®

Inspection visuelle première carte

Basé sur la capture d'une image de la carte et un procédé innovant d'affichage des composants, InspectionXpress® permet une analyse rapide et fiable à 100%, réduisant les temps d'attente et d'arrêt de la ligne de production.



Une aide logicielle à l'inspection visuelle en offrant la possibilité de rassembler les images sur un panneau d'inspection, les composants sont automatiquement groupés et affichés.(Brevet)

Importateurs de données CAO pour visualiser le produit à inspecter

Algorithmes d'importation d'images des cartes à inspecter et de découpage sophistiqués

L'offre logicielle est complétée par du matériel de capture d'images commercialisé par Accelonix

Nombreuses fonctionnalités d'aide à l'inspection comme la gestion de l'opérateur et du N° de fabrication, la saisie des codes de défaut assistée, la traduction des marquages de résistances en valeurs, l'affichage de la description des codes articles issues de la nomenclature...

STATXPRT®

Analyse statistique des données de production

StatXprt® est un outil de mesure, d'analyse et de suivi qui aide à améliorer la qualité. Le logiciel fournit des outils d'analyse statistique sous forme de calculs Cp, Cpk, écart-type, ainsi qu'un outil graphique interactif qui visualise les changements dans les mesures.



Calcul des principaux indicateurs statistiques permettant de valider la stabilité de vos programmes, la précision, l'évolution dans le temps, l'impact d'un changement en cours de production

Il dispose d'un grand nombre de contrôles, de tris et de filtres facilitant l'analyse en mettant en correspondance mesures et résultats

Il permet de collecter rapidement et facilement des données en provenance de vos testeurs et machines de production

Créer de nombreux rapports intégrés au format pdf

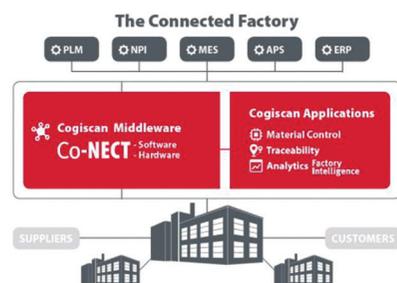
L'USINE CONNECTÉE

► Connectivité



CO-NECT Connectivité pour la Fabrication Électronique

La plateforme Co-NECT de Cogiscan assure une connectivité machine complète dans la fabrication électronique. Flexible et évolutive, elle s'intègre facilement à divers équipements SMT, facilitant la récupération et le partage des données pour accompagner la transformation numérique des fabricants.



Prend en charge une large gamme d'équipements SMT, garantissant une connectivité complète

Permet un partage efficace et concurrent des données entre les systèmes

Facilite la mise en œuvre de systèmes auto-correcteurs grâce à une utilisation intelligente des données

Compatible avec divers équipements SMT, quel que soit le fabricant ou le modèle

Compatibilité CFX

APIs REST

Plusieurs formats de données tels que CAMX, JSON, XML, CFX, FujiTrax, PanaCIM, SECS/GEM, et bien d'autres

Couvre un large éventail d'équipements SMT, y compris les machines de placement, imprimantes de pochoirs, systèmes AOI et SPI, fours de refusion, solutions de stockage de matériaux et équipements de test en fin de chaîne.

PFC Contrôleur de Flux de Production pour Ligne SMT

Le Product Flow Controller (PFC) de Cogiscan améliore le contrôle des lignes de production SMT en vérifiant que tous les composants et matériaux sont correctement positionnés avant de passer à l'étape suivante. Il arrête la production en cas de problèmes critiques, assurant ainsi la qualité des produits.



Offre des options d'intégration flexibles avec d'autres applications logicielles

Interconnecte physiquement la ligne de production pour empêcher les PCBAs de passer à la machine suivante en cas d'erreurs détectées

Suivi par identifiant unique

Capacités de scan avancées : Prend en charge plusieurs types de scanners pour une lecture des PCBAs par le haut et par le bas

Désactive automatiquement la production lorsque des dispositifs sensibles à l'humidité ou des matériaux à durée limitée sont expirés

Arrête la ligne en cas de problème sur une machine, un matériau ou un processus

Contrôle garanti des processus : Veille à ce que tous les produits suivent la séquence correcte des étapes de fabrication requises par le routage

TTC CHECK Collecter des Données dans les Stations Hors Ligne

Le dispositif IIoT TTC Check de Cogiscan étend la capture de données et le contrôle des processus aux opérations manuelles, notamment pour l'assemblage final et les stations de test. Il offre une méthode simple et économique pour ajouter la traçabilité et le contrôle de routage sans matériel coûteux.



Alarmes sonores

Permet le scan manuel à tout moment

Étend la traçabilité et le contrôle de routage aux stations manuelles et aux machines hors ligne, comme les testeurs

Scan de panneaux

Remplace les PC d'atelier, réduisant l'espace requis, les coûts et la maintenance

Réduction des erreurs : Fonctionne comme un dispositif de vérification pour les opérateurs dans des opérations nécessitant beaucoup de manipulations manuelles, diminuant ainsi les erreurs

Signale les produits défectueux identifiés en amont dès le scan, alertant ainsi l'opérateur des problèmes

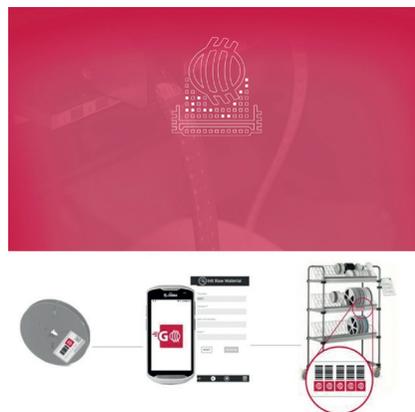
Traçabilité étendue : Assure une traçabilité complète pour les stations manuelles et les machines hors ligne



GESTION DU MATÉRIEL

Gestion et Contrôle de la Matière pour PCBA

Le logiciel Material Control de Cogiscan optimise la production de PCBA en assurant un approvisionnement continu et une gestion rigoureuse des stocks, améliorant ainsi les marges bénéficiaires.



Suivi en temps réel de l'emplacement, de la quantité et du statut de toute la matière dans l'usine

Contrôle de kits : Garantit une préparation et une livraison efficaces de la matière pour les séries de production

Support LCR : Gère et surveille en temps réel l'emplacement et la quantité de toute la matière étiquetée

Contrôle de quarantaine : Isole et signale la matière mis en quarantaine pour empêcher leur utilisation en production

Contrôle de la matière sensible au temps : Supervise avec des dates d'expiration ou des exigences spécifiques de stockage

Suivi d'inventaire en temps réel

Génération d'ID unique

Intégration ERP, MOM, MES

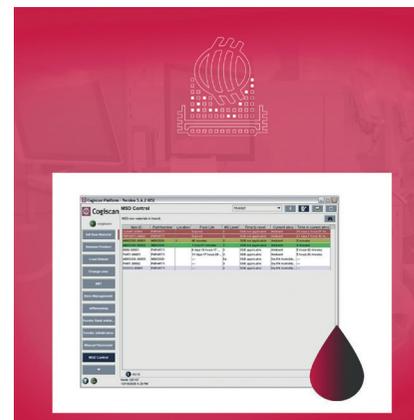
Validation automatique des configurations

Fournit un suivi en temps réel des emplacements et des quantités de stocks

MSD CONTROL

Gestion simplifiée de la conformité MSD

L'application MSD Control de Cogiscan automatise la gestion des composants sensibles à l'humidité (MSD) pour les fabricants de PCBA, assurant la conformité aux normes IPC/JEDEC et simplifiant les calculs de temps d'exposition et de stockage.



Localisation en temps réel et suivi de la durée de vie restante des plateaux et bobines contenant des MSD

Gestion automatisée des temps d'exposition, de cuisson, de reconditionnement et de stockage sec

Alertes automatiques

Rapports détaillés

Contrôle de processus en boucle fermée : Empêche l'utilisation des MSD expirés dans la production grâce au verrouillage physique de la ligne SMT

Conformité aux normes IPC/JEDEC

Surveillance en temps réel

Réduction des temps d'arrêt et cycles de cuisson

Capacités d'intégration : S'intègre facilement aux systèmes de fabrication existants pour des opérations rationalisées

INTÉGRATION DES TOURS DE STOCKAGE

Gestion simplifiée de la matière pour PCBA

La solution Storage Towers Integration de Cogiscan intègre les tours de stockage aux machines de placement pour les PCBA, rationalisant la préparation des kits et augmentant la productivité grâce à une communication automatique entre machines.



Compatible avec plus de 20 marques de machines de placement et de tours de stockage, dont des fabricants majeurs comme Essegi Automation

Contrôle des kits simplifié

Intégration avec MSD Control

Suivi des emplacements et quantités : Fournit un suivi en temps réel des quantités et emplacements des composants dans l'usine

Demandes automatiques de matériaux : Envoie des demandes automatiques pour les composants en cas d'alerte de faible niveau depuis les machines de placement

Coordination avec les AGV

Synchronisation des données : Garantit des données cohérentes et précises à travers l'écosystème de fabrication

Augmentation de la productivité : 10%

Visibilité précise de la matière

► Traçabilité



LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ
Suivi précis pour la conformité et la qualité

Le logiciel de traçabilité de Cogiscan pour la fabrication électronique offre une solution complète de suivi et de reporting pour l'industrie des PCBAs.



Traçabilité 360°

Conformité aux normes IPC/JEDEC

Recherche intuitive et intelligente : Permet des recherches détaillées des PCBAs selon divers critères

Rapports détaillés : Fournit des rapports complets pour analyse et partage avec les clients

Gestion de rappel rapide et précise

Traçabilité produit, matières et processus

Intégration PFC : S'intègre avec des machines ayant des capacités de scan limitées

Options de configuration flexibles : Permet une installation adaptable pour suivre les étapes de production selon les besoins spécifiques

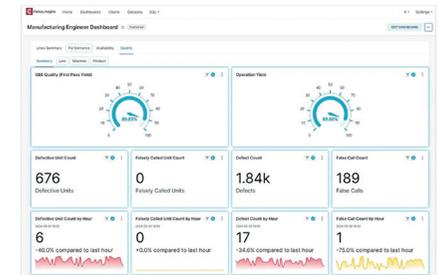
► Factory Insights



REAL-TIME DATA VISUALIZATION

Tableaux de bord en temps réel pour l'assemblage SMT

Real-Time Data Visualization offre une visualisation des données en temps réel pour améliorer la gestion des lignes de production et des machines. Grâce à des tableaux de bord centralisés et des données actualisées en direct, elle optimise le partage d'informations et la prise de décision au sein de votre usine.



Visualisation des données en temps réel : Affiche les données à l'échelle de l'usine, des lignes et des machines avec des indicateurs adaptés

Tableaux de bord centralisés : Accès simplifié aux mises à jour en un coup d'œil, où que vous soyez

Partage d'informations amélioré : Définit des seuils et des alertes pour une communication efficace des anomalies et mises à jour

Données en direct personnalisables : Rafraîchissement automatique des données toutes les 10, 30 secondes ou 1 minute selon vos besoins

HISTORICAL DESCRIPTIVE ANALYTICS

Suivi et Analyse des Performances

Historical Descriptive Analytics fournit des indicateurs standardisés pour comparer machines, lignes ou sites. En augmentant la qualité, la disponibilité et l'efficacité, elle favorise une amélioration continue et permet de détecter rapidement les tendances négatives ou anomalies.



KPIs standardisés : Comparaison simplifiée entre machines, lignes et sites pour favoriser le partage des bonnes pratiques

Amélioration de l'OEE : Augmente la disponibilité, la qualité et l'efficacité des machines et des lignes de production

Amélioration continue : Offre des informations clés pour identifier et résoudre rapidement les problèmes

Analyse des tendances : Détecte facilement les anomalies ou tendances négatives affectant la qualité et la performance

Compatibilité des équipements : Connexion rapide avec une large gamme d'équipements d'assemblage électronique, incluant les imprimantes de pochoirs, les machines de placement, et les systèmes d'inspection AOI et SPI

DRILL DOWN ANALYSIS

Analyse approfondie des défauts et régressions OEE

Drill Down Analysis propose une analyse approfondie des causes racines pour identifier et résoudre les problèmes de défauts ou de régression OEE. Avec des outils consolidés pour l'analyse Pareto et des investigations détaillées, elle facilite la mise en œuvre de mesures correctives ciblées sur vos lignes et machines.



Plateforme unique pour enquêter sur les défauts ou la régression OEE

Analyse détaillée par ligne, produit, numéro de pièce, composant, code défaut ou référence de désignation

Analyse Pareto : Classement des défauts par produit, composant, code défaut ou référence de désignation

Inspection des défauts et faux positifs

Analyse des défauts de placement

Investigations par ligne, machine, composant, ID de feeder, tête, buse ou broche

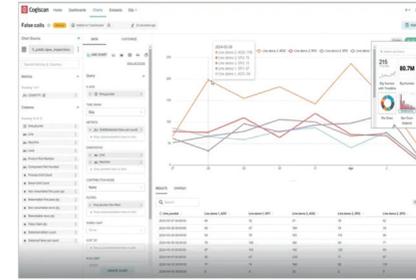
Consolidation des outils d'analyse : Un outil centralisé pour optimiser les enquêtes et les corrections

Compatibilité des équipements : Connexion rapide avec une large gamme d'équipements d'assemblage électronique

FULLY CUSTOMIZABLE PLATFORM

Plateforme entièrement personnalisable

Cette plateforme personnalisable permet de créer vos propres KPIs et tableaux de bord ou de modifier ceux pré-conçus par rôle. Grâce à une architecture ouverte, partagez vos métriques calculées avec d'autres systèmes BI. Idéal pour adapter la visualisation des données aux besoins spécifiques des utilisateurs.



Personnalisation complète : Créez ou ajustez vos KPIs et tableaux de bord pour répondre à vos besoins spécifiques

Tableaux de bord pré-conçus : Utilisez et personnalisez des modèles créés par rôle ou fonction

Architecture ouverte : Partagez vos métriques calculées avec des plateformes BI

Tableaux de bord par rôle : Visualisez des KPIs pertinents selon les responsabilités spécifiques de chaque utilisateur

Expertise PCBA intégrée : Tableaux de bord optimisés grâce à 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assemblage de cartes électroniques

Conception orientée utilisateur : Facilite la prise de décision grâce à des métriques adaptées et accessibles

WORK INSTRUCTION SOFTWARE

▶ Work Instruction Software



VKS Instructions de travail numériques

VKS est une solution puissante d'instructions de travail numériques, conçue pour aider les entreprises manufacturières à augmenter leur rentabilité tout en améliorant la qualité, la productivité et l'efficacité de leurs opérations. VKS rend la création, le déploiement et la gestion des instructions de travail simples et efficaces tout en fournissant une plateforme intégrée pour la collecte de données et le suivi de la productivité en temps réel.



Ajoutez des photos, des vidéos, des GIFs et plus encore!

Glissez-déposez des annotations

Traduction instantané

Contrôle de version et processus d'approbation

Scannez des codes-barres QR et 2D pour un accès rapide

Naviguez facilement à travers les étapes

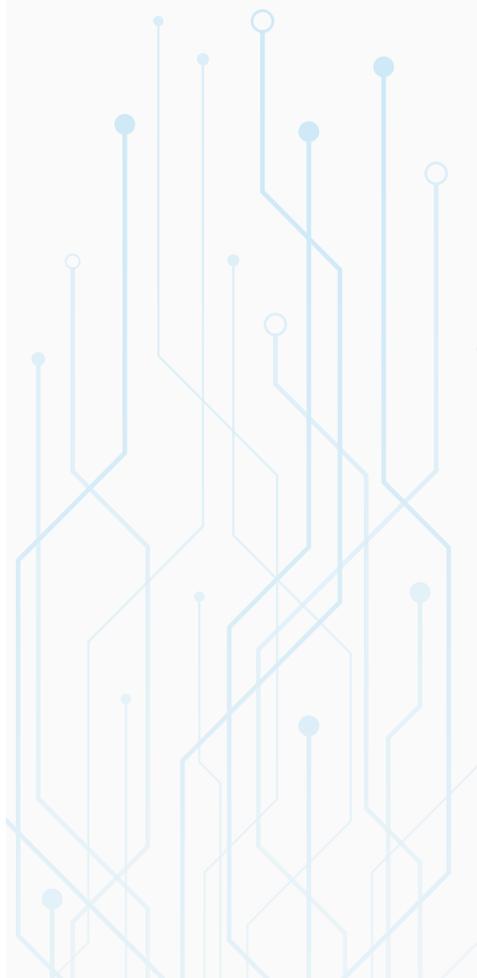
Mode expert pour les employés qualifiés

Suivez la formation et les certifications des opérateurs

Traçabilité à 100%

SALLE ET ZONE BLANCHE

► Hotte, cabine et salle



LAMINO WORKPLACE Hotte à flux laminaire

Des solutions par conception modulaire et mobile pour convertir des surfaces locales en zone propre. Pour les plans de travail, sur support ou en suspension.



- ISO 5 selon DIN ISO 14644-1
- Contrôle individuel du débit d'air
- Surveillance continue du filtre
- Économie d'énergie en nocturne
- Option ESD et ioniseur
- Options d'éclairage
- Option plan de travail sur pied
- Plusieurs largeurs disponibles de série (120cm et 180cm), conception spécifique client possible

LAMINO CABIN Cabine à flux laminaire

Zone de travail propre, adaptable et modulaire, disponible différentes classes ISO. Moteurs à faible consommation d'énergie.



- ISO 5 / ISO 6 / ISO 7 selon DIN ISO 14644-1 - avec dimensions suivant client spécification
- Contrôle individuel du débit d'air
- Surveillance continue du filtre
- Économie d'énergie en nocturne
- Plusieurs connections aux installations existante chez le client disponible dans le panneau de commande (Electricité, Azote, CDA, Network, ...)
- Version mobile
- Compatible pour conversion en salle blanche
- Option ESD et ioniseur
- Option d'éclairage
- Différentes taille disponibles

CLEAN ROOM Salle Blanche Intégrée

Conception des salles blanches, incluant ventilation et filtration d'air. Installation, qualification, service, formation et entretien par une personne Asys certifié.



- ISO 5 / ISO 6 / ISO 7 selon DIN ISO 14644-1
- Solutions spécifiques suivant plan d'utilisation du client
- Tous les matériaux sélectionnés sont compatible avec les normes Allemande du secteur du semi-conducteur
- Adapté à la structure du bâtiment : autonome ou suspendu
- Échangeur de chaleur et de température



ADT 71XX Scie de précision découpe pour die ou substrat

Le ADT71XX est une plateforme de découpe pour wafer 200mm et 300mm, robuste, fiable et conçue pour minimum de maintenance.



Broche pour des lames 2»+3»; ou 4»+ 5»; avec grande range Z

Axes X avec coussin d'air pour un mouvement fluide et une qualité de coupe exceptionnelle

Découpe multi-panneaux

Changement de lame rapide et simple avec broche verrouillable

Option ADT7100XLA pour les substrats 450mm*600mm

Option ADT71TS tilting splindle 0 à 15°

Option ADT71MD - Piezo senseur ; équipé pour les applications épaisse, avec Z mapping et active contrôle contre les vibrations

Option Station de redressage

Option détection de lames cassées

Puissance 1,2kW ou 2,4kW

ADT 7200 Scie de précision découpe wafer avec chargement automatique

Scie de faible encombrement avec chargement automatique des wafers par cassette pour des wafers de 200mm et 300mm.



Découpe automatique de Si, verre, saphir, strip BGA & QFN, substrats céramiques et PCB

Système de manipulation efficace des wafers et cassette

Système de vision à grossissements numériques continus

Algorithme de prédiction de l'usure de la lame

Nettoyage atomisées des wafers

Gestion de taux usures des lames

Lamination et séchage UV intégrés

Communication SECS-GEM

Puissance 1,2kW ou 2,4kW

ADT 7302/7304 Scie de précision pour la découpe de panneaux, avec chargement automatique

L'ADT7302/7304 est une scie automatique avec chargement de cadres rectangulaires pour des PCB-strips et des multi-panneaux.



Découpe d'applications autres que les wafers avec cadres de 225 x 300 mm pour multi-bandes, verres et céramiques jusqu'à 10 mm d'épaisseur

Axes X sur coussin d'air

Utilisation efficace de la bande – avantage de coût non négligeable

Chargement, édicage, nettoyage et déchargement de la cassette entièrement automatiques

Station de dressage automatique

Broche : 2 pouces et 4 pouces

Option de découpage de panneaux multiples

Option : Outil de mesure de la hauteur

ADT 7900

Scie de précision découpe wafer à double broches

Avec ses deux broches, le ADT7900 double la productivité, idéale pour les applications nécessitant un long temps de cycle de coupe.



Deux broches 2»/3» opposées permettent une coupe simultanée

Interface Homme Machine Tactile sous Windows

Structure de base robuste en fonte

Correction automatique du décalage en Y

Faible encombrement

Plateforme configurable pour substrats: 200*200mm, 250*250mm, 250*300mm, et wafer de 300mm

Puissance 1.2kW ou 2.4kW

ADT 8020/8030

Scie de précision découpe wafer à double broches avec chargement automatique

L'ADT80XX est une scie automatique avec deux broches avec chargement des wafers de 200mm sur le ADT8020, et 300mm sur l'ADT8030.



Découpe des wafers sur anneau 200mm ou 300mm

Axes X sur coussin d'air

Chargement/découpe/nettoyage/déchargement de la cassette entièrement automatique

Station de dressage automatique

Broche 2" avec lame 2» ou 3» de diamètre

Puissance des broches 1,8kW ou 2,2kW

Interface à deux écrans tactiles (Programmation et Maintenance) sous Windows

Changement de lame rapide et simple avec broche verrouillable

Inspection automatique de la découpe avec analyse de la qualité

Communication SECS-GEM

ADT 80 WT

Scie de précision découpe automatique des strips application «wettable QFN»

L'ADT80WT est une scie à double broche pour le rainurage des QFN avec une profondeur de rainure fiable prenant en compte la déformation. Un capteur de hauteur laser et un processus de cartographie adaptent la hauteur de la lame pour suivre les variations de forme et garantir une profondeur de rainure reproductible.



Broche pour des lames 2»+3»

Puissance 1,8kW ou 2,2kW

système de manipulation efficace des wafers et cassette

Interface Homme Machine a deux écrans tactiles (Programmation et Maintenance) sous Windows

Changement de lame rapide et simple avec broche verrouillable

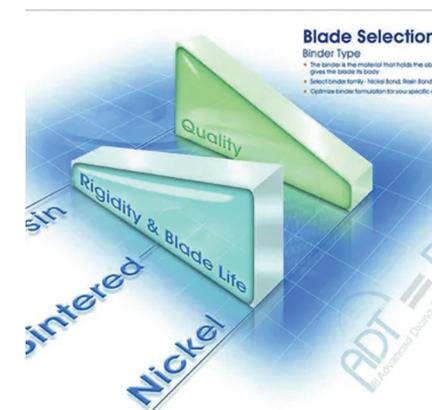
Communication SECS-GEM

Puissance 1,8kW ou 2,2kW

PLUSIEURS APPLICATIONS

Lames annulaires

ADT est fabricant de lames annulaires pour toutes sortes d'applications. Innovantes en performance et en réduction des prix consommables. Optimisation et conseil en choix de lames. Fabrication et livraison avec certificat de conformité. Différentes technologies de lames : (resin/diamond, metal sintered, nickel bonded.)



Lames en résine

Lames Nickel

Lames en métal « sinter »

Hub blades

Lames avec noyau en acier

Flasques- série 4A

► Die sorting

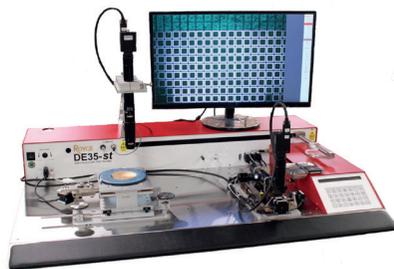
ROYCE

INSTRUMENTS

ROYCE DE35-ST

Die sortir manuel ou semi-automatique

Fiabilité et cout modéré. Équipement semi-automatique. Taille de wafer jusqu'à 8". Chargement en waffle pack ou gel pack 2 & 4", Jedec Tray, Film Frame, ... et autre support spécifique client. Idéal pour faible volume et/ou puces fragiles.



Large gamme de préhension de puces (200µm à 25mm).

Possibilité de PU Tool et éjecteur spécifique client.

Personnalisation de la machine pour répondre au spécification client possible (Wafer 12», Puce à fort Ration Largeur/Longueur, ...).

Nombreuses configurations possibles tel que Die-Inspection, Facet Inspection (par opérateur).

Sauvegarde des programmes, pour un changement de process rapide.

ROYCE AP+

Die sortir automatique avec inspection

Fort de leurs compétences sur les Autoplacer et du travail en commun avec le leader de la mise en Tape&Reel Royce propose cet équipement modulable de haute technologie entièrement automatique. Le chargement en waffle pack ou gel pack 2» & 4", Jedec Tray, Film Frame, ... et autre support spécifique client est toujours possible.



Large gamme de puces (250µm à 25mm pour sortie en Packing et 500µm à 17mm pour sortie en Tape and Reel)

Intègre la fonction wafer mapping (mono ou multi taille de puces) ou reconnaissance point d'encre

Jusqu'à 2000 composants / heure

Précision de placement et de répétabilité jusqu'à +/-12,5µ

Préhension par aspiration, facet contact sans contact, ou spécifique client

Setup rapide et conviviale par programmation de type «Pas à Pas»

Passage du mode Tape and Reel <-> Packing facilité (moins de 10 min)

Option inspection optique automatisée



► Périphériques pour montage et découpe de wafers



ADT 977 Équipement pour le nettoyage des applications après la coupe

Le ADT 977 Wafer Cleaner est conçu pour nettoyer les pièces après la découpe pour une large gamme de types de pièces. L'unité est équipée d'une table rotative et d'un bras de nettoyage. Options de nettoyage par pulvérisation ou à haute pression.



Nouvelle version avec logiciel et matériel améliorés pour une flexibilité, une facilité d'utilisation et une grande fiabilité

Élimination à 100 % de la contamination et des résidus

Rotation des wafers de 200 mm à 3 000 tr/min et des wafers de 300 mm à 200 tr/min

Nettoyage par pulvérisation et séchage à l'azote (N₂)

Séquence programmable, vitesse

Option pour les additifs, pompe à haute pression

ADT 967 Montage semi-automatique de wafer sur tape



Montage de Wafer manuel ou automatique
montage semi-automatique : ADT967 pour wafers 200mm et ADT967L pour wafers 300mm

Option ESD et montage sans contact disponible

Faible Encombrement (Table Top)

AV 57 UV curing pour wafers montés sur film UV

Système de traitement UV des wafers avec une source LED UV à haut rendement et haute fiabilité.



Versions pour wafers de 12 et 8 pouces sur cadre avec chargement par tiroir

Lumière à 365 nm avec une intensité variable de 0 à 100 % de 500 mW/cm₂ pour un durcissement en quelques secondes

Arrêt manuel ou automatique avec lampe témoin et avertisseur sonore

Écran tactile pour la sélection des paramètres, l'affichage de l'état et la surveillance du processus

Option : Azote – Élimine l'oxygène pour un durcissement optimal

Option : Kit de protection du cadre – Protège le cadre de la lumière UV

Faible encombrement : 550 x 500 x 400 mm ; poids : 56 kg

ADT 927

Recyclage de l'eau processus découpe de précision

Conçu pour un approvisionnement uniforme en boucle fermée de l'eau de coupe. Il recycle l'eau par filtration, refroidissement et contrôle de la température et du débit requis pour optimiser la découpe.



Réduction de consommation de l'eau à 95%

Jusqu'à 3 scies peuvent être connectées

Ultra-filtration 0.05um auto-nettoyant

ADT 937-A

Chiller pour broche de découpe

Conçu pour l'alimentation en boucle fermée de l'eau de refroidissement du Spindle. Il maintient l'eau à une température stabilisée, facteur important pour atteindre une découpe de qualité.



Stabilité de température +/- 0.1°C

Jusqu'à 3 scies peuvent être connectées

ADT 947 & AB 47

Injecteur de CO2 pour conductivité contrôlée

L'injecteur de CO2 en ligne 974 et la version AB-47 assurent une conductivité électrique contrôlée et spécifiée dans de l'eau déionisée non conductrice pour les applications sensibles aux dommages électrostatiques.



Les deux versions couvrent la plage de débit : ADT947 de 3 à 10 litres/min et AB47 de 7 à 20 litres/min

Résistivité de 0,5 à 1 MΩ.cm

Contrôle par PID pour une résistivité précise avec compensation de la température

Écran tactile pour la sélection des paramètres, l'affichage de l'état et la surveillance du processus

Compact : 190 x 492 x 447 mm, 13 kg

INSPECTION ET TEST

► Inspection - die et wirebond

ROYCE

INSTRUMENTS

PARMI

ROYCE AP+ Die sorter automatique avec inspection

Fort de leurs compétences sur les Autoplacer et du travail en commun avec le leader de la mise en Tape&Reel Royce propose cet équipement modulable de haute technologie entièrement automatique. Le chargement en waffle pack ou gel pack 2» & 4 », Jedec Tray, Film Frame, ... et autre support spécifique client est toujours possible.



Large gamme de puces (250µm à 25mm pour sortie en Packing et 500µm à 17mm pour sortie en Tape and Reel)

Intègre la fonction wafer mapping (mono ou multi taille de puces) ou reconnaissance point d'encre

Jusqu'à 2000 composants / heure

Précision de placement et de répétabilité jusqu'à +/-12,5µ

Préhension par aspiration, facet contact sans contact, ou spécifique client

Setup rapide et conviviale par programmation de type «Pas à Pas»

Passage du mode Tape and Reel <-> Packing facilité (moins de 10 min)

Option inspection optique automatisée

XCEED MICRO Inspection automatique pour les semiconducteurs

Xceed MICRO est une machine de 2D et 3D AOI précise et à grande vitesse. Il est optimisé pour les inspections requises dans les processus d'assemblage de PCB, lead-frame, FC, SiP les procédés d'assemblage tels que die attach, cu clip attach, underfill, solder paste et ball attach. «Xceed MICRO» offre une capacité d'inspection 2D précise tout en effectuant des inspections 3D à haute vitesse (hauteur, inclinaison, levage et volume) avec son faisceau laser hautement focalisé. En outre, 'Xceed MICRO' est la seule machine capable d'inspecter simultanément des matières étrangères / la contamination et le flambage de la surface du « Die », « lead Frame » et des PCB.



Balayage laser extrêmement rapide

Double laser hautement focalisé pour la génération de données 3D

Le laser 3D peut inspecter des surfaces très réfléchissantes (bare die, IPD, die attach, and underfill fillet)

Large bande passante sur une large gamme de couleurs, de rugosités et de matériaux

Taux de faux défauts quasiment nul

► Shear & pulltest pour dies et wire bonds

ROYCE

INSTRUMENTS

ROYCE 610

Équipement de pull test

Équipement Manuel, Rotation du crochet par Souris. Simplicité et fiabilité. Pull tests jusqu'à 100gf. Large gamme d'outils disponible. Modules intégrant des sous gammes pour encore plus de précision.



Prix abordable, formation rapide des opérateurs.

Encombrement réduit.

Données exportables via RS232 ou imprimables.

Rapport de tests avec types de défauts, min, max, calcul statistique intégré (Moyenne, Écart Type, Cpk...).

Possibilité de connecté un PC, avec logiciel dédié permettant une sortie des résultats en différents formats (XLS, CSV, ...).

ROYCE 620

Équipement de pull & shear test semi-automatique

Équipement mixte pour les fonctions PullTest jusqu'à 10K et ShearTest (Limité à 5K). Modules interchangeables pour Pull et Shear. Modules intégrant des sous gammes pour encore plus de précision.



Table X, Y manuel avec système de manipulation 5:1

Axe Z motorisé avec une résolution de 0,1µm, Axe Theta motorisé

PC interne sous Windows, permettant le stockage des données de test et sortie des résultats et statistique en différents formats

Préprogrammé suivant les norme MIL-STD et JESD22

Compatible Test Tweezer, Push, Stud Pull

Système multi-langage incluant le Français

ROYCE 650

Équipement de pull & shear test semi-automatique

Équipement mixte pour les fonctions PullTest jusqu'à 10K et ShearTest jusqu'à 200K. Modules interchangeables pour Pull et Shear. Précision de répétabilité de 0,1% permettant une automatisation des test.



Motorisation des 4 axes avec une précision de 0,1µm et 0,1°

Support microscope motorisé permettant une ergonomie idéale pour l'opérateur

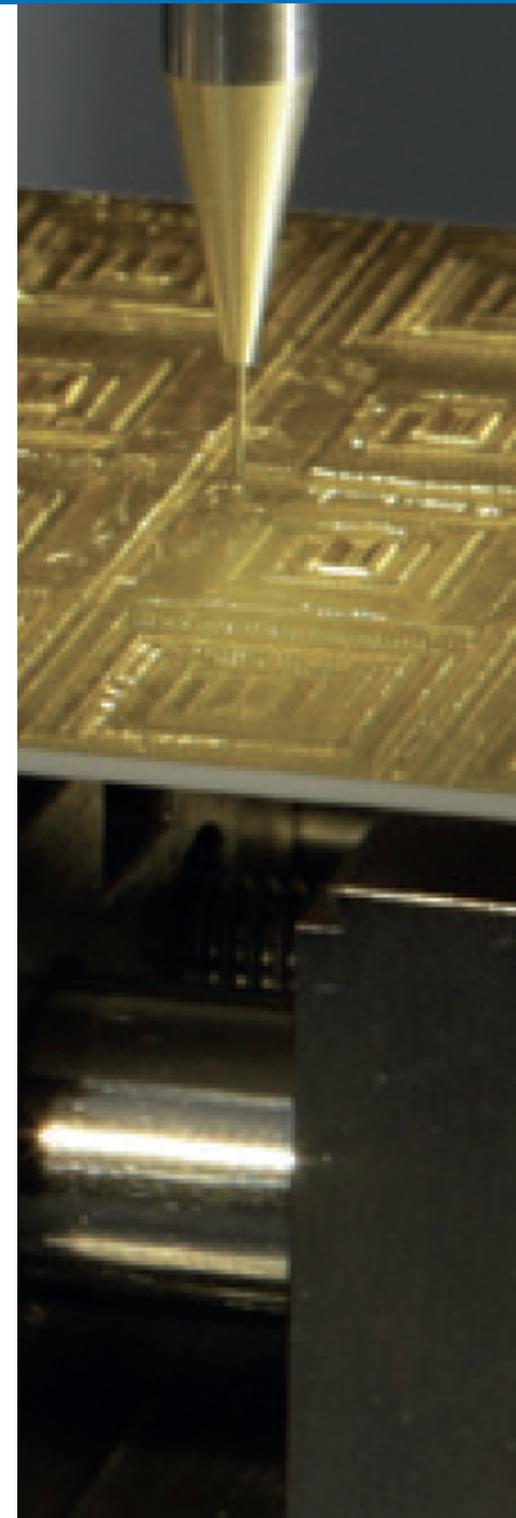
PC interne sous Windows, permettant le stockage des données de test et leur interprétation statistique

Compatible Test Tweezer, Push, Stud Pull

Diverses tables porte échantillon disponible sur catalogue ou spécifique produit client.

Système multi-langage incluant le Français.

Option capture vidéo des test disponibles.



WIRE BONDING, SMART ET LASER WELDING

► Câbleuses semi-automatiques fin et gros fil



TPT HB05 Câbleuse Manuel

Pour le câblage prototypes et petites séries. Idéale pour laboratoires de recherches et développement. Simplicité de mise en œuvre et intuitive. Équipement le moins chère dans le marché des câbleuses à ultrason.



Wedge et Ball bonding (Ruban en option)

Câblage de 17 à 75 μ wedge & 17 à 50 μ en ball bonding

Câblage ruban de 25 à 250 μ

Écran de commande de 4,3 "

Mise en mémoire de 20 programmes

Deep access 16mm

Contrôle indépendant de l'ensemble des paramètres 1er & 2ème bond

TPT HB10 Câbleuse semi-automatique

Pour câblage petites et moyennes séries. Idéale pour le développement et fabrications répétitives. Simplicité d'utilisation grâce ou mouvements motorisés en Z.



Wedge et Ball bonding et bump bonding (Ruban en option)

Câblage de 17 à 75 μ

Câblage ruban de 25 à 250 μ

Écran de commande tactile de 6,5" avec interface homme système simplifié

Deep access 16mm

Mise en mémoire de 100 programmes

Mouvement Z linéaire et motorisé

Pincés motorisés pour la contrôle de longueur de queue

Mode de fonctionnement : manuel, pas à pas, semi-automatique

TPT HB16 Câbleuse pour wire bonding semi-automatique

Pour câblage petites et moyennes séries, Idéale pour développement et fabrications répétitives. Simplicité d'utilisation grâce aux mouvements « Z & Y » motorisés. Jusqu'à 100 process mémorisables.



Wedge et Ball bonding et bump bonding (Ruban en option)

Câblage de 17 à 75 μ

Câblage ruban de 25 à 250 μ

Écran de commande tactile de 6,5" avec interface homme système simplifié

Deep access 16mm

Mise en mémoire de 100 programmes

Mouvement Y&Z motorisé

Pincés motorisés pour la contrôle de longueur de queue

Mode Table Tear pour cassure de fil disponible

Mode de fonctionnement : manuel, pas à pas, semi-automatique

TPT HB30

Câbleuse semi-automatique gros fil

Pour câblage petites et moyennes séries, idéale pour développement et fabrications répétitives. Simplicité d'utilisation grâce aux mouvements « Z & Y » motorisés et à la coupe du fil (back cut) programmable et automatique.



Wedge bonding de 100 à 500µ

Option Ruban de taille maximum : 2000*300µm

Écran de commande tactile de 6,5"

Mise en mémoire de 100 programmes

Mouvement Y et Z motorisé permettant un contrôle programmable des boucles

Couteau motorisé et programmable

Mode de fonctionnement : manuel, pas à pas, semi-automatique

► Câbleuses automatiques fin fil, ball et wedge

HESSE

MECHATRONICS



TPT HB100

Câbleuse automatique pour wirebonding fin-fil, ball et wedge

Pour câblage moyennes séries possédant un nombre de fil élevé, idéale pour le développement et fabrications répétitives. Simplicité d'utilisation grâce aux mouvements « Theta, X, Y et Z » motorisés. Programmation des fils de câblage par apprentissage sur écran tactile, possibilité d'un bras microscope pour surveillance durant le câblage. NOUVEAUTÉ 2020: PRS Disponible.



Wedge et Ball bonding et bump bonding.

Câblage de 17 à 75µ, ruban de 25 à 250µ

Écran tactile de 21 pouces

Double caméra (Overview et x150)

Deep access 16mm

Mise en mémoire de plus de 1000 programmes

Mouvement Theta répétable pour câblage en Wedge dans toutes les directions

Machine Tabletop ayant une large zone de travail motorisée

Mode de fonctionnement : manuel, pas à pas, semi-automatique et full automatique

BJ855

Câbleuse automatique pour wirebonding ball et wedge

Compatible en wedge ou ball pour les applications de type composants RF, COB, MCM, hybrides, opto-électroniques et électroniques du véhicule. Process fiable, rapide, précis et répétable. Bondhead robuste - conçu sans usure et sans entretien.



Work area X : 305 mm; Y : 410 mm

Fils : Al, Au : 12,5 à 75 µm ; Cu : 17,5 à 30 µm

Ruban Al, Au : 35x6 µm à 250x25 µm

Nouvelle Interface riche en fonction

E-Box : alignement d'outils

Calibrage automatisé de la force

PRS rapide avec traitement d'image numérique et flash

Bondhead - wedge: 95 kHz ou 135 kHz ; 45°, 90°

Bondhead - Ball: 120 kHz ou 60 kHz ou dual 120/60 kHz avec débattement en Z de 31 mm.

BJ653 Câbleuse automatique pour wirebonding multifonction

Compatible en wedge ou ball pour les applications de type composants RF, COB, MCM, hybrides, opto-électroniques et électroniques du véhicule. Process fiable, rapide, précis et répétable. Bondhead robuste - conçu sans usure et sans entretien.



Plateforme compatible avec tous bondhead Hesse BJ855/BJ95X

Compatible avec tous des applications fait par BJ855/BJ95X

Work area X : 100 mm ; Y : 90 mm ; Z : 50 mm,

Pull test intégré pour fil et ruban – non destructif

Nouvelle Interface riche en fonction

E-Box : alignement d'outils

► Soudage des connexions de puissance

HESSE

MECHATRONICS

BJ955/9 Câbleuse automatique gros- fil et ruban

Câbleuse gros fils et ruban en Alu et cuivre conçu pour production avec multiples lignes d'automatisation. Les fonctions intégrées facilite l'utilisation en production: Ebox, calibration automatique, PRS, backup, login, SEC/GEMS, Process fiabilisé, rapide, précis et répétable. Bondhead robuste - conçu sans pièce d'usure et nécessitant pas d'entretien.



BJ955 : X : 305 mm ; Y : 410 mm ; Z : 42 mm

BJ959 : X : 370 mm ; Y : 560 mm ; Z : 42 mm

Pull test intégré pour fil et ruban – non destructif

Nouvelle Interface riche en fonction

E-Box : alignement d'outils

Calibrage automatisé de la force

PRS rapide avec traitement d'image numérique et flash

Bondead fils Al, Cu, AlCu : 50 à 600 µm

Bondhead ruban Al, Cu, AlCu : 250x25 µm à 2000x400 µm

Bondhead Fil Cu : 50 à 600 µm

BJ985 Câbleuse automatique gros fil et ruban grand formats

Plateforme gros fil & ruban avec un espace de travail de 370 mm x 870 mm destiné pour des application assemblage type batterie. Des grandes ouvertures latérales et un système d'indexation spécifique permet le chargement des substrats de très grandes taille.



Work area X : 370 mm ; Y : 870 mm ; Z : 42 mm,

Pull test intégré pour fil et ruban – non destructif

Nouvelle Interface riche en fonction

E-Box : alignement d'outils

Calibrage automatisé de la force

PRS rapide avec traitement d'image numérique et flash

Bondead fils Al, Cu, AlCu : 50 à 600 µm

Bondhead ruban Al, Cu, AlCu : 250x25 µm à 2000x400 µm

Bondhead Fil Cu : 50 à 600 µm

SW1089

Équipement de soudage ultrasonique intelligent pour batteries

Plate-forme avec une gamme de têtes spécifiques pour le soudage par ultrasons de pièces métalliques. Espace de travail de 370 mm x 870 mm pour les applications de connecteurs de puissance pour les modules et les batteries. Les grandes ouvertures latérales et l'indexation spécifique permettent de charger et d'indexer de très grands substrats.



Zone de travail X : 370 mm ; Y : 870 mm ; Z : 42 mm

Soudage jusqu'à 1500Watts pour le soudage de barres de cuivre de 3,5x3,5x1,2mm

Navigation de précision par caméra

Détection de contact

Contrôle fin de la force, énergie US et de la déformation pendant le soudage

Métrologie de la qualité de la soudure (PIQC)

Option pour la prise, placement et le soudage de connecteurs sur des modules - pour des connexions de câbles pushfit

LW1089

Équipement de soudage laser

Le soudeur laser LW1089 assure le soudage précis et reproductible de fils en aluminium et cuivre sur substrats DCB, grâce à une modulation de puissance laser et un dispositif de maintien anti-contamination. Son concept « serrer et souder » facilite l'adaptation rapide et flexible aux variantes de produits.



Grande zone de travail : 400 mm _ 400 mm _ 75* mm (X_Y_Z)

Temps de soudage rapides

Différentes géométries et profondeurs de soudure grâce à la modulation temporelle et spatiale de la puissance laser

Axe vertical actif avec technologie de capteur

Un capteur de détection de contact, combiné à une force de maintien réglable, évite d'endommager les partenaires de contact sensibles

Source de faisceau laser de 1,5 kW

Reconnaissance d'image (PR) pour une détection précise et une correction de l'emplacement de la soudure

Charge mécanique et thermique minimale

Surveillance du processus via des capteurs pour l'éclairage du processus (plasma, éclairage thermique et rayonnement rétro-diffusé)

BJ931

Câbleuse automatique double têtes pour application leadframe

Câbleuse conçue pour les applications lead frame matricielle nécessitant un câblage par gros fil avec deux diamètres de fil variables (ou ruban et fil). Zone d'entrée et de sortie automatisées (Magazine to Magazine), Indenseur, axes linéaires permettent une forte augmentation de cadence.



Workarea X : 100 mm ; Y : 90 mm ; Z : 48 mm

Pull test intégré pour fil et ruban – non destructif

Nouvelle Interface riche en fonction

E-Box : alignement d'outils

Calibrage automatisé de la force

PRS rapide avec traitement d'image numérique et flash

Bondhead fils Al, Cu, AlCu : 50 à 600 µm

Bondhead ruban Al, Cu, AlCu : 250x25 µm à 2000x400 µm

Bondhead Fil Cu : 50 à 600 µm

Magazine to magazine automation for leadframe handling

INTERFACE, QUALITÉ ET AUTOMATION

Fonctions supplémentaires des câbleuses automatiques Hesse

Les bonders Hesse offrent une grande flexibilité grâce à un large espace de travail et des bondheads sans entretien, garantissant une soudure répétable. Le contrôle PIQC assure une qualité optimale via la surveillance de l'énergie US, fréquence, amplitude et contre-force.



Bondhead modulaire, interchangeable, avec mémoire intégrée, conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance

Assistance intégrée pour le changement des outils clampe et lame (E-Box)

Hesse Bonder Network (HBN) : Gestion des lignes et synchronisation des données avec intégration simplifiée via Plug & Produce

PBS Server & Workbench 2.0 : Gestion centralisée, sauvegarde automatique et détection de modèles à distance

Interface aux Manufacturing Execution System, implémentation intégrée ou personnalisée

PIQC Mesure de la qualité de chaque point de soudage en temps réel avec traçabilité

Automatisation spécifique pour répondre aux exigences industrialisation conçu pour un rendement bonding le plus élevé

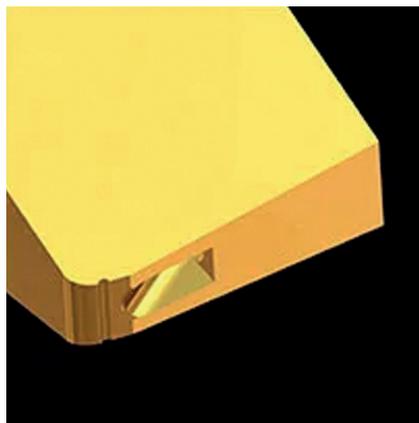
► Outils pour wirebonding



FIN FIL, GROS FIL, RUBAN, OR, ALUMINIUM, CUIVRE

Outils pour wirebonding tous types de fil

Deweyl propose outils en petites ou grandes quantités, avec production rapide pour prototypes. Pour garantir une qualité « zéro-défaut », Deweyl offre un contrôle visuel à 100 % (optionnel) avec fiche de mesures, assurant la conformité commande/livraison.



Large choix de matériaux

Céramique, Carbone de Titane, Carbone de Tungstène, ...

Compatible avec l'ensemble des équipements de câblage ultrasonique (Wedge Bonding)

Outils customisables pour répondre aux contraintes grandissantes des processus de câblage

Précurseur et Leader dans les outils finition céramiques

Précurseur sur de nombreuses nouvelles capacités de câblage (ie câblage coin de boîtier avec l'option A13, en photo)

Finition céramique pour les outils câblage gros fil, permettant de rallonger la durée de vie de l'outil

FABRICATION ADDITIVE (AME)

► Fabrication additive (AME)



NANODIMENSION

Electrifying Additive Manufacturing®

DRAGONFLY LDM 4.0 Machine de fabrication additive (AME)

Le LDM 4.0 est la plus avancée pour le prototypage rapide et la fabrication à faible volume d'électronique de précision imprimée en 3D. Le nouveau LDM4.0 inclut des améliorations matériels et des procédés optimisés pour la production : purge, durcissement/frittage et contrôle de l'impression, calibrage et alignement automatiques de l'impression.



Prototypage rapide : gain de plusieurs semaines sur un projet de développement

Confidentialité : fabrication en interne sécurisant la propriété intellectuelle

Innovation : conception avancée en 3D de produits plastroniques

Lieu de production : équipement compact et mobile

Environnemental : processus additif avec réduction des déchets

min track > 75µm

thickness: conductor > 17µm; dielectric > 50µm; pcb < 3mm

Switch Hub 1.2 – offline ECAD for Dragonfly LDM conversion and import of ECAD file to AME input print file

FLIGHT SW Suite for integration mCAD integration

PLASMA

► Plasma sous vide pour activation et décontamination

Nordson
MARCH

AP 600/1000 Traitement par plasma adaptable

Des solutions pour traitement de plasma par lots, avec une flexibilité de configuration des électrodes pour un plasma direct, indirect, «downstream» et «ion-free».



Processus plasma RF 13MHz pour les processus inorganique & organique

Chambre aisément configurable - direct, indirect, downstream

Chambre électrode - AP300: 33.0(D) x 19.0(W) cm, ou AP1000: 55.9(D) x 61.0(W) cm

Accords générateur RF automatique

Programmation aisée

Sauvegarde et gestion des programme, lecteur de code-barre, création de rapport de process et de traçabilité

Pompe à l'huile ou pompe sèche

FLEXTRAK Traitement par plasma pour processus en ligne

Équipement 13 MHz RF plasma avec chambre adaptée pour un temps de processus rapide.



Plasma system chambre 305W x 305D mm or 305W x 560D mm

Plasma 13MHz «on-line» fiable et robuste

Conçu pour un temps de processus rapide (Temps de chargement hors process à 15s)

SECS/GEMS interface

Sauvegarde et gestion des programme, lecteur de code-barre, création de rapport de process et de traçabilité

FLEXTRAK 2MB Traitement par plasma avec automatisation par boat en ligne

Flextrack avec automatisation en entrée / sortie sur deux lignes (indexeur). La conception est optimisée pour maximiser le temps de traitement au plasma avec un temps de cycle minimum.



Plasma system chambre 305W x 305D mm or 305W x 560D mm

Conçu pour un temps de processus rapide (temps de chargement pour deux Boat @ 20s, hors temps de process)

SECS/GEMS interface

Sauvegarde et gestion des programmes, lecteurs de codes-barre, création de rapport de process et de traçabilité

FLEXTRACK CD/CDS Traitement par plasma avec automatisation magasin à magasin

Flextrack avec automatisation de chargement/déchargement de plusieurs magasins. Traitement au plasma de plusieurs substrats ou supports en parallèle pour optimiser le temps de traitement au plasma pour une durée de cycle minimale. Configurations permettant de recharger le même magasin ou de le décharger dans des magasins. Options de traçabilité.



Plasma system chambre 305W x 305D mm
SECS/GEMS interface

Sauvegarde et gestion des programmes,
lecteurs de codes-barre, création de rapport
de process et de traçabilité

STRATOSPHERE™ & MESOSPHERE™ Traitement par plasma pour panneaux semi-conducteur grand format

StratoSPHERE™ nettoie les wafers jusqu'à 300 mm, éliminant contamination et résine photosensible. MesoSPHERE™ traite wafers et substrats jusqu'à 480 mm avec un très haut débit, garantissant efficacité et flexibilité pour des applications variées.



La conception et l'architecture de commande symétriques de la chambre F3 brevetées permettent des temps de cycle de plasma courts avec un faible surcoût et une excellente uniformité dans le process

Système StratoSPHERE™ avec sa conception modulaire permet une configuration à une ou deux chambres

Rapidité pour changement de configuration Wafer 200mm vers wafer 300mm, commandé via le logiciel

Le système MesoSPHERE, compatible avec des wafers de 300 mm et des substrats jusqu'à 450 x 450 mm, offre une flexibilité maximale grâce à un minimum de modifications matérielles. Son robot à deux bras sur trois axes garantit un haut débit pour diverses cassettes d'indexation

Évolution de la famille SPHERE pour des substrat jusqu'à 630*630mm

DIE ATTACH ET DIE SORTING

▶ Brasage en chambre vide/
pression



SST International

Your Partner for Microelectronics Assembly

SST 1200 Brasage sous vide/pression petit format

Le SST1200 est un four vide/pression de table pour les laboratoires et les productions de petit volume. Chauffe par énergie rayonnante d'un élément résistif en graphite. Chambre en aluminium et couvercle de verrouillage refroidi à l'eau incluant une grande fenêtre de visualisation. La plaque chauffante et l'outillage de traitement sont fabriqués à partir de graphite à haut rayonnement thermique.



Température maximale : 450 °C

Niveau de vide minimum : 0,13 mbar

Pression maximale d'utilisation: 4,5 bar

Zone chauffée : 125 mm x 100 mm

Surface de traitement recommandée : 115 mm x 90 mm

Gaz de traitement : N2 plus 1 en option

SST 5100

Brasage sous vide/pression

Le modèle 5100 est un four vide/pression programmable avec système de chauffe (450°C) et de refroidissement rapide. Le processus de chauffe est assuré sur toute la zone de travail par un élément graphite au dessous de la plaque et en périphérie. La plaque chauffante et les outils de traitement sont fabriqués à partir de graphite à haut rayonnement thermique.



Température de fonctionnement: 500 ° C

Zone de travail thermique: 305 x 305 mm

Niveau de vide minimum: <0,067 mbar

Niveau de pression de gaz de chambre maximal: 3,7 bar

Gaz de traitement: N2 requis, (Ar He et autre gaz en option)

Option acide formique Option Flux Trap

SST 3130

Brasage sous vide/pression jusqu'à 1000°C

Le SST 3130 permet un processus régulé pour des assemblages complexes. Un élément en graphite agit comme élément chauffant et support pour l'application, en générant une chaleur uniforme jusqu'à 1000°C.



Vide et Pression contrôlé

Élément chauffant en graphite compatible avec SST DAP d'origine et outillage pour processus complexes

Procédé optionnel à 1000 ° C

Pression de 4,5 bars / vide de 50mbar

Gaz de traitement: N2 requis, (Ar He et autre gaz en option)

SST 3150

Brasage à encapsulation ultravide avec activation du getter

Pour le scellement hermétique avec un vide élevé avec activation des getters. Ce modèle est doté d'une pompe à vide secondaire - turbo ou cryogénique pour une vide ultra-poussé. Cette solution avec son outillage permet l'activation des « getters », un vide important, l'assemblage mécanique et le scellement en un seul processus.



Chambre à vide ultra haute (10-9mbar)

Activation du getter et scellage sous vide en un processus

Système d'exploitation PC / Windows intégré

Interface par écran tactile 15 pouces

Différent niveau d'autorisation : Programmeur, Opérateur, Maintenance personnalisable

SST 3250

Wafer bonder sous atmosphère contrôlée

Le SST 3250 est conçu pour le wafer bonding pour les wafers de 150-200mm diamètres. L'équipement assure un contrôle précis sur les paramètres du processus en pression et température, de façon automatique et programmable. Le système permet une montée en température jusqu'à 350°C avec une précision de contrôle de 1°.



Chambre pression 1 x 10⁻⁷ mbar jusqu'à 0,8 bar

Jusqu'à trois entrées de gaz de traitement

Température jusqu'à 350 ° C avec une précision de 1 ° C

Système d'exploitation PC / Windows intégré

Interface par écran tactile pouces

SST 8300

Brasage sous vide/pression chargement automatique

Le SST 8300 est un four vide/pression autonome ou en adaptation d'une ligne production. Le SST 8300 fournit un volume élevé de chargement dans une chambre simple (SST 8301) ou triple (SST 8303). Chaque chambre du SST 8303 exécute un processus complet permettant l'exécution de plusieurs processus en parallèle. L'interface logicielle conviviale fournit une synthèse graphique des données pour l'analyse des processus en temps réel.



Température de fonctionnement: 500 ° C

Surface de traitement thermique: 330 x 470 mm par chambre

Niveau de vide minimum: <0.067 mBar

Niveau de pression de gaz maximale dans la chambre: 3.8 Bar

Gaz de traitement: N2 requis, (Ar He et autre gaz en option)

► Die bonder manuel

TRESKY

T-4909-AE

Die Bonder économique

Pour le die attach petites et moyennes séries. Idéale pour la recherche et développement, cet équipement est simple d'utilisation et évolutif suivant vos besoins. Applications: Die Attach, Flip-Chip, MEMS, MOEMS, VCSEL, RFID, Adhesive Bonding, Eutectic Bonding, ...



Déplacement en Z suivant la technologie «True Vertical» sur 95mm

Force contrôlée (20g à 1000g)

Dispenser intégré (Temps/pression)

Déplacement X/Y manuel avec vis micrométrique (180mmx180mm)

Rotation à 360° du PU Tool

Précision de placement 5µm

Option: camera bidirectionnel pour un alignement d'une précision inférieur au micron

Interface opérateur simple et intuitif

Écran tactile, avec mémorisation des paramètres process et profils

Nombreuses autres options : chauffe statique de l'outil et statique ou dynamique du substrat, stamping, forming gaz, moniteur de contrôle

T-5100 ET T-5100-W

Die Bonder manuel de haute précision

Équipement manuel pour die attach en petites et moyennes séries, simple d'utilisation et évolutif. Doté d'une caméra, il offre une répétabilité exceptionnelle. Applications : Sub-Micron Bonding, Flip-Chip, Eutectic Die Attach, TO Bonding, Thermosonic, et plus.



Déplacement en Z suivant la technologie «True Vertical» sur 125mm

Force contrôlée (20g à 1000g)

Dispenser intégré (Temps/pression)

Déplacement X/Y manuel avec vis micrométrique (220mmx220mm)

Rotation à 360° du PU Tool

Précision de placement < 1µm (opérateur dépendant)

Option: camera bidirectionnel et écran HD pour un alignement d'une précision inférieur au micron

Disponible en version -W (Extraction des puces directement du Wafer)

Interface opérateur simple et intuitif

Option: Chargement des composants sur wafer 200mm avec éjecteur pneumatique / Nombreuses options : chauffe statique de l'outil et statique ou dynamique du substrat, die invertteur, eutectique avec «scrubbing», thermosonique

▶ Die bonder semi-automatique

TRESKY



TPT HB75 Die bonder semi-automatique

Pour le câblage prototypes et petites séries et travaux de réparation. Idéale pour laboratoires de recherches et développement. Simplicité de mise en œuvre et intuitive. Enregistrement des paramètres (Force, Hauteurs, Temp) pour un remise en route rapide des process. Nouveauté 2020: Maitrise de la dose de Stamping par pôt à rotation motorisé.



Axe Z motorisé pour contrôle de la force, par capteur de force

Triple tête rotative permettant le Stamping / Dispensing et le placement des puces sans changement d'outillage et sans reprise de l'apprentissage de hauteur

Large gamme pour la taille des puces de 100*100µm à 20*20mm

Option dispenser et plateau chauffant pour répondre à la majorité des besoins en Pick and Place

Compatible Dispense type Globe Top.

Die Career pour Waffle pack 2"

Mise en mémoire de 100 programmes

T-5300 ET T-5300-W Die Bonder semi-automatique de haute précision

Plateforme de die bonder manuelle avec axe Z et éjecteur motorisés, offrant précision et maîtrise via l'interface Windows10/T-suite. Ses options couvrent tous types de processus de report, garantissant simplicité, fiabilité et reproductibilité pour les applications complexes.



Déplacement automatisé en Z suivant la technologie «True Vertical» sur 125mm

Force contrôlée (20g à 4000g)

Dispenser intégré (Temps/pression)

Déplacement X/Y manuel avec vis micrométrique (220mmx220mm)

Rotation à 360° du PU Tool

Précision de placement < 1µm (opérateur dépendant)

Option: camera bidirectionnel et écran HD pour un alignement d'une précision inférieure au micron

Interface Utilisateur sous Windows 10, simple et intuitif intégrant l'ensemble des fonctionnalités de l'équipement et de ses options

Option: Chargement des composants sur wafer 200mm avec éjecteur motorisé

T-5500 Die Bonder semi-automatique «high force»

La T5500 ajoute une force allant jusqu'à 1000 N en combinaison avec une action verticale, garantissant une coplanarité absolue entre la puce et le substrat à n'importe quelle hauteur pendant le processus. La machine convient des processus de frittage avec une force et une chaleur contrôlées. La T5500 est équipée des axes Z et Theta motorisés.



Déplacement automatisé en Z suivant la technologie «True Vertical» sur 120mm

Force contrôlée (20g à 100KG)

Dispenser intégré (Temps/pression)

Taille du substrat max: 400mmx280mm

Rotation à 360° du Pick up Tool (motorisé)

Répétabilité < à 10µm en X/Y, 1µm en Z (opérateur dépendant)

Interface utilisateur sous Windows 10, simple et intuitif

Possibilité d'intégrer une optique permettant une résolution optique inférieure au µm

Disponible avec Dispenser volumétrique en option

Applications diverses possibles : thermocompression, UV curing, eutectic, flip-chip...

► Die bonding automatique



Besi

EVO2200 Die bonding automatique haute précision multi-chip multi-processus

Le Die Bonder EVO2200 offre une plateforme polyvalente, robuste et fiable, adaptée aux procédés de report de puces, y compris les applications de haute technologie et les fortes cadences. Idéal pour les procédés « multi-chip » et « flip chip » en production.



Chargement des die par wafer 8» ou 12», waffle pack, Gel-Pak®, ou tape feeder
Application par substrat, boat, lead frame, dimensions 200*300mm

Alignement automatique (PRS)

En option, deuxième axe indépendant, pour haute cadence (jusqu'à 7,000 uph)

Interface SECSGEMS

Précision @3 sigma: 2200evo @ 10µm ; 2200evoPlus @ 7µm ; 2200EvoAdv 3µm / 0.07°

2200evoHF - pour des processus sintering : avec force et température : 500N/300°C support et 450°C par la tête

Options UV curing, eutectec bonding

Options : dispensing par jeter : volumétrique, temps/pression de précision

ESEC 2100 / 2100DS Die bonding automatique haute cadence pour leadframe et strip

Système dédié au besoin de cadence élevée (jusqu'à 12000 UPH) pour placement sur leadframe (monopuce).



2100SC Reel Feed pour les applications de cartes à puce

2100sDplus / sDPPPplus pour les applications de puce empilées. Tête double / précision de placement 12 µm @ 3 Sigma

2100HS Temps de cycle vitesse élevée 120 ms / emplacement 20 µm à 3_, dimensions de la strip allant de 100 à 300 mm

2100FC plus avec fonctionnalité flip-chip

L'Esec 2100 DS est une solution flexible et polyvalente pour le brasage et le frittage par diffusion

La système comporte un tunnel thermique modulaire adapté au leadframe et au contrôle du processus thermique. Une soudure est distribuée à partir de fil et appliquée en masse et en surface contrôlées

Tunnel Thermique

Cadence jusqu'à 8000 UPH

8800 CHAMEO ADVANCED

Die bonding automatique haute cadence flip-chip

Une solution flip-chip pour production en haute cadence.



8800 TC Adv - Collage par thermo-compression pour emballages 2.5D / 3D C2S et C2W, avec TC-CUF. Comporte une tête de liaison unique à 7 axes

8800 FC QUANTUM précision ± 5 microns @ 3 Sigma, Cadence jusqu'à 9000UPH. Compatible puce ultra-fine, des leadframe, wafers jusqu'à 8 «... En option, système d'inspection intégré

8800 CHAMEO Adv - WL-FOP, emballage multi-puce à Thermo compression et reflow locale. Précision ± 5 µm @ 3 Sigma

ENCAPSULATION

► Dispense pour glob-top, dam & fill, et underfill

GPD Global
Precision Dispensing Systems

CATALINA Dispenseur automatique simple pompe

Le modèle Catalina permet l'automatisation de travaux simples et répétitifs avec une grande polyvalence et précision. Le Catalina est fourni avec toutes les fonctionnalités d'une machine automatique. Elle est compatible avec l'ensemble des pompes GPD Global incluant MicroDot à vis AUGER, HyFlow pour la dispense large volume, et PCD pour la dispense volumétrique.



Zone de travail X,Y,Z, 300x300x100mm

Vitesses X,Y de 600mm/s et Z de 500 mm/s

Répétabilité X,Y Z de +/- 20_μm

Alignement automatique par camera haute résolution

Détection surface par laser

Contrôle Windows

Programmation par camera ou par l'interface

Importation des fichier DXF

Table chauffante en option

Dimensions 595*700*750mm/Poids 50kg

MAX SERIE Dispenseur automatique pour production en ligne

La Max Series est une plateforme de dispense automatique multi-procédés, intégrable en ligne ou en îlot. Compatible avec divers types de fluides (colles mono/bi-composants, crèmes à braser, silicones), elle s'adapte grâce à des valves de dispense spécifiques.



Convoyeur PCB intégré

Surface de travail de 358 x 305 x 70 mm

Plateforme pour produit grand format 609 x 609mm

Configurable selon application avec valve temps pressions, vis d'Archimède, jetting, volumétrique

Convient au dépôt de crème à braser, de colle, d'encapsulant, de joint, de dam&fill, de glob top etc...

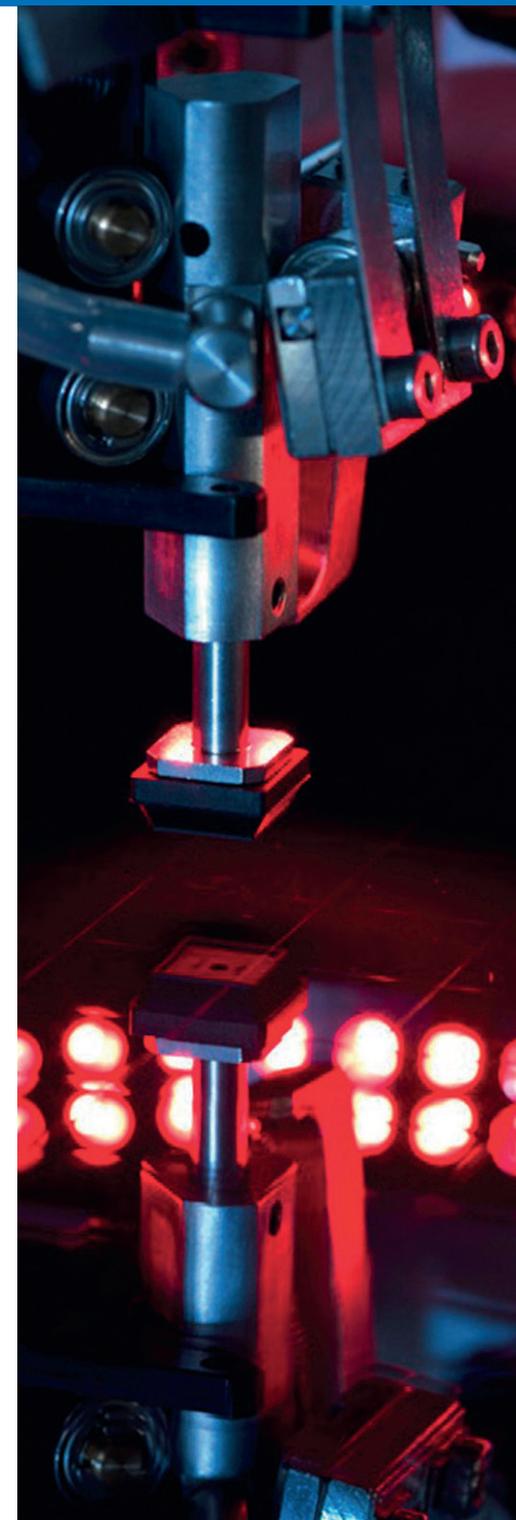
Mutli-usage avec changement de valve rapide

Système de régulation de pression valve pour une dispense optimum unique sur le marché. Solution adaptable à tous types de valves

Système chauffant pour valve et support produit

Mélangeur pour colle bi-composants

Faible empreinte au sol 937 x 1191 x 1525 mm



► Surmoulage et singulation



Besit

AMS-LM ET MMS-LM Surmoulage des PCB simple face automatique ou manuel

Les systèmes AMS-LM et MMS-LM sont conçus pour mouler des panneaux, bandes et wafers pour les packages complexes tels que SIP, flip chip, moulage sélectif, dies exposés, simple ou double face, et MEMS. Le design modulaire, avec 35 % de pièces mobiles en moins, permet des conversions rapides avec des outils peu coûteux.



La MMS-LM, manuelle pour la production ou le nettoyage de moules hors ligne

AMS-LM : Automatisation avec correction de l'orientation, préchauffage, anti-déformation et transport par coussin d'air pour cartes fines

Option : Inspection visuelle à l'entrée et à la sortie

Bandes jusqu'à 102 x 280 mm

Moulage sélectif et flip chip, boîtiers moulés avec dies nus exposés

Force élevée : 600 kN, avec contrôle dynamique

Vide profond pour le moulage de packages complexes

Gestion de purge d'air dynamique

Compensation de l'épaisseur du substrat

Option avec feuille

AMS-X ET MMS-X Surmoulage des cadres cuivre automatique et/ou manuel

Les plateformes AMS-X et MMS-X sont une nouvelle génération de presses à mouler conçues pour les applications avancées de leadframes de puissance et les leadframes à haute densité.



La MMS-X, manuelle pour production ou le nettoyage de moules hors ligne

L'AMS-X, automatisée, comprend trois presses, magazine chargement/déchargement

option inspection visuelle à l'entrée et à la sortie

Leadframes jusqu'à 125 x 300mm et épaisseur jusqu'à 10 mm

Moulages des produits à haute densité et puissance

Force élevée 1800 kN et uniforme avec contrôle dynamique

Compatible avec : flip chip ; die exposé ; die empilé ; SIP ; ...

Faible consommation de matériau

FICO COMPACT LINE™ Découpe, séparation et mise en forme des leads

Pour la découpe, séparation et formage des connections du boîtier après le moulage. Une modularité de la conception offre une flexibilité dans les combinaisons pour plusieurs chargeurs et déchargeurs avec une conception compacte qui réduit considérablement l'espace au sol. Des options sont disponibles tel que les modules de marquage laser, l'inspection visuelle, la traçabilité des produits et des lots. Convient aux leadframes de Extreme High Density (EXHD) jusqu'à 4 pouces de large.



FCL-X pour les applications à haute densité : pour une singularisation de 0,4 mm dans les leadframes. Avec sortie vers un déchargeur en vrac

FCL-P pour les produits de puissance : pour une singularisation de 2 mm des leadframes. Avec sortie vers un déchargeur de tubes à gravité

Cadres de plomb jusqu'à 125 mm de large x 300 mm de long

Force de pression 50 kN

Manipulateur de magasin à double pile

Inspection par vision

Changement d'outil facile

FSL FICO SAWING LINE

Ligne intégrée pour la sciage et le tri des PCB surmoulés

Le système de singularisation intégré FSL est conçu pour une efficacité maximale au mètre carré. Le processus en quatre étapes comprend la coupe des produits à partir d'une bande, le nettoyage, l'inspection et le tri. Il utilise une coupe sans tape avec un maintien supérieur sous vide. Les produits sont ensuite nettoyés, inspectés et triés avant d'être livrés sur des plateaux JEDEC.



Sciage et triage en une seule station avec un processus sans tape pour substrats jusqu'à 100 x 300 mm

Sciage avec double broche de 2,5 kW et lames de 3 pouces, avec option de coupe en escalier « wettable QFN »

Dimensions : 3,6 x 1,5 m et cadence jusqu'à 34 000 UPH

Dimensions des produits : de 1,6 mm à 50 mm

Nettoyage, séchage, inspection et triage

Sortie à 9 têtes avec ajustement du pas pour plateau JEDEC, en option vers bande/tube/bulk

Conversion rapide pour différentes dimensions de produit et de substrat

Surveillance du processus en temps réel

► Fermeture hermétique



AMADA MIYACHI AMERICA, INC.

SM8500

Fermeture à mollette

Le SM8500 est conçu pour le scellement hermétique par électrodes à mollettes des capots sur des boîtiers carrés, rectangulaires ou ronds. Un générateur de courant avec régulation en boucle fermée assure des impulsions contrôlées (rampe). Ce dispositif permet le scellement de boîtiers fragiles ou sensibles à la chaleur. Le SM8500 peut être utilisé soit comme unité autonome, soit totalement intégré dans une boîte à gants.



Procédé d'étanchéité hermétique robuste avec un excellent joint de soudure reproductible

HF25 Alimentation de soudage à rétroaction en boucle fermée à 25 kHz avec impulsions de soudage basées sur la position et soudage en angle adaptable

Force d'électrode programmable

Programmation flexible comprenant le soudage à quatre passes pour un procédé de soudage spécifique grandes pièces.

Nombreuse options de pointage

AF1250

Fermeture à mollette collective

L'AF1250 est conçue pour le scellement hermétique des capots sur des boîtiers carrés et rectangulaires, par processus collectifs, automatiques, robustes et reproductibles. Un système de vision haute résolution permet un placement de haute précision du capot sur le boîtier.



Procédé d'étanchéité hermétique robuste avec un excellent joint de soudure reproductible

HF25 Alimentation de soudage à rétroaction en boucle fermée à 25 kHz avec impulsions de soudage basées sur la position et soudage en angle adaptable

Force d'électrode programmable

Programmation flexible comprenant le soudage à quatre passes pour un procédé de soudage spécifique grandes pièces

L'option automatique d'alignement et de positionnement du couvercle, soudage par point pour maintenir le couvercle ; logiciel de vision facile à programmer

L'option de chargeur de magasin automatisé se charge par le haut ou par le bas pour un système de manutention de pièces entièrement ou semi-automatisé

PULSAR

Fermeture par soudage global

Pour le soudage par décharge pour les « soudure globale » des capots ronds type TO ou rectangulaires. Décharges jusqu'à 9000 Joules avec des électrodes de 1" ou 2" de diamètre. Un concept mécanique précis et rigide pour éliminer les éclats de soudure. En option une indexation rotative pour atteindre une forte cadence.



Soudage par simple décharge pour le scellage des têtes hermétiques circulaires et rectangulaires

Impulsion électrique jusqu'à 9000 joules

Indexation rotationnelle optionnelle

AX5000/MX2000

Enceinte sèche automatique avec sas chauffant

Enceinte à atmosphère contrôlée pour des processus scellement hermétique. Contrôle d'humidité automatique. Un ou deux four à vides intégrant des plateaux chauffés individuellement, et un cycle de séchage programmable.



Le boîtier atmosphérique AX5000 est contrôlé par Windows®. Un Logiciel de traçabilité fournit un historique de la production, incluant les interruptions de process

Quant au MX2000, il est contrôlé par PLC

Options : analyseurs de gaz, contrôleurs d'humidité, environnementaux,... , pour répondre à vos exigences de process uniques, disponible sur les deux modèles

Option assécheur

ALPHA GLOVBOX

Enceinte sèche avec sas chauffant

Enceinte à atmosphère contrôlée économique pour des processus scellement hermétique via SM8500 ou Pulsar. Contrôle d'humidité automatique. Une four à vide avec cycle de séchage programmable et un sas de déchargement.



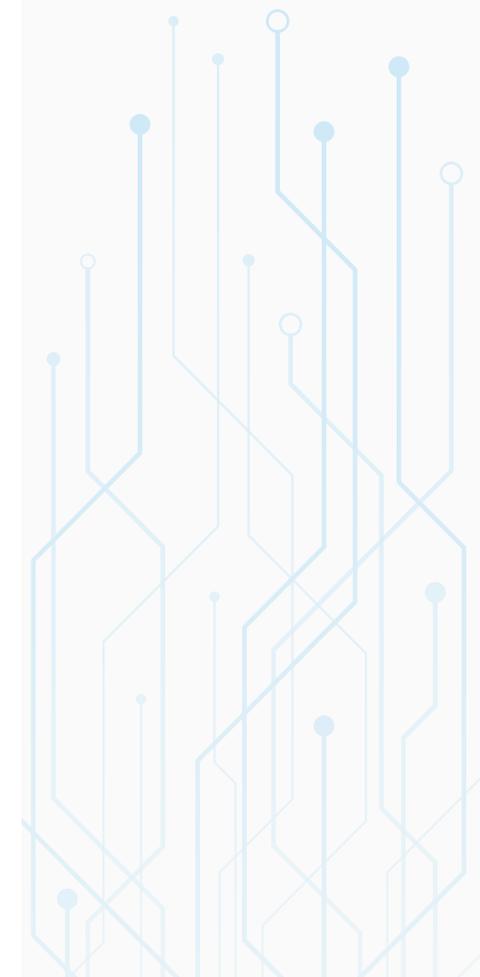
Options : mélangeur de gaz process avec contrôle actif

Options : senseurs helium, oxygène

Faible coût de maintenance

LOGICIEL MICROÉLECTRONIQUE

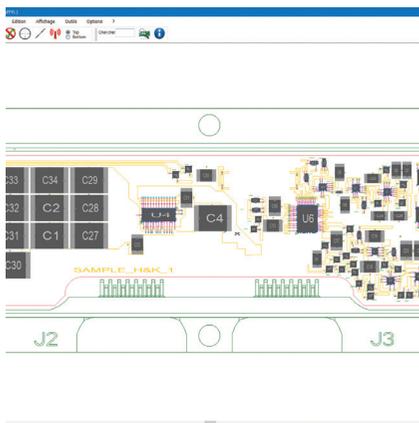
► Logiciels microélectronique



WIREBONDXPRT

Création de programmes de Bonding pour les machines Hesse

Issu de l'expérience et du partenariat qui lie Accelonix et Hesse Mechatronics, WireBondXpert est une solution logicielle innovante de création de programmes de câblage pour le monde de l'industrie de la Micro-électronique.



Importation des données CAO ou DXF afin de visualiser le produit à câbler.

Création des différentes références machines et optimisation du placement des fils

Simulation de la séquence de câblage

Génération des programmes de câblage pour tous les WireBonders Hesse Mechatronics.

ADMINISTRATION COMMERCIALE

Le back office

Le back office est le soutien indispensable des commerciaux et des techniciens dans la rédaction et l'envoi des devis (pièces, consommables, prestations et formations), ainsi que dans la création et le traitement des commandes (clients/fournisseurs), le suivi des livraisons et la facturation.

Son étroite collaboration avec des prestataires spécialisés complète la solide expérience du service dans l'import/export, les flux nationaux et la manutention.

En fonction de votre demande, vous pouvez les contacter aux adresses suivantes :

Devis -> devis@accelonix.fr

Commandes -> commande@accelonix.fr



MÉTROLOGIE DE DÉFORMATION THERMIQUE

► Métrologie de déformation thermique



TTSM Métrologie de coplanarité des surfaces

Mesure de la topologie de surface à température ambiante des substrats jusqu'à 330 x 300 mm.



Temps de mesure de 2 secondes

Résolution par Moiré : 100 LPI à 2,5 µm ; 200 LPI à 1,25 µm ; 300 LPI à 0,85 µm

Akrometrix Studio : pour la génération de rapports et l'analyse

Traçabilité avec plusieurs pièces par cycle thermique

Comparaisons et analyses de surface avec corrélation sur plusieurs pièces

Suivi des pièces – plusieurs pièces dans un cycle thermique

Option pour l'automatisation du système en ligne

PS200/PS600 Mesure dynamique de déformation thermique au cours d'un véritable cycle de refusion

PS200S/PS600S utilise le procédé Moiré pour mesurer la déformation thermique en conditions dynamiques jusqu'à 300°C pendant un cycle de refusion. Avec un champ de vision de 200 x 200 mm pour le PS200 et de 600 x 600 mm pour le PS600, la mesure en Z a une résolution de 0,85 µm.



Cycle de refusion typique de 20 minutes, avec un chauffage à +1°C/s et un refroidissement à -1°C/s

Uniformité de température de ±15°C et ±10°C pour la partie inférieure

Temps de mesure de 2 secondes

Résolution par Moiré : 100 LPI à 2,5 µm ; 200 LPI à 1,25 µm ; 300 LPI à 0,85 µm

Plage de température jusqu'à 300°C

Akrometrix Studio : pour la création de recettes, la génération de rapports et l'analyse

Traçabilité avec plusieurs pièces par cycle thermique

Comparaisons et analyses de surface avec corrélation sur plusieurs pièces

AXP3.0 Mesure dynamique de déformation thermique à haute résolution avec refroidissement

AXP3.0 utilise le procédé Moiré pour mesurer la déformation thermique en conditions dynamiques, de -55°C à 350°C, pendant un cycle de refusion. Il offre un champ de vision de 375 x 375 mm et une résolution allant jusqu'à 0,5 µm. La plate-forme est compatible avec d'autres méthodes de mesure : corrélation d'images numériques (DIC) et projection de franges numériques (DFP).



Cycle de refusion typique de 8 minutes, avec un chauffage à +3,5°C/s et un refroidissement à -2,25°C/s

Uniformité de température de ±5°C et ±2°C pour la partie inférieure

Temps de mesure de 2 secondes

Résolution par Moiré : 100 LPI à 1,5 µm ; 200 LPI à 0,75 µm ; 300 LPI à 0,5 µm

Refroidissement et échappement améliorés avec réduction des effets de vibrations

Plage de température de -55°C à 350°C

Akrometrix Studio : pour la création de recettes, les rapports et l'analyse

Traçabilité avec plusieurs pièces par cycle thermique

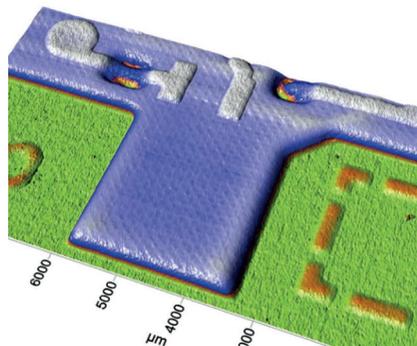
Comparaisons et analyses de surface avec corrélation sur plusieurs pièces

► Métrologie des surfaces par capteur optique

CYBER
TECHNOLOGIES

ANALYSE PUISSANTE Fonctions profilométriques

Fonctionnement 1 capteur optique + 2 en option en fonction de la matière, type de métrologie et précision. Un contrôleur et analyse puissante permet une rapide acquisition et analyse.



Métrologie de surfaces avec discontinuités avec en réflectivité différente

Métrologie d'épaisseur des matériaux transparents optiquement en lumière blanche ou IR

Métrologie XY latérale avec une détection automatique des formes (point-point, forme-forme, ligne-ligne, ligne-cercle, ligne-cercle, etc.)

Métrologie des lignes (Longueur, angle) et des formes (radii des cercles, aires des surfaces..)

ASCAN : Métrologie automatique (pour la production) avec chargement collectif, navigation par caméra, et reporting par lots avec traçabilité

Gamme de capteurs de lumière blanche confocale: résolution de mesure minimale à 3 nm et typiquement 35 nm sur une plage dynamique de 1 mm

Capteurs de lumière blanche confocale de ligne pour un balayage rapides : 196 points sur une largeur de 2mm

VANTAGE 1 Profilomètre optique linéaire

Profilométrie 2D intégrée à une plateforme réduite (table top) accueillant un capteur CHR avec haute résolution pour les profils linéaires sur 50mm, caméra et illumination. Une conception conviviale et économique intégrant un logiciel d'analyse sophistiqué et automatique.



linear y-axis 50 mm avec résolution 50 nm

Confocal White Light Sensor (C-CHR)

Optique échangeable pour résolution/ range : 8 nm/200µm ; 40nm/1mm ; 160nm/4mm

Camera with LED illumination for easy navigation on sample and fiducial correction

Dimensions/poids : 478 x 246 x 337 mm/ 20 kg

PC Windows avec le logiciel cyberTECHNOLOGIES SCAN SUITE

Option CYBER TECHNOLOGIES ASCAN pour la métrologie collective en production

VANTAGE 2 Profilomètre optique pour salle blanche

Les systèmes Vantage sont adaptés à une utilisation en salle blanche pour des mesures 1D ou 2D avec un ou deux capteurs. Tous les composants électroniques sont intégrés dans un boîtier robuste, sans câbles ni contrôleurs externes requis. Le système se connecte à un PC ou à une station de travail via un seul câble USB.



Options pour capteurs : confocal chromatique, interféromètre, interféromètre 3D à lumière blanche, microscope confocal, réflectomètre, caméra haute résolution

Métrologie à haute résolution (nm) grâce à des capteurs alternatifs sélectionnés en fonction des besoins spécifiques de l'application, pour la mesure de profil, d'épaisseur ou de surface

Vitesse de mesure : 2 000 points/seconde (options à 4 000 et 14 000 points/seconde disponibles)

Déplacement par moteurs linéaires de 200 mm en X et Y

Caméra et éclairage intégrés pour la navigation, avec réticule calibré

Option cyberTECHNOLOGIES ASCAN pour la métrologie collective en production

Axe Z motorisé avec fonction autofocus

CT 150 Profilomètre optique 3D avec capteur linéaire

Profilomètre équipé d'un capteur CHR linéaire, offrant une métrologie 3D compacte, une haute résolution, une vitesse rapide et une capacité d'analyse puissante.



Métrologie 3D haute vitesse : mesure de matrices de 10 µm sur des composants en quelques secondes et sur des substrats en quelques minutes

Capteur linéaire de lumière blanche confocale avec mesure à grande vitesse (1,15 million de points/seconde)

Capteur alternatif pour une résolution de >20 nm à <320 nm, sur une plage de >0,2 mm à <3,9 mm

Base et axes en granit, avec une zone de travail en XY de 150 x 150 mm et un réglage en Z de 100 mm

Caméra et éclairage intégrés pour la navigation, avec réticule calibré

Axe Z motorisé avec fonction autofocus

PC sous Windows équipé du logiciel cyberTECHNOLOGIES Scan Suite

Automatisation ASCAN pour la métrologie collective en environnement de production

Dimensions/poids : 701 x 491 x 875 mm / 85 kg

CT 300 / CT 350 / CT 600S Profilomètres optiques multi-capteurs pour production

La série CT offre une flexibilité inégalée grâce à sa conception multi-capteurs, elle intègre de manière transparente jusqu'à six technologies de capteurs différentes dans un seul système.



Option pour multiples capteurs : confocal chromatique, interféromètre, interféromètre 3D à lumière blanche, microscope confocal, réflectomètre, caméra haute résolution

Option capteur de ligne : 1,15 million de points/s avec une résolution jusqu'à 20 nm et un changement rapide d'objectif

Structure en granit isolée des vibrations et enceinte de sécurité avec platine XY de 350 mm * 350 mm ou 600 mm * 600 mm

Axe Z motorisé avec fonction autofocus

Montages adaptés pour boat, Jedec, strip et wafer 12 pouces

PC Windows avec logiciel cyberTECHNOLOGIES Scan Suite

Automatisation ASCAN pour la métrologie collective en production

Contrôle à distance via SECS/GEM

CT 350T / CT 600ST Profilomètre double capteur pour la mesure précise des épaisseurs

Métrologie double face avec capteurs supérieurs et inférieurs pour mesurer simultanément les surfaces supérieure et inférieure, l'épaisseur absolue et les variations d'épaisseur avec précision, adaptés à tous types de matériaux.



Option pour multiples capteurs : confocal chromatique, interféromètre, interféromètre 3D à lumière blanche, microscope confocal, réflectomètre, caméra haute résolution

Option capteur de ligne : 1,15 million de points/s avec une résolution jusqu'à 20 nm et un changement rapide d'objectif

Structure en granit isolée des vibrations et enceinte de sécurité avec platine XY de 350 mm * 350 mm ou 600 mm * 600 mm

Axe Z motorisé avec fonction autofocus

Montages adaptés pour boat, Jedec, strip et wafer 12 pouces

PC Windows avec le logiciel cyberTECHNOLOGIES Scan Suite

Automatisation ASCAN pour la métrologie collective en production

Contrôle à distance via SECS/GEM

CT 450G Profilomètre haute résolution pour produits grand format (-30 °C à 300 °C)

Le CT 450G est un système de métrologie haute résolution conçu pour les grandes pièces, avec une option de mesures à température statique allant de -30 °C à 300 °C.



Chambre de chauffage par convection pour profilométrie à haute résolution avec chaleur statique. Taille de l'échantillon : jusqu'à 300 mm et température de 300 °C à -30 °C avec refroidissement à l'azote

Option pour multiples capteurs : confocal chromatique, interféromètre, interféromètre 3D à lumière blanche, microscope confocal, réflectomètre, caméra haute résolution

Option capteur de ligne : 1,15 million de points/s

Structure en granit isolée avec axes XY de 450 mm * 450 mm

Axe Z motorisé avec fonction autofocus

PC Windows avec le logiciel cyberTECHNOLOGIES Scan Suite

Automatisation ASCAN pour la métrologie collective en production

Contrôle à distance via SECS/GEM

AL200S/AL200D AUTOMATIC

Profilomètre optique multifonction avec système de chargement automatique pour wafers/boat/strip/Jedec

L'AL 200S intègre une unité CT300 ou CT350T avec un système de manipulation des wafers, prenant en charge des wafers de 100 mm à 200 mm. Cette conception maximise le débit et peut être utilisée pour une large gamme d'applications «front-end».



Option pour multiples capteurs : confocal chromatique, interféromètre, interféromètre 3D à lumière blanche, microscope confocal, réflectomètre, caméra haute résolution

Système automatisé de manipulation des wafers à un ou deux bras, incluant le pré-alignement des wafers et le mappage des cassettes

Progiciel M-LINK pour le contrôle à distance

Station supplémentaire pour microscope ou autre appareil

Logiciel de traçabilité

AL200D en alternative, avec cellule double pour une métrologie simultanée

Contrôle à distance via SECS/GEM



TPT H240 Microscope Vidéo de mesure 200x

Le microscope vidéo de mesure H220 est un appareil autonome, haute résolution et économique pour la documentation et la gestion de la qualité



Microscope de mesure

Zoom 20-200 x

Led Ring Ajustable

Table de travail pour balayage manuel en option

Enregistrement de photo via USB

Enregistrement des mesures sous forme tableau

Mouvement Y&Z motorisé

Prix attractif

Écran de 11.6 pouces - 1920x1080



Contacts

Standard

+33 (0)2 32 35 64 80

Support technique

+33 (0)2 32 35 64 84
support@accelonix.fr

Service commercial

sales@accelonix.fr

Pièces détachées et consommables

devis@accelonix.fr

Gestion commerciale

commande@accelonix.fr



 Accelonix France

 www.accelonix.fr



Accelonix SAS • PA du Long Buisson • 260, rue Clément Ader • 27000 Evreux • France.
T: +33 (0)2 32 35 64 80

Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

CONSEIL INSTALLATION ACCOMPAGNEMENT
FORMATION MAINTENANCE SUPPORT